

# 紫光国芯微电子股份有限公司 2020年度第一期超短期融资券募集说明书



发行人:	紫光国芯微电子股份有限公司
注册金额:	人民币 10 亿元
首期发行	人民币 5 亿元
发行期限:	270 天以内
信用评级及债项评级:	主体评级: AA+ 中诚信国际信用评级有限责任公司
担保情况:	无担保

主承销商/簿记管理人/后续管理人: 中国建设银行股份有限公司



联席承销商: 光大证券股份有限公司



二零二零年十月

## 重要提示

本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

## 目录

第一章 释义	5
第二章 风险提示及说明	7
一、超短期融资券的投资风险	7
二、发行人相关风险	7
第三章 发行条款	12
一、主要发行条款	12
二、发行安排	12
第四章 募集资金运用	15
一、募集资金主要用途	15
二、发行人承诺	16
三、本期超短期融资券的偿还计划	18
第五章 发行人基本情况	20
一、发行人基本情况	20
二、发行人历史沿革及股本变动情况	21
三、发行人股权结构及实际控制人情况	22
四、发行人独立性情况	26
五、发行人重要权益投资情况	27
六、发行人公司治理	30
七、发行人高级管理人员及员工基本情况	36
八、发行人主营业务情况	40
十、发行人的发展战略和目标	53
十一、发行人所在行业现状及前景、行业政策、竞争格局	56
十二、其它重要事项	63
第六章 发行人主要财务状况	67
一、发行人财务数据的说明	67

二、发行人合并报表范围变化情况 .....	71
三、发行人近三年及一期财务报表 .....	73
四、发行人资产负债表结构分析.....	81
五、发行人利润结构分析 .....	99
六、发行人现金流量分析 .....	104
七、发行人偿债指标分析 .....	105
八、发行人有息债务 .....	106
九、发行人关联交易 .....	110
十、发行人或有事项 .....	114
十一、发行人受限资产情况 .....	115
十二、发行人衍生产品、理财产品、海外投资情况 .....	115
<b>第七章 发行人资信状况</b> .....	<b>117</b>
一、信用评级情况.....	117
二、发行人授信情况 .....	118
三、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况.....	120
四、发行人最新资信情况 .....	120
<b>第八章 担保</b> .....	<b>121</b>
<b>第九章 税项</b> .....	<b>122</b>
一、增值税 .....	122
二、所得税 .....	122
三、印花税 .....	122
<b>第十章 信息披露安排</b> .....	<b>123</b>
一、信息披露机制.....	123
二、信息披露安排.....	123
<b>第十一章 持有人会议机制</b> .....	<b>125</b>
一、持有人会议的目的与效力 .....	125

二、持有人会议的召开情形 .....	125
三、持有人会议的召集 .....	127
四、持有人会议参会机构 .....	128
五、持有人会议的表决和决议 .....	129
六、其他 .....	132
<b>第十二章 违约责任与投资者保护机制 .....</b>	<b>133</b>
一、违约事件 .....	133
二、违约责任 .....	133
三、投资者保护机制 .....	133
四、不可抗力 .....	135
五、弃权 .....	135
<b>第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构 .....</b>	<b>136</b>
一、发行人 .....	136
二、牵头主承销商 .....	136
三、联席主承销商 .....	136
四、公司法律顾问 .....	136
五、审计机构 .....	137
六、信用评级机构 .....	137
七、托管人 .....	137
八、集中簿记建档系统技术支持机构 .....	137
<b>第十四章 备查文件 .....</b>	<b>139</b>
一、备查文件 .....	139
二、文件查询地址 .....	139
<b>附录：发行人主要财务指标计算公式 .....</b>	<b>140</b>

## 第一章 释义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

### 一、名词释义

发行人/紫光国微/公司	指	紫光国芯微电子股份有限公司
紫光春华	指	西藏紫光春华投资有限公司，为发行人控股股东
紫光集团	指	紫光集团有限公司，为发行人间接控股股东
清华控股	指	清华控股有限公司，为发行人实际控制人
同方股份	指	同方股份有限公司，为发行人前控股股东
唐山晶源	指	唐山晶源科技有限公司，为发行人设立时的控股股东
同芯微电子	指	紫光同芯微电子有限公司，由北京同方微电子有限公司更名而来
国微电子	指	深圳市国微电子电子有限公司
紫光同创	指	深圳市紫光同创电子有限公司
紫光联盛	指	北京紫光联盛科技有限公司
长江控股	指	长江存储科技控股有限责任公司
长江存储	指	长江存储科技有限责任公司
超短期融资券	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 270 天内还本付息的债务融资工具。
本期超短期融资券	指	本期发行金额为人民币【】亿元、期限为 270 天的紫光国芯微电子股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券。
本次发行	指	本期超短期融资券的发行。
我国、中国	指	中华人民共和国。
募集说明书	指	公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的《紫光国芯微电子股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书》。
主承销商	指	中国建设银行股份有限公司
联席主承销商		光大证券股份有限公司
簿记管理人	指	簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国建设银行股份有限公司担任。
簿记建档	指	指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。
承销商	指	与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构。
承销协议	指	公司与主承销商签订的《承销协议》。
《公司章程》	指	《紫光国芯微电子股份有限公司章程》
最近三年、近三年	指	2017 年度、2018 年度和 2019 年度
最近三年及一期、报告期	指	2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月

证监会	指	中国证券监督管理委员会。
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会。
环保部	指	中华人民共和国环境保护部。
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部。
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会。
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司。
北金所	指	北京金融资产交易所有限公司。
银行间市场	指	全国银行间债券市场。
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。
工作日	指	中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元
唐山市国资委	指	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

## 二、其他事项

本募集说明书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。同时，由于计算时小数点后两位采用四舍五入的方式，因此表格中各单项数据之和与合计数在小数点后两位可能存在误差。

## 第二章 风险提示及说明

本期超短期融资券无担保，能否按时兑付取决于发行人的经营状况和财务状况。投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，除本募集说明书提供的各项资料外，应认真考虑下列风险因素：

### 一、超短期融资券的投资风险

#### （一）利率风险

在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率的波动，市场利率的波动将对投资者投资本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响。

#### （二）流动性风险

本期超短期融资券将在银行间市场上进行交易，在转让时可能由于无法及时找到交易对手而难以将超短期融资券变现，存在一定的流动性风险。

#### （三）偿付风险

在本期超短期融资券的存续期内，如果政策、法规或行业、市场及环境等不可控因素变化，可能影响发行人的经营状况或导致发行人的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响本期超短期融资券的按期足额兑付。

### 二、发行人相关风险

#### （一）财务风险

##### 1、营业毛利率波动风险

发行人 2017-2019 年度以及 2020 年 1-6 月的营业毛利率分别为 33.14%、30.15%、35.75%和 55.07%，呈波动趋势。发行人 2018 年度毛利率较 2017 年度有所下降，主要是智能安全芯片市场竞争激烈致使产品毛利率下降以及低毛利率的存储器芯片业务收入占比增加。2019 年度发行人毛利率最高的特种集成电路业务收入规模大幅上升使得营业毛利率有所回升。2020 年一季度发行人营业毛利率进一步上升，是由于 2020 年 1 季度高毛利率的特种集成产品毛利率进一步提升且收入占比增加所致。如果未来行业环境、市场需求环境发生重大不利变化，公司存在营业毛利率波动的风险。



## 2、应收账款回收风险

截至 2017-2019 年末及 2020 年 6 月末，发行人应收账款账面净额分别为 8.17 亿元、10.89 亿元、13.13 亿元和 18.18 亿元，占各期末流动资产比重分别为 29.79%、32.00%、29.82%和 40.94%，所占比重较高，且最近三年金额持续增长。尽管发行人近 3 年应收转款周转率持续提升，主要客户均为实力强、信誉好的优质客户，且主要客户历史回款状况良好，但如果发行人催收不及时，或主要债务人的财务、经营状况发生恶化，则存在部分应收账款无法收回的风险。

## 3、商誉减值风险

截至 2020 年 6 月末，发行人商誉账面价值为 6.86 亿元，占公司期末总资产比重为 9.97%，若后期被并购对象经营业绩下滑，商誉资产或发生减值，将对发行人的盈利表现产生不利影响。

## 4、政府补助变化风险

发行人获得的政府补助主要为集成电路业务相关的研发项目补助。2017-2019 年度，发行人计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）分别为 0.61 亿元、0.46 亿元和 0.45 亿元。近年来国家不断出台各项政策支持集成电路产业发展，在国家大力发展集成电路产业的长期规划下，基于发行人积累的研发实力，发行人获得的政府补助具备一定的持续性。但如未来政策环境发生变化，可能导致发行人获取的政府补助金额减少甚至取消，从而对发行人未来的净利润和现金流产生不利影响。

## 5、经营活动现金流波动风险

2017-2019 年度以及 2020 年 1-6 月，发行人经营活动净现金流分别为 5.84 亿元、3.19 亿元、2.66 亿元和-2.48 亿元，呈下降趋势。2018 年度发行人集成电路业务规模增长，年末应收账款以及存货占用资金增加，使得当年经营活动产生的现金流量净额有所减少。2019 年度，为扩大市场份额，发行人适当延长了客户账期，以及备货环节资金占用增加，导致经营活动现净现金流下降。2020 年 1-6 月，发行人经营活动现净现金流为负，主要系销售回款受疫情影响延迟及备货采购付款增加所致。由于发行人从事的集成电路设计业务受到宏观经济、产业政策、市场需求及技术升级等因素的影响，发行人经营活动现金流近年出现一定程度的波动，若未来经营活动现金流进一步下降，可能会对发行人的日常流动性及短期偿债能力产生不利影响。

## 6、资本支出压力较大的风险

2017-2019 年度以及 2020 年 1-6 月，发行人投资活动净现金流分别为-2.93 亿元、-2.43 亿元、-4.82 亿元和-2.44 亿元。由于发行人所处的集成电路设计行业属于典型的资本和技术密集型行业，技术更新要求持续的、较高的资本投入。截至

2020 年 6 月末，发行人有如下五个在建项目：1) 成都研发中心项目，工程进度 85.00%；2) SMD 小型化项目，工程进度 100.00%；3) 集成电路在安装设备，工程进度 80.00%；4) 小型化 OCXO 及专用 IC 研发与产业化项目，工程进度 15.25%；5) 高档石英谐振器产业化项目，工程进度 4.09%。上述在建项目对发行人的研发能力提升及经营健康发展有积极作用。如未来发行人资本支出持续增长，将给发行人带来一定的财务压力。

### **7、研发支出无法产生预期收益的风险**

集成电路技术迭代速度较快，如果公司对相关技术和市场发展趋势判断失误，或新技术的市场接受度未如预期，将让公司面临研发支出无法产生预期收益的风险。

## **(二) 经营风险**

### **1、行业景气度风险**

发行人所处的集成电路行业具有投资规模大、终端市场变化快的特点，因此受金融市场和实体经济的影响较大，宏观经济和政治环境的变化对发行人的经营业绩会造成影响。虽然目前集成电路行业呈现稳定增长的趋势，但是国际经济形势错综复杂，国内市场面临经济结构调整以及经济增速减缓的压力，未来几年集成电路行业能否继续保持高速增长存在不确定性。发行人的经营业绩与集成电路行业的景气度紧密相关，行业景气度的变化将使公司面临一定的经营风险。

### **2、市场竞争风险**

在集成电路市场上，国际著名芯片厂商在资产规模、技术水平及抗风险能力上具有显著优势，发行人面临国际厂商的竞争风险。同时，目前国内集成电路设计企业数量较多，市场竞争日趋激烈。虽然发行人具有较为丰富的行业经验，市场开拓、培育及竞争能力较强，但如果竞争对手投入更多的资源推广及销售其产品，或采取更激进的定价策略，可能限制公司的盈利能力，导致发行人市场份额的降低。

### **3、技术更新风险**

集成电路行业的终端市场销售对象通常为电子产品消费者。终端电子产品的市场需求多变，从而导致整个集成电路产业链具有技术更新快、相关产品和技术生命周期短、竞争格局变化大的特点。

虽然发行人制定了完善的技术研发管理流程和可行性评估制度，所有研发项目的启动都必须经过前期市场调查、分析和收益评估，进行严格的审核程序后方可实施，但仍存在对新产品和新技术的市场前景判断失误的风险。如果发行人不能及时、准确地把握产品和技术的发展趋势，不能持续保持技术创新或升级，或

新技术的市场接受度未达预期，将削弱发行人已有的竞争优势，从而对发行人的经济效益及发展前景造成不利影响。

#### **4、产品开发风险**

发行人的盈利基础在于新产品的开发及销售。鉴于集成电路设计的特点，新产品开发的研发费用大、开发周期长。

产品开发风险主要来自以下几个方面：（1）在产品规划阶段，存在对市场需求判断失误的风险，可能导致公司产品定位错误；（2）存在对企业自身实力判断失误的风险，主要是技术开发能力的判断错误引起的，可能引发发行人项目的中断；（3）在新产品上市销售阶段，存在因方案不够成熟等引起的市场开拓风险，这种风险可能导致产品销售迟滞，发行人无法有效回收成本从而影响后续开发。

#### **5、核心技术人员流失的风险**

核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分，但经营效益的波动、员工激励等内部治理变化以及竞争对手发展或造成公司核心技术人员的流失，将对公司运营产生负面影响。

#### **6、突发事件引发的经营风险**

发行人如遇突发事件，例如不可预知的社会大型活动影响、生产经营安全事故、社会治安事件、公司管理层无法履行职责等事项，可能使发行人社会形象受到影响，人员生命及财产安全受到危害，发行人治理机制不能顺利运行等，对公司的经营可能造成不利影响。

### **（三）管理风险**

#### **1、内部控制风险**

发行人已建立了一套较为完整、合理和有效的内部控制制度。内部控制的有效运行，保证了发行人经营管理正常有序地开展。随着发行人业务的不断发展，发行人的资产、业务、机构和人员将进一步扩展，发行人在运营管理和内部控制等方面将面临着更大的挑战。如果发行人未能继续强化内控体系建设，相关内控制度不能随着企业规模的扩张和发展不断完善，可能导致发行人出现内部控制有效性不足的风险。

#### **2、子公司管控风险**

发行人下属公司涉及国内多个省市和境外公司，虽然发行人已经建立起较为完善的子公司管理制度，但随着业务的持续发展，子公司数目可能继续增加，管理半径不断扩大。如果发行人内部管理体系不能正常运作或者效率降低，或者下属企业自身管理水平不高，可能对下属企业开展业务和提高经营业绩产生不利影响，进而损害发行人的利益。如果发行人不能及时提高对子公司的战略协同、财

务协同、技术协同、市场协同的管控能力，将对发行人的经营和发展产生一定的潜在风险。

### 3、人力资源风险

集成电路设计行业是典型的知识密集型行业，人力资源优势是行业内企业核心竞争力的体现。因此，人才是公司发展的根本保障，人才队伍的建设对公司的发展至关重要，能否维持公司人员队伍的稳定，并不断吸引优秀人才加盟，关系到公司能否继续保持行业内的技术领先优势和未来的发展动力。

虽然发行人十分重视人才的引进和培养，并采取了多种措施稳定人员队伍并取得较好的效果，但仍存在人才流失及人才短缺的风险。同时，随着公司经营规模的继续扩张，对技术人才和管理人才的需求将进一步增加，公司可能面临人才不足的风险。

## （四）政策风险

### 1、产业政策风险

发行人所处的集成电路行业受到国际国内产业政策、地区发展政策等的影响，相关政策的变化将对发行人各项业务的发展产生影响。在我国国民经济不同的发展阶段，国家、地方的产业政策导向和侧重点都会有所不同。相关产业政策的变动有可能影响发行人的经营情况和盈利水平。

### 2、税收优惠政策风险

目前，发行人的子公司紫光同芯微电子有限公司、深圳市国微电子有限公司、唐山国芯晶源电子有限公司、无锡紫光微电子有限公司为高新技术企业，执行 15% 的企业所得税优惠税率。同时，同芯微电子、国微电子符合国家规划布局内的集成电路设计企业资质，根据财税【2016】49 号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》文件及财税【2012】27 号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》文件的规定，减按 10% 征收企业所得税。此外，发行人下属子公司的部分可研项目或产品根据相关规定享受增值税优惠政策。但如果未来发行人及/或下属子公司所享受的税收优惠政策发生变化，可能对发行人的盈利能力产生不利影响。

### 3、不可抗力风险

严重自然灾害以及突发性公共事件会对发行人的财产、人员造成损害，并有可能影响发行人的正常生产经营。

## 第三章 发行条款

### 一、主要发行条款

债务融资工具名称	紫光国芯微电子股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券。
发行人全称	紫光国芯微电子股份有限公司。
发行人及下属子公司待偿还债务融资工具余额	截至本募集说明书签署之日为止，发行人及下属子公司债务融资工具余额为 3 亿元。
接受注册通知书文号	【】
注册金额	人民币 10 亿元。
超短期融资券期限	270 天以内。
计息年度天数	闰年为 366 天，平年为 365 天。
超短期融资券面值	人民币 100 元。
发行价格	面值发行，发行利率由集中簿记建档结果确定。
发行对象	银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
票面利率	【】
承销方式	余额包销
公告日期	【】
发行方式	采用簿记建档，集中配售方式发行
集中簿记建档日	2020 年【】月【】日-2020 年【】月【】日
发行日	2020 年【】月【】日-2020 年【】月【】日
缴款日	2020 年【】月【】日
起息日	2020 年【】月【】日
债权债务登记日	2020 年【】月【】日
上市流通日	2020 年【】月【】日
本息兑付日	2020 年【】月【】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日）。
还本付息方式	到期一次性还本付息。
兑付价格	按面值兑付。
信用评级机构及评级结果	中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用级别为 AA+，评级展望为稳定。
超短期融资券担保	本期超短期融资券不设担保。
本期超短期融资券的托管人	银行间市场清算所股份有限公司
集中簿记建档系统技术支持机构	北京金融资产交易所有限公司
簿记管理人及主承销商	中国建设银行股份有限公司
后续管理人	中国建设银行股份有限公司
税务提示	根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担。

### 二、发行安排

#### （一）集中簿记建档安排

1、本期紫光国芯微电子股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，本期紫光国芯微电子股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券承销团成员须通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《紫光国芯微电子股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

2、每一承销团成员申购金额的下限为 1,000 万元（含 1,000 万元），申购金额超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。

## （二）分销安排

1、认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。

2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类托管账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。

## （三）缴款和结算安排

1、缴款时间：【2020】年【 】月【 】日。

2、簿记管理人将在发行日下午 17:00 前通过集中簿记建档系统发送《紫光国芯微电子股份有限公司 2020 年度债务融资工具配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配超短期融资券面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。

3、合格的承销商应于缴款日下午 17:00 前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：

户名：中国建设银行股份有限公司

开户银行：中国建设银行总行（不受理个人业务）

账号：110400396

支付系统行号：105100000017

汇款用途：紫光国芯微电子股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券承销款

如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期超短期融资券发行结束后，超短期融资券认购人可按照有关主管机构的规定进行超短期融资券的转让、质押。

## （四）登记托管安排

本期超短期融资券以实名记账方式发行，在银行间市场清算所股份有限公司进行登记托管。

上海清算所为超短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对超短期融资券进行债权管理、权益监护和代理兑付，并负责向投资人提供有关信息服务。

#### **(五) 上市流通安排**

本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日（2020 年【 】月【 】日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

#### **(六) 其他**

无

## 第四章 募集资金运用

### 一、募集资金主要用途

本次注册募集资金用途：发行人申请注册 10 亿元超短期融资券，其中 3 亿元用于偿还有息借款，7 亿元用于补充营运资金。本期发行金额 5 亿元，1 亿元用于发行人及下属子公司偿还公司债务，4 亿元用于补充营运资金。本期超短期融资券发行有利于公司提高直接融资比例和优化融资结构，增加公司现金管理的灵活性，并进一步降低融资成本。

表 4-1：本次募集资金用途情况表

用途	金额
补流	7 亿
偿还贷款	3 亿
合计	10 亿

表 4-2：本期募集资金用途情况表

用途	金额
补流	4 亿
偿还贷款	1 亿
合计	5 亿

表 4-3：本期募集资金用途情况表-偿还贷款

公司名称	贷款类别	金融机构	贷款金额	利率	借款日	最后还本日
无锡紫光微电子有限公司	流动资金贷款	招商银行无锡分行新区支行	68.82	5.00%	2019/12/18	2020/12/18
无锡紫光微电子有限公司	流动资金贷款	招商银行无锡分行新区支行	82.77	5.00%	2019/11/22	2020/11/22
深圳市国微电子有限公司	流动资金贷款	招行泰然支行	2,000.00	4.35%	2020/3/30	2020/12/30
深圳市国微电子有限公司	流动资金贷款	招行泰然支行	3,000.00	4.35%	2020/4/23	2020/12/23
深圳市国微电子有限公司	流动资金贷款	招行泰然支行	3,000.00	4.40%	2020/2/28	2020/12/28
紫光同芯微电子有限公司	流动资金贷款	中国工商银行中关村支行	3,000.00	4.35%	2020/1/1	2020/12/31
合计			11,151.59			

#### (一) 偿还有息借款

表 4-4：发行人拟偿还到期贷款明细表

单位:万元



## 紫光国芯微电子股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书

借款主体	贷款类别	金融机构	贷款金额	利率	借款日	最后还本日
无锡紫光微电子有限公司	流动资金贷款	招商银行无锡分行新区支行	68.82	5.00%	2019/12/18	2020/12/18
无锡紫光微电子有限公司	流动资金贷款	招商银行无锡分行新区支行	248.41	5.00%	2020/1/6	2021/1/6
无锡紫光微电子有限公司	流动资金贷款	招商银行无锡分行新区支行	200.00	4.80%	2020/1/20	2021/1/20
无锡紫光微电子有限公司	流动资金贷款	江苏银行无锡科技支行	300.00	4.35%	2020/5/19	2021/1/18
无锡紫光微电子有限公司	流动资金贷款	招商银行无锡分行新区支行	82.77	5.00%	2019/11/22	2020/11/22
无锡紫光微电子有限公司	流动资金贷款	中国银行无锡河埭支行	200.00	4.79%	2020/1/15	2021/1/12
无锡紫光微电子有限公司	流动资金贷款	中国银行无锡河埭支行	200.00	4.79%	2020/1/19	2021/1/15
无锡紫光微电子有限公司	流动资金贷款	中国银行无锡河埭支行	400.00	4.79%	2020/2/11	2021/2/9
紫光国芯微电子股份有限公司	流动资金贷款	中信银行海淀支行	4,150.00	4.25%	2020/9/4	2021/7/8
深圳市国微电子有限公司	流动资金贷款	平安银行深圳罗湖支行	5,000.00	4.24%	2020/7/29	2021/7/28
深圳市国微电子有限公司	流动资金贷款	招行泰然支行	2,000.00	4.35%	2020/3/30	2020/12/30
深圳市国微电子有限公司	流动资金贷款	招行泰然支行	3,000.00	4.35%	2020/4/23	2020/12/23
深圳市国微电子有限公司	流动资金贷款	招行泰然支行	3,000.00	4.40%	2020/2/28	2020/12/28
紫光同芯微电子股份有限公司	流动资金贷款	中国工商银行中关村支行	3,000.00	4.35%	2020/1/1	2020/12/31
紫光同芯微电子股份有限公司	流动资金贷款	招商银行北京大运村支行	3,000.00	4.35%	2020/1/19	2021/1/18
紫光同芯微电子股份有限公司	流动资金贷款	招商银行北京大运村支行	991.01	4.35%	2020/2/25	2021/2/24
紫光同芯微电子股份有限公司	流动资金贷款	国家开发银行北京市分行	5,334.32	3.50%	2020/5/29	2023/5/28
紫光同芯微电子股份有限公司	流动资金贷款	中国建设银行	1,300.00	2.91%	2020/6/29	2020/12/29
紫光国芯微电子股份有限公司	流动资金贷款	中国工商银行上地支行	615.00	3.92%	2020/4/7	2021/3/25
紫光国芯微电子股份有限公司	流动资金贷款	南京银行北京分行营业部	5,000.00	4.50%	2020/7/27	2021/7/27
合计			<b>38,090.33</b>			

**(二) 补充流动性**

基于发行人 2019 年 12 月末财务报表，依据银监会于 2010 年 2 月 12 日发布的《流动资金贷款管理暂行办法》后附的流动资金贷款需求量测算方法，对发行人流动性缺口进行测算。如下表所示，发行人流动性资金缺口为 8.22 亿元。

**表 4-5：发行人流动性缺口测算表**

单位:万元

2019 年销售收入	343,041.00	2019 年总资产	678,646.53		
2019 年销售成本	220,412.76	2019 年流动资产	440,438.53		
2019 年净利润	40,054.70	2019 年非流动资产	238,208.00		
预计销售收入年增长率	35.00%	2019 年长期借款	7,120.00		
2019 年末自有资金=货币资金 余额-存放在境外的款项-其他货 币资金	98,856.07	2019 年所有者权益	419,275.63		
2019 年末流动资金贷款	25,797.10				
2019 年末其他渠道取得的融资	0.00				
	<b>2019 年初</b>	<b>2019 年末</b>	<b>年均余额</b>	<b>周转次数</b>	<b>周转天数</b>
应收账款	131,349.83	108,948.35	120,149.09	2.86	126.09
预付账款	6,231.76	5,510.47	5,871.12	37.54	9.59
存货	86,397.66	78,858.79	82,628.23	2.67	134.96
应付账款	65,449.12	40,434.80	52,941.96	4.16	86.47
预收账款	1,487.25	2,495.45	1,991.35	172.27	2.09
营运资金周转次数	1.98				
营运资金量: 上年销售收入*(1- 上年度销售净利率) * (1+预计 销售收入年增长率) / 营运资金 周转次数	206,873.34				
新增流动资金贷款额度	<b>82,220.17</b>				

## 二、发行人承诺

为了充分、有效地维护和保障超短期融资券持有人的利益，发行人承诺将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。发行人募集资金应用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要，不用于长期投资。募集资金投向不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设；募集资金不用于金融投资、土地一级开发，不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款，不用于保障房（含棚户区改造）项目建设或偿还保障房（含棚户区改造）项目贷款，不用于二级市场增持股票，不用于购买高收益理财产品。

发行人承诺在本期超短期融资券存续期间，若发生募集资金用途变更，将通过中国货币网、上海清算所网站和其他中国银行间市场交易商协会指定的平台及时披露有关信息。

### 三、本期超短期融资券的偿还计划

#### (一) 还款来源

本期超短期融资券还款资金主要来源于发行人自身经营活动现金流。

#### (二) 企业经营状况

发行人主要业务为集成电路芯片设计与销售，深耕此领域多年，保持业内领先的技术优势。随着新产品、新业务的不断推出，2019 年发行人经营业绩实现较快增长，并保持业内领先的技术优势。2019 年实现营业总收入 34.30 亿元，同比增长 39.54%；实现净利润 4.01 亿元，同比增长 14.92%。同时，发行人执行稳健的财务政策，资产负债率与总资本化比率均控制在较低水平，发行人具备很强的经营获现能力。截至 2019 年末发行人 EBITDA 总额 6.07 亿元，同比增长 10.36%。2017-2019 年发行人经营活动净现金流分别为 5.84 亿元、3.19 亿元和 2.66 亿元，发行人近三年经营活动现金流呈现大幅净流入。同时，当前国家不断推出产业政策支持集成电路的发展，良好的外部环境将推动公司未来业务的开展。

综上所述，发行人第一还款来源充足。

#### (三) 其他还款来源

发行人除经营性现金净流入外，截至 2020 年 6 月末，发行人共有货币资金 102,706.98 万元，应收账款 181,823.62 万元，存货 89,893.72 万元。发行人在经营状况或市场环境出现负面变化的时候，该部分资产的变现会成为发行人偿付能力的保障和补充，确保投资者的资产安全。

发行人与国内各主要金融机构建立了良好的合作关系，间接融资渠道畅通，具备较强的融资能力，为贷款及债务融资工具的本息偿付提供进一步的保障。截至 2020 年 6 月末，发行人共获得银行授信 24.21 亿元。此外，发行人可通过资本市场进行股权融资和债权融资，具有较为广阔的融资渠道和较强的融资能力。

综上所述，发行人拥有充足的其他还款来源。

#### (四) 本期超短期融资券的偿债保障措施

为了充分、有效地维护超短期融资券投资人利益，发行人为本期超短期融资券的按时、足额偿付制定了一系列保障措施，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保超短期融资券安全兑付的内部机制。

##### (一) 加强募集资金的使用管理

发行人根据国家政策和公司资金使用计划安排使用募集资金。依据公司内部管理制度，由发行人指定其内部相关部门和人员对募集资金使用情况进行不定期核查。确保募集资金做到专款专用，同时安排人员专门对募集资金使用情况进行

日常监督。发行人已要求各有关部门协调配合，加强管理，确保募集资金有效使用和到期偿还。

#### （二）偿债计划的人员安排

发行人将安排人员专门负责管理本期超短期融资券还本付息工作。自发行日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

#### （三）制定应急措施

发行人若出现未能按约定或者未能按期偿付资金本息，将采取暂缓重大对外投资、变现优良资产等措施，来保证本期超短期融资券本息的兑付，保护投资者的利益。

#### （四）加强日常资金管理

发行人将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，并严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。投资项目注重回报，对于财务测算可行、内部收益率大于行业基准收益率、风险规避措施到位、投资安全有保障的项目进行重点考虑。同时，发行人也将加强对货币资金的管理，提高资金使用效率，提高资金的自我调剂能力，为本期超短期融资券本息的按时偿还创造条件。

## 第五章 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

中文名称:	紫光国芯微电子股份有限公司
英文名称:	Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.
注册资本:	人民币 60,681.80 万元
注册地址:	河北省玉田县无终西街 3129 号
邮政编码:	064100
法定代表人:	马道杰
统一社会信用代码:	911302006010646915
成立日期:	2001 年 9 月 17 日
上市日期:	2005 年 6 月 6 日
股票简称:	紫光国微
股票代码:	002049
股票上市地:	深圳证券交易所
办公地址:	河北省玉田县无终西街 3129 号
联系人:	杜林虎
电话:	010-82355911
传真:	010-82366623
互互联网址:	<a href="http://www.gosinoic.com">http://www.gosinoic.com</a>

公司经营范围为：集成电路设计、开发、销售与技术服务；高亮度发光二极管（LED）衬底材料开发、生产、销售；生产和销售压电石英晶体器件；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

截至 2019 年末，发行人的总资产为 678,646.53 万元，总负债为 259,370.90 万元，所有者权益为 419,275.63 万元。2019 年度，实现营业收入 343,041.00 万元，利润总额 45,617.00 万元，净利润 40,054.70 万元，经营活动净现金流量为 26,592.89 万元。

截至 2020 年 6 月末，发行人的总资产为 687,984.54 万元，总负债为 232,061.51 万元，所有者权益为 455,923.03 万元。2020 年 1-6 月，实现营业收入 146,436.53 万元，利润总额 43,806.43 万元，净利润 40,221.97 万元，经营活动净现金流量为 -24,799.65 万元，主要是因为公司为扩大市场份额，适当延长了客户账期，以及备货环节资金占用增加，故 2020 年 1-6 月经营性现金流呈现净流出。

## 二、发行人历史沿革及股本变动情况

### (一) 设立及上市情况

#### 1、2001 年设立

发行人是经河北省人民政府冀股办[2001]88 号文批准，由唐山晶源裕丰电子有限公司整体变更的股份有限公司，于 2001 年 9 月 17 日在河北省设立，设立时名称为“唐山晶源裕丰电子股份有限公司”，注册资本为 5,050.00 万元，控股股东为唐山晶源，实际控制人为阎永江。

#### 2、2005 年首次公开发行股票并上市

2005 年 5 月 20 日，经中国证监会证监发行字[2005]18 号文批准，发行人首次公开发行股票 2,500 万股，并经深交所深证上[2005]52 号文批准，发行人股票于 2005 年 6 月 6 日上市交易，股票简称为“晶源电子”。首次公开发行股票后，发行人总股本为 7,550 万股。

### (二) 发行人上市后股本变动情况

#### 1、2005 年股权分置改革

2005 年 10 月 28 日，发行人股东大会审议通过了《股权分置改革方案》，公司原非流通股股东向全体流通股股东每 10 股支付 3.5 股股份，以获得其所持股份的流通权。股权分置改革完成后，公司总股本未发生变化。

#### 2、2007 年非公开发行股票

2007 年 2 月，经中国证监会证监发行字[2007]36 号文核准，发行人向特定投资者非公开发行股票 1,450 万股，该等股份于 2007 年 3 月 14 日在深交所上市，公司总股本增加至 9,000 万股。

#### 3、2008 年公积金转增股本

2008 年 11 月 3 日，根据公司 2008 年第三次临时股东大会决议，发行人实施资本公积金转增股本方案，以 2008 年上半年末总股本为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本增加至 13,500 万股。

#### 4、2010 年实际控制人变更

2009 年 6 月，同方股份与唐山晶源签署《发行股份购买资产协议》，同方股份以发行股份方式收购唐山晶源持有的发行人 3,375 万股股份，占总股本的 25%。经中国证监会核准该方案，同方股份与唐山晶源于 2010 年 6 月 28 日办理完毕股份转让及过户登记手续。至此，发行人控股股东由唐山晶源变更为同方股份，实际控制人变更为清华控股。

#### 5、2012 年非公开发行股票及更名

经中国证监会《关于核准唐山晶源裕丰电子股份有限公司向同方股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]340 号）核准，发行人于 2012 年 5 月以非公开发行股票作为支付对价收购同芯微电子 100% 股权。本次交易完成后，公司总股本增加至 24,175.30 万股，公司名称变更为“同方国芯电子股份有限公司”，股票简称变更为“同方国芯”。

## 6、2013 年非公开发行股票

经中国证监会《关于核准同方国芯电子股份有限公司向深圳市国微投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1726 号）核准，发行人于 2012 年 12 月以非公开发行股票作为支付对价收购国微电子 100% 股权，并于 2013 年 2 月非公开发行股票募集配套资金。本次交易完成后，公司总股本增加至 30,340.90 万股。

## 7、2014 年公积金转增股本

2014 年 6 月 16 日，根据公司 2013 年度股东大会决议，发行人实施公积金转增股本方案，以 2013 年末总股本为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增加至 60,681.80 万股。

## 8、2016 年控股股东变更及更名

2015 年 11 月 2 日，紫光春华与同方股份签署《股份转让协议》，紫光春华以现金受让同方股份持有的发行人 22,083.50 万股股份，占总股本的 36.39%。紫光春华与同方股份于 2016 年 4 月 7 日办理完毕股份转让及过户登记手续。至此，发行人控股股东由同方股份变更为紫光春华，实际控制人仍为清华控股。

2016 年 6 月 20 日，发行人名称变更为“紫光国芯股份有限公司”，股票简称变更为“紫光国芯”。

## 9、2018 年名称变更

2018 年 4 月 27 日，发行人名称变更为“紫光国芯微电子股份有限公司”，股票简称变更为“紫光国微”。

截至本募集说明书签署日，公司总股本为 606,817,968 股，其中第一大股东西藏紫光春华（以下简称“紫光春华”）持股比例为 34.39%，紫光春华系紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）全资控股的投资平台，紫光集团为公司间接控股股东，公司实际控制人为清华控股有限公司（以下简称“清华控股”），最终实际控制人为教育部。

## 三、发行人股权结构及实际控制人情况

### （一）股权结构

截至 2020 年 6 月末，发行人前十名股东持股情况如下：

表 5-1: 截至 2020 年 6 月 30 日发行人前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量/股	持股比例	股份性质
1	西藏紫光春华投资有限公司	220,835,000	36.39%	流通 A 股
2	香港中央结算有限公司	11,797,969	1.94%	流通 A 股
3	中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	9,645,647	1.59%	流通 A 股
4	中央汇金资产管理有限责任公司	9,121,700	1.50%	流通 A 股
5	中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	7,600,649	1.25%	流通 A 股
6	韩军	7,500,000	1.24%	流通 A 股
7	中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	7,309,452	1.20%	流通 A 股
8	招商银行股份有限公司—交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	6,387,114	1.05%	流通 A 股
9	同方股份有限公司	6,011,396	0.99%	流通 A 股
10	共青城清晶微投资管理合伙企业(有限合伙)	5,230,940	0.86%	流通 A 股
合计		<b>291,439,867</b>	<b>48.01%</b>	-

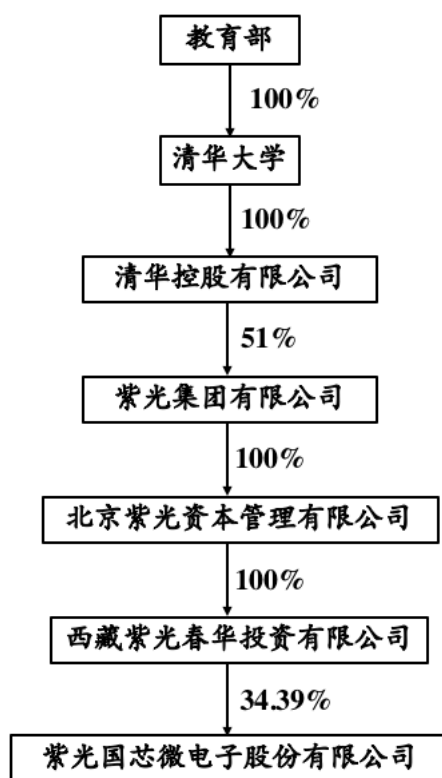
2020 年 7 月 20 日至 7 月 22 日,紫光春华通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式累计减持公司股份 779.31 万股,占公司总股本的 1.28%。减持后,发行人第一大股东紫光春华持有发行人无限售条件普通股 213,041,900 股,占公司总股本的 35.11%。截至 2020 年 9 月 21 日,紫光春华持有发行人 34.39%的股权。

截至本募集说明书签署日,发行人控股股东、实际控制人及其关联方持有的发行人股票不存在质押情况。

截至本募集说明书签署日,公司、控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示:

图 5-1: 截至募集说明书签署日公司、控股股东及实际控制人之间的控制关系





## (二) 控股股东

截至本募集说明书签署日，发行人的控股股东为西藏紫光春华投资有限公司，对发行人的控股比例 34.39%。

西藏紫光春华投资有限公司的法定代表人为赵伟国，成立日期为 2015 年 2 月 9 日，注册资本为 30 亿元。该公司的经营范围包括股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务；不得从事房地产业务）；创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

截至 2019 年末，紫光春华资产总额为 157.96 亿元，负债总额为 78.21 亿元，2019 年实现营业收入总额为 34.30 亿元，净利润为 3.17 亿元。

## (三) 实际控制人

发行人实际控制人为清华控股有限公司，系清华大学在整合清华科技产业的基础上，经国务院批准、出资设立的国有独资有限责任公司。清华控股作为投资

持股型公司，截至目前已形成了以信息技术产业为支柱，能源环保产业、生命健康产业、科技服务和知识产业及资产管理及其他产业协同发展的战略格局。其简要信息如下：

清华控股有限公司成立于 1992 年 8 月 26 日，注册资本为 250,000.00 万元，法定代表人为龙大伟，注册地址位于北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼（科技大厦）A 座 25 层，经营范围为资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；投资、投资管理、投资咨询；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；高科技企业孵化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

截至 2019 年末，清华控股资产总额为 4,877.01 亿元，负债总额为 3,597.64 亿元，2019 年度实现营业收入 1,364.76 亿元，净利润为 34.22 亿元。

报告期内关于发行人实际控制人变更提示公告：

(1) 2018 年 8 月 11 日《紫光国芯微电子股份有限公司关于实际控制人筹划转让紫光集团有限公司部分股权的提示函公告》：清华控股有限公司持有紫光集团 51% 股权，为公司实际控制人，公司于 2018 年 8 月 10 日收到紫光集团通知，紫光集团的控股股东清华控股有限公司正在筹划转让其持有的紫光集团的部分股权，该事项可能涉及到公司实际控制人变更。

(2) 2018 年 9 月 5 日《紫光国芯微电子股份有限公司于实际控制人筹划转让紫光集团有限公司部分股权的提示公告》：公司实际控制人清华控股原持有紫光集团 51% 的股权。2018 年 9 月 4 日，清华控股分别与高铁新城、海南联合签署附生效条件的《股权转让协议》，分别向其转让所持有的紫光集团 30%、6% 股权。同时，清华控股与高铁新城、海南联合三方签署《共同控制协议》，对紫光集团实施共同控制。上述事项将导致清华控股、高铁新城、海南联合在公司拥有的权益发生变动。上述权益变动完成后，公司的实际控制人将发生变更。

(3) 2018 年 10 月 26 日《紫光国芯微电子股份有限公司关于实际控制人筹划对转让紫光集团有限公司部分股权的方案进行重大调整的进展暨公司股票复牌的公告》：

目前清华控股拟对紫光集团部分股权转让方案进行重大调整，于 2018 年 10 月 25 日与苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司（以下简称“苏州高新”）和海南联合资产管理有限公司（以下简称“海南联合”）分别签署了《股权转让协议之终止协议》，并共同签署了《共同控制协议之终止协议》。同日，清华控股与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及紫光集团共同签署了《合作框架协议》，拟向深投控转让紫光集团 36% 股权，并拟约定在本次股权转让完成后由清华控股和深投控一致行动或作

出类似安排，达到将紫光集团纳入深投控合并报表范围的条件，以实现深投控对紫光集团的实际控制。基于这一安排，本次股权转让完成前后，紫光集团的国有控股的性质未发生变化。

(4) 2019 年 8 月 9 日，紫光国微收到公司间接控股股东紫光集团的通知，经各方友好协商，公司实际控制人清华控股、紫光集团与深投控共同签署《合作框架协议之终止协议》，本次终止协议签署后，紫光集团原有的股权结构不变，清华控股仍持有紫光集团 51% 股权，仍为紫光集团的控股股东及紫光国微的实际控制人。

(5) 2020 年 6 月 3 日，紫光集团发布《关于签署《合作框架协议》的提示性公告》：紫光集团的全体股东清华控股和健坤投资双方拟同意紫光集团增资扩股，引入重庆两江新区管委会指定的两江产业集团或其关联方。最终清华控股、健坤投资、两江产业集团或其关联方三方各持有紫光集团三分之一股权。截至募集说明书签署日，增资事项仍在协商、推进和落实过程中。发行人的实际控制人仍为清华控股，最终实际控制人仍为教育部。

#### **四、发行人独立性情况**

发行人与控股股东能够在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开，公司具有独立完整的业务体系及自主经营的能力。

##### **(一) 业务独立情况**

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人业务人员以公司名义办理相关事宜，发行人相对于控股股东在业务方面是独立的。

##### **(二) 人员独立情况**

发行人与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面已实现独立。公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，且高级管理人员未在控股股东或其关联方单位担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬。

##### **(三) 资产独立情况**

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括房屋建筑物、机器设备等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序。

##### **(四) 机构独立情况**

发行人设立了股东大会、董事会、监事会，完善了各项规章制度，法人治理结构规范有效。公司建立了独立于股东适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了独立完善的管理机构和生产经营体系。

#### (五) 财务独立情况

发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理、内部控制制度，独立在银行开户，独立纳税。公司独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。

综上，发行人拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，与控股股东做到了业务分开、人员独立、资产完整、机构独立、财务分开，符合独立性的要求。

### 五、发行人重要权益投资情况

#### (一) 发行人合并报表范围

截至 2020 年 6 月末，发行人纳入合并范围的子公司共 15 家，其中包括 9 家一级子公司、6 家二级子公司。

表 5-2: 纳入合并报表范围的子公司

公司名称	级次	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
<b>控股子公司</b>						
西藏拓展创芯投资有限公司	一级	拉萨市	股权投资、投资管理、投资咨询	100.00	-	设立
西藏茂业创芯投资有限公司	一级	拉萨市	股权投资、投资管理、投资咨询	100.00	-	设立
西藏微纳芯业投资有限公司	一级	拉萨市	股权投资、投资管理、投资咨询	100.00	-	设立
唐山国芯晶源电子有限公司	一级	河北省玉田县	研发、生产、销售	100.00	-	设立
北京晶源裕丰光学电子器件有限公司	一级	北京市	生产、销售	100.00	-	设立
香港同芯投资有限公司	一级	中国香港	高科技企业投资；集成电路采购、销售	100.00	-	设立
成都国微科技有限公司	一级	四川省成都市	研发、生产、销售和技术咨询	100.00	-	非同一控制下企业合并
紫光同芯微电子有限公司	一级	北京市	设计、开发、销售	100.00	-	同一控制下企业合并
深圳市国微电子有限公司	一级	广东省深圳市	设计、开发、销售	100.00	-	非同一控制下企业合并
无锡紫光微电子有限公司	二级	江苏省无锡市	设计、生产、销售	-	70.00	设立
唐山晶源电子有限公司	二级	河北省玉田县	生产、销售	-	100.00	设立

公司名称	级次	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
MARS TECHNOLOGY PTE.LTD	二级	新加坡	集成电路销售	-	100.00	设立
<b>持股不超过 50%但纳入发行人合并范围的子公司</b>						
北京紫光青藤微系统有限公司	二级	北京市	设计、开发、销售	-	35.00	设立
北京紫光安芯科技有限公司	二级	北京市	设计、开发、销售	-	35.00	设立
北京紫光芯能科技有限公司	二级	北京市	设计、开发、销售	-	35.00	设立

注 1: 2019 年 8 月 8 日, 经发行人第六届董事会第三十一次会议审议批准, 同意以公司自有资金对公司全资子公司西藏茂业创芯投资有限公司 (以下简称“茂业创芯”) 增资 1 亿元, 将其注册资本由 1.5 亿元增加到 2.5 亿元, 2020 年 4 月 17 日, 茂业创芯完成了工商变更登记手续。

注 2: 发行人分别持有紫光青藤、紫光安芯、紫光芯能 35.00%、35.00%、35.00% 的股份, 能够控制董事会, 享有紫光青藤、紫光安芯、紫光芯能的控制权, 故纳入范围入发行人的合并报表范围。

## (二) 发行人重要子公司情况介绍

发行人纳入合并范围的重要子公司介绍:

### 1、紫光同芯微电子有限公司 (同芯微电子)

同芯微电子成立于 2001 年, 是信息产业部认定的“第一批集成电路设计企业”, 专注于智能安全芯片产品的设计与销售, 提供的芯片及解决方案涵盖了移动通信、金融支付、身份识别以及信息安全等方面, 广泛应用在电信 SIM 卡、金融 IC 卡、移动支付卡、USB-Key、社保卡、城市通卡、居民健康卡、居住证以及可信计算、非接触读写机具等市场。

截至 2019 年末, 同芯微电子资产总额 16.70 亿元, 负债总额 10.47 亿元, 所有者权益 6.23 亿元。2019 年度, 该公司营业收入 12.12 亿元, 净利润 0.33 亿元。

### 2、深圳市国微电子有限公司(国微电子)

国微电子成立于 1993 年, 是首家启动的国家“909”工程的集成电路设计公司, 主要从事特种集成电路研发、生产与销售, 产品涵盖特种微处理器、特种存储器、特种可编程器件、特种总线、特种接口驱动、特种电源管理和特种定制芯片等类别, 同时可以为用户提供 ASIC/SOC 设计开发服务及国产化系统芯片级解决方案。

截至 2019 年末, 国微电子资产总额 27.27 亿元, 负债总额 9.27 亿元, 所有者权益 18.00 亿元。2019 年度, 该公司实现营业收入 10.79 亿元, 净利润 5.06 亿元。

## (三) 发行人主要参股公司情况

截至 2020 年 6 月末, 发行人不存在重要的合营企业。

截至 2020 年 6 月末，发行人有以下 2 家重要联营企业：

**表 5-3：截至 2020 年 6 月末主要参股公司情况明细表**

单位：万元、%

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市紫光同创电子有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	研发、销售、投资		36.50	权益法
西安紫光国芯半导体有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	研发、生产、销售	24.00		权益法

### 1、深圳市紫光同创电子有限公司

深圳市紫光同创电子有限公司（以下简称“紫光同创”），专业从事可编程逻辑器件研发与生产销售，是中国可编程逻辑器件领导厂商，致力于为客户提供完善的、具有自主知识产权的可编程逻辑器件平台和系统解决方案。

2020 年 1 月，紫光同创的控股股东西藏紫光新才信息技术有限公司通过天津产权交易中心公开挂牌转让其持有的紫光同创 24% 股权。经公司第六届董事会第三十八次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议批准，公司放弃了上述股权的优先受让权。天津芯翔志坚科技有限公司受让了紫光同创 24% 股权，并于 2020 年 3 月 20 日完成上述股权的工商变更手续。本次股权转让完成后，公司继续持有紫光同创 36.5% 的股权，紫光同创仍为公司的联营企业。

截至 2019 年末，深圳市紫光同创资产总额 11.63 亿元，负债总额 8.62 亿元，所有者权益 3.01 亿元。2019 年度，该公司实现营业收入 1.02 亿元，净利润-2.28 亿元。2019 年度净利润为负主要系紫光同创可编程逻辑器件研发仍处于高强度投入期，当期研发费用支出较高所致。

### 2、西安紫光国芯半导体有限公司

西安紫光国芯半导体有限公司（以下简称“西安紫光国芯”）是 DRAM 存储器设计开发、销售，以及专用集成电路设计开发服务。其 DRAM 存储器芯片和内存模组广泛应用于服务器、个人计算机、机顶盒、电视机等方面，产品实现了全球量产销售，是国产 DRAM 存储器的主要供应商。

2015 年 5 月，发行人全资子公司香港同芯投资有限公司购买了星堡有限公司持有的西安紫光国芯 25% 股权，2015 年 7 月，发行人成功中标山东华芯半导体有限公司持有的西安紫光国芯 51% 股权，2015 年 12 月，西安紫光国芯完成工商登记变更，西安紫光国芯成为发行人控股子公司。发行人于 2017 年完成剩余股权收购，购买了西安紫光国芯少数股东持有的 24% 剩余股权。

2019 年度发行人将其持有的西安紫光国芯的 76% 股权转让于北京紫光存储科技有限公司，持股比例降为 24%。本次股权转让于 2019 年 12 月底完成，自 2020 年起不再将西安紫光国芯纳入公司合并报表范围。自此，西安紫光国芯由发行人控股子公司变为重要联营企业。

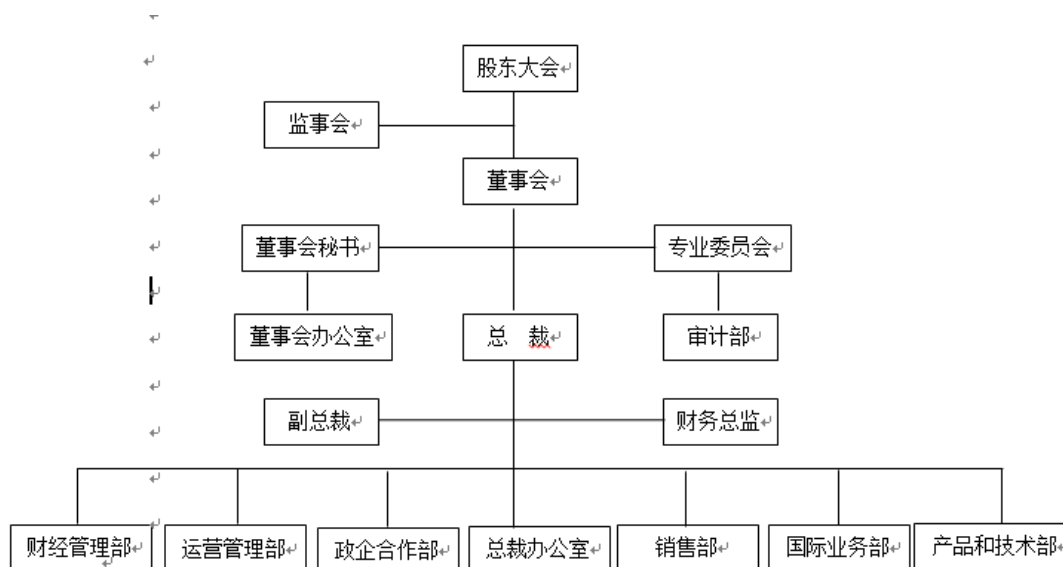
截至 2019 年末，西安紫光国芯资产总额 4.62 亿元，负债总额 4.30 亿元，所有者权益 0.32 亿元。2019 年度，西安紫光国芯实现营业收入 8.58 亿元，净利润 248.18 万元。

## 六、发行人公司治理

### (一) 发行人组织结构

发行人组织机构图及主要职能部门的职责如下：

图 5-2：截止 2020 年 6 月末发行人组织结构图



资料来源：企业提供

发行人主要职能部门包括董事会办公室、总裁办公室、财经管理部、运营管理部、政企合作部、销售部、国际业务部、产品和技术部、审计部。其中董事会办公室负责董事会事务、证券事务、投资者关系管理、市值管理、合规管理等。总裁办公室负责行政文秘、人力资源管理、法务管理、企业文化、信息化建设、安全生产管理、后勤服务等。财经管理部负责财务管理、会计核算、成本与预算管理、税务管理、资金管理、融资管理、财务风险管控、投资分析、投资并购、投后管理、项目管理等，承担综合资源协调工作组职责。运营管理部负责市场研究、运营分析、品牌管理、客户关系管理、营销规则与策略制定、市场统筹与资源协调、业务协同等，统筹协调政企合作部和销售部的具体业务，承担营销协调工作组和品牌宣传协调工作组职责。政企合作部负责政企客户需求分析，政企客户开发与维护，政企客户整体解决方案的制定和推广，行业应用拓展，政企客户

营销及服务管理等。销售部负责产品销售、销售体系建设、渠道管理、政企/行业项目落地执行、总部及产业公司的产品销售协同、渠道协同、销售团队管理等。国际业务部负责国际市场调研、国际市场营销、统筹国内产业与海外产业的业务协同、海外市场推广等。产品和技术部负责产业研究、战略管理、技术管理、研发统筹、产品规划、产品开发、技术支持等，承担技术与产品协调工作组职责。审计部负责内控管理、审计稽查、效能监察、风险管理等。

## （二）发行人治理结构

发行人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求，建立了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，建立健全了内部控制体系，加强了对内部控制的管理力度。在战略制定、重大事项决策、投融资活动、对外担保、关联交易等重大事项上规范运行。

### 1、股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序。股东大会均由公司董事会召集召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果，平等对待所有股东，保证全体股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保全体股东能够充分行使自己的权利。

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改本章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准第四十三条规定的担保事项；（13）审议批准第四十四条规定的交易事项；（14）审议批准变更募集资金用途事项；（15）审议股权激励计划；（16）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

公司第四十三条规定的对外担保行为：（1）公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。（6）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；（7）连续



十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币。(8) 深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。

公司第四十四条规定的交易事项：股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

## 2、董事和董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会成员 7 人，其中独立董事 3 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会下设三个专门委员会。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》召开会议，依法行使职权，公司董事认真出席董事会、股东大会，诚实守信、勤勉尽责地履行董事义务和责任。

董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，并制定了相应的专业委员会工作细则，明确了各专业委员会的职责权限和工作程序。

董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；决定公司因本章程第二十五条第（三）项、（五）项、（六）项规定的情形收购本公司股份的事项；（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（9）决定公司内部管理机构的设置；（10）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁（总监）、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（11）制订公司的基本管理制度；（12）制订本章程的修改方案；（13）管理公司信息披露事项；（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（15）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（16）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

## 3、监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的选聘程序选举监事，公司监事会成员 3 人，其中，职工代表监事 1 人，监事会的人

数和人员构成符合法律、法规要求。公司监事认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的精神，依《公司章程》召开监事会、出席股东大会，列席董事会，对董事会决策程序、决议事项、公司依法运作情况及公司财务状况实施监督，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了有效监督，维护了公司和全体股东的利益。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事会做出的利润分配预案、利润分配政策调整方案提出建议及发表意见；（4）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（5）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（6）对董事会、管理层就公司内部控制体系的建立健全、有效实施和定期评估进行监督；（7）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（8）向股东大会提出提案；（9）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（10）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

#### **4、发行人管理机构**

发行人设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。高级管理人员每届任期三年，总裁连聘可以连任。总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁（总监）、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。

#### **（三）发行人主要内控制度**

发行人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步

提高公司治理水平，促进公司规范运作。为了加强内部管理，发行人以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，建立了一系列内部控制制度，形成了规范的管理体系。为了各项目标的实现，发行人建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、内部稽查控制、对下属子公司的管理等，具体包括以下几个方面：

### 1、预算管理制度

为建立、完善公司内部约束机制，进一步规范公司内部管理，加强预算管理以达到强化企业管理的目的，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资本与财务管理暂行办法》等有关规定，结合公司发展战略规划和经营实际，发行人明确了公司财务预算管理应遵循坚持经济和社会效益同步的原则，进行全面预算管理。公司董事会对年度财务预算的管理工作全面负责，由公司董事会确定年度财务预算的主要控制目标方案，组织编制、审查财务预算草案，召开董事会审议通过，由公司总经理负责年度财务预算的组织实施，对全公司财务预算的执行结果负责，确保公司战略目标及年度经营目标的实现。

### 2、财务管理制度

发行人建立了财务预算控制、资金统一管理、财务状况分析、不定期财务检查等财务管理体系。为保证公司经营目标的实现，维护会计记录和管理记录的真实性、完整性，防止工作失误和滥用职权、徇私舞弊行为的发生，根据《公司法》、《会计法》等有关规定，发行人遵循权责发生制原则，对合理确认和计量主要资产、负债、所有者权益、财务报告的编制与评价、公司清算时的会计处理进行了规定。发行人明确了职责分离、钱、物、账分管的内部财务管理原则，对会计稽核工作的组织形式、具体分工、职责权限、考核奖惩等相关事宜进行了细化规定。

### 3、关联交易管理制度

发行人制定了《关联交易决策制度》，明确规定公司的关联方范围及不构成关联方的情形；规定了关联交易范围和关联交易基本原则即发行人关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。

### 4、控股子公司管理制度

发行人建立了对控股子公司控制的架构，确定控股子公司章程的主要条款，明确了母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对子公司的重大事项管理，同时负有对子公司运营进行指导、监督的义务。明确向控股子公司

委派董事、监事及重要管理人员的选任方式和职责权限等，控股子公司应接受发行人定期和不定期的财务状况、制度执行情况等内部或外聘审计。

#### 5、重大投、融资决策制度

为规范公司的权益性融资及债务性融资的管理，降低融资成本，发行人建立了投、融资业务决策环节的控制制度，对投、融资方案的拟订设计、投、融资决策程序等作出明确规定。对重大投、融资方案应当进行风险评估，实行集体决策审批制度，以降低投、融资风险。

#### 6、担保制度

为有效防范公司对外担保风险，保证公司资金安全，发行人制定了《对外担保管理规定》，发行人在财务制度中对有关对外担保进行了严格规范。公司企业在对内、对外担保事项中，坚持严格程序、审慎处置、依法担保、规范运作的原则，明确了公司对对外担保实行统一管理，对外担保必须按程序经公司董事会批准。原则上各子公司不得对除集团内公司之外的其它外部公司进行担保。

#### 7、信息披露制度

为规范公司信息披露行为，加强投资者保护机制，根据中国银行间市场交易商协会修订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《公司法》等法律法规，发行人制定了《债务融资工具信息披露事务管理办法》。制度包含信息披露内容、时间节点、流程以及相关责任认定及处罚措施，确保了公司按照银行间交易商协会要求，及时准确地披露相关信息。

#### 8、资金运营内控制度

发行人为了保护其资金的安全、完整，确保经济和会计信息的正确可靠，董事会以及各级管理层通过协调经济行为、控制经济活动，利用集团内部分工而形成了一套的相互制约、相互联系的治理体系。明确了资金存储、资金使用管理与监督等方面内容并严格按照管理办法执行。

#### 9、资金管理制度

为合理安排资金流向，保证资金安全，发行人制定了资金调度管理办法。通过建立健全资金管理内部控制制度，在公司内部建立重大资金和专项资金使用透明规范的运作机制，加强对资金管理薄弱环节的整治。公司对全资控股子公司实行资金集中管理模式，通过全面预算管理，实行资金的统一管理。

#### 10、短期资金调度应急预案

为应对可能对公司经营管理造成不利影响的突发事件，发行人设立了重大突发事件应急处置领导小组。发行人长期做好适当的货币资金储备，满足公司的正常经营周转；保留适当银行授信提款额度，满足短期提款需求；公司各部门每月

编制资金预算表，经过财务部门审核后提交相关授权人员审批，根据轻重缓急，做好短期收支计划；加强应收款项的回收；股东必要时给予短期资金周转支持。

## 七、发行人高级管理人员及员工基本情况

### (一) 董事、监事和管理层人员基本情况

发行人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及公司章程，设置了董事会、监事会和高级管理层，相关人员设置符合法律规定。

**表 5-4：截至本募集说明书签署日公司董事、监事、管理层人员基本情况**

序号	姓名	性别	职务	任期时间
董事会成员				
1	马道杰	男	董事长	2020 年 7 月至今
2	刁石京	男	董事	2020 年 7 月至今
3	吴胜武	男	董事	2020 年 5 月至今
4	缪刚	男	董事	2020 年 9 月至今
5	王立彦	男	独立董事	2017 年 3 月至今
6	崔若彤	女	独立董事	2019 年 9 月至今
7	黄文玉	男	独立董事	2020 年 5 月至今
监事会成员				
1	王志华	男	监事会主席	2017 年 3 月至今
2	郑铂	男	监事	2016 年 5 月至今
3	沈立峰	男	职工代表监事	2016 年 5 月至今
高级管理人员				
1	马道杰	男	总裁	2018 年 1 月至今
2	乔志城	男	副总裁	2016 年 4 月至今
3	苏琳琳	女	副总裁	2020 年 5 月至今
4	杜林虎	男	副总裁、董事会秘书	2010 年 10 月至今
5	杨秋平	女	财务总监	2010 年 10 月至今

### (二) 董事简历

马道杰先生：1964 年 8 月出生，中国国籍，工商管理博士，高级工程师，毕业于北京邮电大学，2004 年获得国家科技进步一等奖，享受国务院政府津贴。曾任中国联通广西分公司副总经理；联通华盛通信技术有限公司副总经理；天翼电信终端有限公司总经理、中国电信移动终端管理中心总经理；中国电信集团工会副主席；联想集团副总裁、MBG 中国业务常务副总裁；紫光集团有限公司高级副总裁。现任北京紫光存储科技有限公司董事长、北京紫光展锐科技有限公司董事、紫光宏茂微电子(上海)有限公司董事。2017 年 12 月起历任紫光国微常务副总裁、总裁、副董事长兼总裁。2020 年 7 月起，任紫光国微董事长。

刁石京先生：1962 年 4 月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级工程师。曾任电子工业部办公厅、信息产业部办公厅部长办公室副主任；国务院信息化工作

办公室综合组副组长兼机关党委副书记；工业和信息化部电子信息司副司长、司长。兼任全国信息技术标准化技术委员会副主任委员、全国音频视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会主任委员、工业和信息化部电子科技委副主任委员及通信科技委委员。历任紫光集团有限公司联席总裁、北京紫光展锐科技有限公司副董事长、北京紫光存储科技有限公司董事。2018 年 8 月至 2020 年 7 月间任紫光国微董事长。2020 年 7 月辞去紫光国微董事长一职，继续担任紫光国微董事、薪酬与考核委员会委员等职务。

吴胜武先生：1973 年 9 月出生，中国国籍，先后毕业于清华大学、华中科技大学，获博士学位。曾任鄞县人民政府副县长，宁波市鄞州区常委、副区长，宁波望春工业园区管委会党组书记、主任，宁波望春工业开发公司董事长，宁波市信息产业局党组书记、局长，宁波市海曙区人民政府区长，国家工业和信息化部电子信息司副司长等职务。现任全国青联委员、IT 工作者联谊会常务理事、浙江大学宁波理工学院、宁波工程学院、宁波大学兼职教授（硕士生导师）、浙江大学电子服务研究院客座研究员、清华大学唐仲英兼职导师。2019 年 9 月起，任紫光集团有限公司全球执行副总裁；2019 年 10 月起，任厦门紫光学大股份有限公司董事长；2019 年 12 月起，任 500 彩票网（NYSE:WBAI）公司董事会主席。2020 年 5 月起任紫光国微董事。

缪刚先生：1969 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，计算机专业学士学位、University of Dayton, OHIO 工商管理硕士。历任 NCR 中国公司高级客户经理、西安办事处总经理、中国区副总经理、大中华区总裁，紫光西部数据有限公司 CEO，紫光集团有限公司副总裁，北京紫光联盛科技有限公司总裁。2020 年 9 月起任紫光国微董事。缪刚先生现任本公司间接控股股东紫光集团有限公司下属子公司北京紫光联盛科技有限公司总裁。除此以外，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

王立彦先生：1957 年 2 月出生，中国国籍，注册会计师、经济学博士。1988 年至今在北京大学从事教学、研究工作，曾任广汇能源股份有限公司独立董事、紫光股份有限公司独立董事、北京大北农科技集团股份有限公司独立董事、北京天坛生物制品股份有限公司独立董事、大秦铁路股份有限公司独立董事、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。现任北京大学光华管理学院教授，兼任财务管理会计咨询专家、中国环境科学学会环境审计专业委员会主任、中国会计学会环境会计专业委员会副主任、中国审计学会环境审计委员会副主任、中国注册会计师协会职业道德准则委员会委员；华新水泥股份有限公司独立董事。2017 年 3 月起任公司独立董事。

崔若彤女士：1986 年 12 月生，中国国籍，硕士研究生，律师。2011 年 8 月-2014 年 5 月，任北京市高朋律师事务所律师，2014 年 6 月至今为北京市汉衡律师事务所律师。2019 年 9 月起任公司独立董事。

黄文玉先生：1956 年 7 月出生，中国国籍，管理学硕士，通信专业教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1982 年 1 月至 1994 年 4 月在乌鲁木齐市电信局工作，历任市话分局局长，体改办负责人，市话工程处副处长，副局长等职。1994 年 4 月至 2006 年 5 月，曾任新疆维吾尔自治区邮电管理局副总工程师，党组成员，副局长；党组书记，局长等职。2006 年 5 月至 2008 年 11 月曾任新疆维吾尔自治区通信管理局党组书记，局长，信息产业厅党组副书记，厅长等职。2008 年 11 月至 2016 年 8 月曾任中央纪委监察部驻工业和信息化部纪检组副组长，监察局局长等职。2017 年 1 月于工业和信息化部退休。暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2020 年 5 月起任紫光国微独立董事。

### （三）监事简历

王志华先生：1960 年 9 月出生，中国国籍，工学博士，毕业于清华大学微电子与固态电子学专业。1983 年至 1992 年历任清华大学电子工程系助教、讲师；1992 年至 1993 年为美国卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon University）访问学者；1993 年至 1994 年为比利时鲁汶天主教大学（K.U. Leuven）访问研究员；1994 年至 1997 年，任清华大学电子工程系副教授；2014 年 9 月至 2015 年 3 月，为香港科技大学访问教授。1997 年至今，任清华大学电子工程系及微电与纳电子学系教授；2015 年 12 月至今，任北京兆易创新科技股份有限公司独立董事。曾任清华大学微电子学研究所副所长（微电子与纳电子学系副系主任），现兼任中国通信学会通信集成电路专业委员会副主任委员，中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长，“教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会”委员，核心电子器件、高端通用芯片和基础软件产品重大专项咨询专家组专家，IEEE 固态电路学会执行委员会委员等职务。2017 年 3 月起任公司监事。

郑铂先生：1984 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。2006 年 8 月至 2008 年 9 月于德勤华永会计师事务所北京分所任顾问，2008 年 9 月至 2010 年 6 月于安永（中国）企业咨询有限公司任高级顾问，2010 年 6 月至 2011 年 9 月任华锐风电科技（集团）股份有限公司税务经理，2011 年 9 月至 2014 年 8 月于华润医药集团任职财务管理部经理，2014 年至今于紫光集团历任投资管理部副总经理、投资管理部总经理、投资管理中心总经理、投资合作部投资总监。现兼任紫光集团有限公司监事、紫光科技（控股）有限公司执行董事、北京紫光通信科技集团有限公司董事、厦门紫光学大股份有限公司董事。2016 年 5 月起任公司监事。

沈立峰先生：1979 年 4 月出生，中国国籍，中专学历，1998 年 7 月加入本公司从事技术工作，现任唐山国芯晶源电子有限公司五厂生产主管。2016 年 5 月起任公司职工代表监事。

#### （四）高级管理人员简历

马道杰先生：见上文“董事简历”。

乔志城先生：1972 年 9 月出生，中国国籍，经济学博士。1998 年至 2003 年任职于涌金集团，2004 年至 2010 年 8 月曾任株洲千金药业股份有限公司投资总监、总经理、副董事长；2010 年 9 月至 2013 年 6 月曾任上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总裁、首席财务官、董事会秘书；2013 年 9 月至 2015 年 4 月曾任紫光古汉集团股份有限公司董事长；2013 年 8 月至 2016 年 3 月任紫光集团有限公司高级副总裁；2017 年 5 月至 2019 年 4 月，历任厦门紫光学大股份有限公司董事、董事长。2017 年 2 月至今，兼任宏茂微电子（上海）有限公司监事。2016 年 4 月起，任公司副总裁。

苏琳琳女士：1983 年 1 月出生，中国国籍，毕业于北京航空航天大学，信息与通信系统专业博士。2012 年 7 月至 2018 年 7 月历任紫光同芯微电子有限公司安全技术主管，安全技术部经理等职；2018 年 10 月至 2020 年 5 月任北京紫光存储科技有限公司总工程师，产品规划与技术部总经理；2019 年 7 月起兼任紫光国芯微电子股份有限公司高级业务副总裁，紫光青藤微系统有限公司汽车电子事业部总经理。为北京商用密码行业协会技术组成员。2020 年 5 月起，任紫光国微副总裁。

杜林虎先生：1973 年 6 月出生，中国国籍，硕士学历，工程师。2006 年至 2010 年，在同方股份投资发展部工作，主要从事行业分析、公司研究及证券事务工作。2010 年 10 月起任公司副总裁兼董事会秘书。

杨秋平女士：1974 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、高级会计师、注册管理会计师、国际注册内部审计师。2001 年至 2008 年在信永中和会计师事务所任高级项目经理。2008 年至 2010 年任同方股份有限公司审计部副总经理。2010 年 10 月起任公司财务总监。

发行人董事、监事及高层管理人员设置符合《公司法》及公司章程的相关规定。

#### （五）员工基本情况

截至 2019 年末，发行人共有在册员工 2,192 人，其分布如下表所示。

表 5-5：截至 2019 年末公司在岗人员情况表

	单位：人
母公司在职工工的数量（人）	46



主要子公司在职员工的数量 (人)	2,103
在职员工的数量合计 (人)	2,192
当期领取薪酬员工总人数 (人)	2,192
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 (人)	13
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数 (人)
生产人员	651
销售人员	183
技术人员	1,133
财务人员	76
行政人员	149
合计	2,192
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量 (人)
硕士及以上学历	690
本科学历	698
大专及以下学历	804
合计	2,192

## 八、发行人主营业务情况

### (一) 发行人经营范围

发行人经营范围为：集成电路设计、开发、销售与技术服务；高亮度发光二级管（LED）衬底材料开发、生产、销售；生产和销售压电石英晶体器件；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

### (二) 总体经营情况

发行人主营业务包括集成电路业务和晶体元器件业务，2019 年度营业收入占比分别为 94.55%和 4.91%；2020 年 1-6 月，营业收入占比分别为 93.40%及 5.91%，其中集成电路芯片设计与销售系公司核心业务，包括智能安全芯片、特种集成电路和半导体功率器件等产品。

2019 年度公司实现营业收入 343,041.00 万元，其中智能安全芯片、存储器芯片、特种集成电路和晶体元器件业务占营业收入的比重分别为 38.52%、24.57%、31.46%和 4.91%。2020 年 1-6 月公司实现营业收入 14.64 亿元，其中智能安全芯片、存储器芯片、特种集成电路和晶体元器件业务占营业收入的比重分别为 37.58%、0.75%、55.07%和 5.91%。2020 年 1-6 月，存储器芯片收入在总收入中占比大幅下降，主要系西安紫光国芯自 2020 年 1 月起不再纳入发行人合并报表范围。西安紫光国芯 76%股权的转让于 2019 年 12 月末完成，2019 年度发行人合并范围发生变化，但 2019 年度西安紫光国芯的收入、成本仍然由发行人合并。

表 5-6: 2017 年-2019 年度及 2020 年 1-6 月营业收入分类一览表

单位: 万元

业务板块	2020 年 1-6 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
集成电路业务	136,771.14	93.40%	324,337.50	94.55%	229,698.98	93.43%	166,419.48	90.98%
智能安全芯片	55,029.38	37.58%	132,122.91	38.52%	103,626.52	42.15%	81,335.53	44.47%
特种集成电路	80,638.71	55.07%	107,927.18	31.46%	61,567.06	25.04%	51,611.01	28.22%
存储器芯片	1,103.05	0.75%	84,287.41	24.57%	64,505.40	26.24%	33,472.94	18.30%
晶体业务	8,653.42	5.91%	16,845.31	4.91%	15,680.63	6.38%	16,137.17	8.82%
其他业务	1,011.97	0.69%	1,858.18	0.54%	462.74	0.19%	352.92	0.19%
合计	146,436.53	100.00%	343,041.00	100.00%	245,842.35	100.00%	182,909.57	100.00%

近年来, 发行人主营业务结构不断优化调整, 随着集成电路业务的快速发展, 晶体业务占比不断波动。2016 年, 公司收购西安紫光国芯, 进军存储器芯片领域, 使得晶体业务占比进一步降低。

表 5-7: 2017 年-2019 年度及 2020 年 1-6 月营业成本分类一览表

单位: 万元

业务板块	2020 年 1-6 月		2019 年		2018 年		2017 年	
	成本	占比	成本	占比	成本	占比	成本	占比
集成电路	58,192.77	88.45%	205,164.08	93.08%	158,373.09	92.22%	108,774.76	88.94%
智能安全芯片	40,554.80	61.64%	102,695.05	46.59%	78,137.52	45.50%	58,317.03	47.68%
特种集成电路	16,491.64	25.07%	27,680.54	12.56%	20,644.50	12.02%	19,360.35	15.83%
存储器芯片	1,146.32	1.74%	74,788.49	33.93%	59,591.07	34.70%	31,097.38	25.43%
晶体业务	6,718.05	10.21%	13,736.78	6.23%	13,230.64	7.70%	13,444.21	10.99%
其他业务	878.51	1.34%	1,511.90	0.33%	123.25	0.07%	78.88	0.06%
合计	65,789.34	100.00%	220,412.76	100.00%	171,726.98	100.00%	122,297.84	100.00%

表 5-8: 2017 年-2019 年度及 2020 年 1-6 月营业毛利分类一览表

单位: 万元

业务板块	2020 年 1-6 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
智能安全芯片	14,474.58	26.30%	29,427.86	22.27%	25,489.00	24.60%	23,018.50	28.30%
特种集成电路	64,147.07	79.55%	80,246.64	74.35%	40,922.56	66.47%	32,250.66	62.49%
存储器芯片	-43.27	-3.92%	9,498.92	11.27%	4,914.33	7.62%	2,375.56	7.10%
晶体业务	1,935.37	22.37%	3,108.53	18.45%	2,449.99	15.62%	2,692.96	16.69%
其他业务	133.45	13.19%	343.23	18.64%	339.48	73.36%	274.04	77.65%
合计	80,647.19	55.07%	122,628.24	35.75%	73,652.63	30.02%	60,611.72	33.14%

近三年及一期发行人利润占比较大的分别是智能安全芯片和特种集成电路业务, 其他业务占比不大, 2018 年度发行人毛利率较 2017 年度有所下降的主要原因系: 1) 智能安全芯片市场产品同质化严重, 竞争更趋激烈, 导致产品利润贡献下滑, 毛利率呈下降趋势; 2) 发行人于 2016 年收购西安紫光国芯, 进军存储器芯

片领域，存储器芯片业务毛利率与其他业务相比较低；此外，公司于 2017 年对该板块业务的发展战略进行了调整，硬件产品收入规模扩张，授权收入降低，因此毛利率也有所降低。2019 年，发行人毛利率最高的特种集成电路业务收入规模大幅上升，使得营业毛利率亦有所回升。2020 年一季度公司营业毛利率大幅上升，是由于 2020 年 1 季度高毛利率的特种集成产品毛利率进一步提升且收入占比增加所致。

### （三）发行人主营业务经营模式

#### 1、集成电路业务经营模式

发行人根据经营战略和自身技术条件、资本实力等特点，聚焦于集成电路芯片设计领域，是典型的 Fabless（无晶圆）厂商，其在经营过程中将集成电路芯片的制造、封装和测试等工序外包，主要负责芯片的研发设计和市场营销等核心业务环节。

##### （1）研发模式

发行人的芯片研发设计业务主要包括对外提供研发设计服务和自有产品开发两种模式，其中对外提供研发设计服务指通过定向指定、公开竞标方式承担客户的研制任务，客户按照合同支付研发设计费，该模式主要存在于特种集成电路和存储器芯片领域；自有产品开发是指公司根据客户需求及市场发展，结合公司资源制定产品研发战略，主动开发自有产品。

公司产品研发设计流程分为可行性评估及立项、研发阶段和样品试产三个阶段：1、可行性评估及立项阶段。公司研发中心结合市场调研分析、产品技术创新诉求和目标客户新增需求，进行新产品开发提案，并组织对新产品的市场定位、功能定位、技术路线、知识产权、成本、盈利前景等进行可行性研究，并会同相关部门进行评审；立项后，研发中心安排项目负责人，并根据人员需求计划成立研发项目组，确定详细的芯片规格、技术指标、系统软硬件方案和项目进度安排，细化系统设计、电路设计、版图设计、样品生产等阶段的任务分工及进度要求，最终形成合理的产品开发计划。2、研发阶段。研发项目组将根据产品开发计划的方案要求和既定的进度安排开展研发工作，并组织解决研发过程中遇到的问题，及对设计中存在的缺陷进行修改。在完成整个研发阶段后，经总经理审批后，可进入样品试生产环节。3、样品试产阶段。研发中心委托晶圆代工厂、封装测试厂依照与量产流程相同的标准进行样品试生产。样品完成后，研发中心会组织对其进行严格的评估测试，以确认产品满足可用性、可靠性、可扩展性和完整性等要求。随后市场人员将产品提供于目标客户进行试用，由客户的技术研发部门对新产品功能的应用性进行检验，如产品在应用方面存在缺陷，需重新返回产品设计阶段。如产品各项指标均符合要求，则经过总经理审批后可进入量产阶段。总的

来看，公司对产品研发实行严格的流程管理，以确保产品研发的全过程得到科学有效的控制并达到预期目标。

## (2) 采购模式

发行人集成电路业务的采购主要包括晶圆代工以及封装、测试服务，其中晶圆代工的主要供应商为上海华虹宏力半导体制造有限公司等晶圆厂，封装、测试服务的主要供应商为中电智能卡有限责任公司等封装测试企业。

公司根据客户需求及市场发展进行系统设计和电路设计，将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体的物理版图，并根据客户订单需求，向晶圆厂下达代工订单；晶圆厂完成晶圆加工后转交给封装测试企业；封装测试企业完成芯片的封装和测试作业后形成芯片成品。

## (3) 销售模式

发行人集成电路业务主要采取直销的销售模式。对于智能安全芯片和存储器芯片领域，由于客户往往需要在公司提供的产品上进行二次开发，因此公司产品的推广销售与其本身的研究、制造等环节密不可分；对于特种集成电路领域，公司的销售对象主要为特种装备生产企业，根据现行的特种装备采购体制，公司产品必须获得相关方的设计定型批准，并进入客户的采购目录后方能进行销售。基于前述特性，在集成电路板块的销售过程中均是直面客户需求，并与客户保持持续沟通，以最终达成销售。

## 2、晶体业务经营模式

发行人晶体业务涵盖研发、生产、销售等完整的产业链环节，其采购的原材料主要是人造水晶，配套件为基座、外壳等。发行人在晶体材料加工领域具备自主开发能力，在电子元件组装生产、测试方面有二十多年的从业经验，具备电子器件组装工艺设计开发能力，具备相关专用设备的开发能力；发行人目前拥有完整的生产线，拥有石英晶片加工、SMD 晶体加工、精密器件加工、DIP 晶体加工和 LED 用蓝宝石衬底及红外窗口加工等五条生产线。

发行人除从事自有产品的生产销售外，还从事 OEM 业务，即为同行业大型制造商生产贴牌产品。发行人自有产品的销售模式主要有直销和分销两种模式，其中直销主要针对境内客户，分销主要针对出口，即通过分布在全球各地的专业贸易商向最终用户销售产品。

## (四) 发行人主营业务经营情况

2019 年度公司集成电路业务规模继续保持快速增长，行业地位进一步增强。随着技术升级迭代及创新业务的推广，综合竞争力不断提高，核心业务盈利能力持续提升，经营业绩增长显著。在联营企业紫光同创计入当期损益的研发支出大幅增加导致公司权益法核算确认的投资损失大幅增加的情况下，仍然实现了净利

润的稳定增长。晶体业务行业景气度回升，销售收入平稳增长，贡献了稳定的利润。

公司各主要业务的具体发展情况如下：

#### 集成电路业务：

公司在集成电路领域经营多年，凭借持续的研发投入和技术积累，在智能安全芯片、特种集成电路等核心产品方面已形成业内领先的技术优势，推动业务良好发展。2019 年，公司集成电路产品生产量同比增长 15.28%，销售量同比增长 33.97%，同期产销率保持较高水平；集成电路业务合计实现收入 32.43 亿元，同比增长 41.20%。凭借着巨大的市场需求及国家和地方政策的扶持等众多优势条件，我国集成电路产业近年保持较快的发展势头，但国内集成电路的自给率仍较低，未来仍将保持良好的发展态势，为公司后期集成电路业务的快速发展提供了良好的行业环境。

表 5-9：近年来发行人集成电路产、销、存情况（万颗）

项目	2019	2018	2017
生产量	199,082.24	172,688.42	156,638.12
销售量	204,793.39	152,866.32	150,562.04
库存量	53,523.99	59,235.78	39,413.69

#### 1、智能安全芯片业务

2019 年度，公司智能安全芯片产品的市场表现不俗，产品销量及销售额持续快速增长，行业地位进一步提高。2019 年度发行人持续加大研发投入，为业务持续快速发展提供了空间和保障。此外，基于安全芯片的创新业务也快速成长，有望成为该板块未来强有力的增长点。2019 年度智能安全芯片业务整体营业收入达到 13.21 亿元，同比增长 27.50%。

表 5-10：近年来发行人智能安全芯片主要产品销量情况（万颗）

产品	2019	2018	2017
SIM 卡	114,896.83	106,390.98	110,013.65
安全支付类	59,374.15	21,024.18	11,252.96
智能终端	9,888.95	2,485.72	2,316.65
功率器件	15,183.79	19,282.00	25,252.31

##### (1) 智能卡安全芯片

2019 年，全球 SIM 卡市场保持平稳，但高端卡产品发展势头良好，eSIM 市场持续增长。公司的电信 SIM 卡芯片进行了全线工艺升级，为拓展全球市场提供

了丰富的产品选型，高端 SIM 卡芯片海外市场的出货大幅增长。此外，公司与联通华盛签署战略合作协议，就 eSIM 业务展开深入合作；同时成立紫光&联通物联网联合创新中心，携手推动物联网的全面创新与安全落地。这些与运营商的物联网合作项目将提供持续的增长动力，随着 5G 网络的大力推广，电信卡安全芯片的发展空间值得期待。

身份识别安全产品主要包括第二代居民身份证芯片、交通卡芯片和居住证芯片等。2019 年，相关芯片产品的众多行业应用项目稳步推进，取得良好成绩。其中，第二代居民身份证芯片稳定供应；电子证照项目获得重大突破；助力国密交通一卡通实现全国首发，交通部标准的交通卡芯片市场份额继续保持领先；居住证芯片产品持续出货；作为首批芯片供应商，助推可信教育数字身份（教育卡）全国首发。

2019 年，公司金融支付安全产品市场取得长足进步，成为年度业绩增长的最大亮点。随着国产银行 IC 卡芯片的全面推广应用，国内市场份额大幅提高。公司凭借优异的产品和积极的市场策略，占据了领先的市场地位。同时，公司积极布局 EMV 卡市场取得成效，国内外发卡量逐步增长。此外，公司发挥产业链协同优势，结合当下消费需求，推出光感卡、蓝牙显示卡、指纹卡、定制彩色载带等个性化金融支付新品，引领金融支付市场新方向。公司还大力拓展社保卡市场，积极推进第三代社保卡的试点工作，在多个项目中取得突破，出货量快速攀升。

## （2）智能终端安全芯片

公司智能终端安全芯片产品包括 USB-Key 芯片、POS 机安全芯片和非接触读写器芯片。2019 年，USB-Key 芯片整体市场规模略有减少，公司市场份额稳中有升。得益于 ETC 项目的需求爆发，非接触读头与终端安全芯片的出货激增。传统 POS 安全模块市场稳健发展，公司保持领先优势，销量加速增长。

此外，公司依托核心芯片产品，重点布局创新产品业务，涵盖智慧生活、智能家居、汽车电子等应用领域，增长势头迅猛。凭借产业链整合能力与品牌优势，在 5G 超级 SIM 卡项目重点发力，携手广东联通实现全国首销，为用户带来全新体验，极具市场潜力，2020 年已经开始陆续在山西省、湖南省、北京市销售。汽车电子方面，THD89 系列荣获 AEC-Q100 车规认证，基于该芯片的方案已导入众多知名车企，为国六标准汽车提供信息安全保障，快速抢占市场先机。智能门锁方面，以安全芯片为核心的智能门锁安全解决方案，已得到市场高度认可，为市场扩张打下坚实的基础。

## 2、特种集成电路业务

公司特种集成电路业务主要产品包括：特种微处理器、特种可编程器件、特种存储器、特种网络总线及接口、特种模拟器件、特种 SoPC 系统器件和定制芯片等七大方向。2019 年度，该业务全年的营业收入超过 10 亿元，实现产值利润同步

增长，同时优质大客户数量不断增加，产品应用市场不断扩大，业务进入高速发展阶段。

2019 年度特种集成电路新产品的研制与开发工作持续推进，40 多款芯片完成了样品研制，还有 40 多款芯片通过了产品考核鉴定，为后续发展提供了巨大的动力。主流成熟产品的竞争力不断提高，获得用户广泛认可和大批量选用，科研、生产均进入了良性循环的规模应用阶段。

在芯片产业受到广泛关注和大力支持的背景下，特种集成电路各产品系列的市场推广均有亮眼表现，其中，多款特种微处理器产品进入了重要的嵌入式特种应用领域；特种 FPGA 产品已经广泛应用在电子系统、信息安全、自动化控制等领域，在国内取得了很高的市场占有率，最新开发的基于 2x 纳米的新一代大容量高性能 FPGA 系列产品也正在推向市场；特种存储器产品已经具有国内特种应用领域最广泛的产品系列；网络、总线及驱动产品技术先进、品种齐全、可靠性高、应用广泛，在国产飞机 C919 上也获得了应用。公司的 SoPC 平台产品继续获得市场的广泛认可和批量应用，已经成为公司增长的一个重要方向，同时，新一代的 SoPC 芯片的研制进展顺利，初步预计在年内完成研制。此外，公司在模拟器件领域也获得了长足的进步，特种电源变换类、特种电源监控类产品获得了较高的市场份额，特别是微型 DC/DC 电源变换器产品的研制水平达到了国际先进水平，目前已推出了 20 多款系列产品。

### 3、存储器芯片业务

2019 年度，DRAM 存储器芯片年初价格大跌，全年持续处于降价周期，至年底才有所好转。公司存储器芯片业务逆势增长，实现营收 8.43 亿元，同比增长超过 30%。

2019 年度公司 DRAM 存储器芯片和内存模组在服务器、个人计算机、机顶盒、电视机等方面的出货稳步增加，特别是成熟的 DDR3 的模组系列产品，成功支持了国产 CPU 系列产品的大规模产业化，成为国产 DRAM 存储器的主要供应商。基于积累的多款成熟 DRAM 芯片产品和良好的技术支持，KGD (known good die) 业务成功导入多个应用领域，实现规模量产。LPDDR4、DDR4 及模组等新产品也开始量产销售。此外，公司自主创新设计的高带宽存储器方案和产品完成设计，进行了流片，进展顺利。

集成电路集成和验证服务业务方面，尽管最大客户的业务年内出现了重大调整，公司及时响应，加强客户拓展，保持了整体业务规模的持续增长，特别是基于先进技术的国内客户增长较快，份额已达到一半以上。

表 5-11：近年来发行人存储器芯片主要产品销量情况（万颗）

产品	2019	2018	2017
DRAM 颗粒	5,263.52	3,596.80	1,322.09

DRAM 模组	95.32	33.57	15.78
---------	-------	-------	-------

#### 4、半导体功率器件业务

公司半导体功率器件业务专注于先进半导体功率器件的研发和销售，产品涵盖 500V-1200V 高压超结 MOSFET、20V-150V 中低压 SGT/TRENCH MOSFET、40V-1200V VDMOS、IGBT、IGTO、SIC 等先进半导体功率器件，产品广泛应用于节能、绿色照明、风力发电、智能电网、混合动力/电动汽车、仪器仪表、消费电子等领域，已形成领先的竞争态势和市场地位。

2019 年度在半导体功率器件市场景气度下降的情况下，得益于高压超结 MOSFET、中低压 MOSFET 的持续研发投入和市场布局，公司半导体功率器件业务的销售额仍然保持了较快增长，持续提升市场影响力，为未来的进一步快速发展打下良好的基础。

#### 5、可重构系统芯片业务

2019 年度公司 FPGA (Field-Programmable Gate Array, 现场可编程门阵列) 芯片业务研发工作进展顺利，持续扩充了 Logos 系列高性价比产品和 Compact 系列 CPLD 产品的型号，基本形成 CPLD 的全系列产品。完成了新一代 FPGA Logos2 系列更高性价比产品的设计平台建设，典型产品已成功投片。开启了下一代 FPGA Titan3 系列高带宽、大容量、高性能 FPGA 产品的研发。

公司全面推动 Titan、Logos、Compact 三个系列产品的应用及产业化工作，在通信、工控和消费类市场都有重要进展，实现批量发货，实现全年销售额过亿元。

#### 6、晶体业务

公司晶体业务的主要产品为石英晶体元器件。报告期内，受扩张产能释放和 ETC 推广的叠加影响，主力产品 SMD3225 呈现了先冷后暖的波动行情，但产品价格持续走低。另外，国际贸易摩擦的持续也对石英晶体产品的出口产生不利影响。公司深入推进精益生产管理活动，持续完善信息化管理系统，全力推动管理效能的提升，同时积极对接国内通讯厂商频率组件国产化需求，加强集团内部产业合作，大力开拓 5G 移动通讯、车用电子、工业控制、智能仪表、物联网等新市场领域。2019 年度共销售晶体元器件 3.3 亿件，实现销售收入 1.68 亿元，实现净利润 1536 万元。

2019 年度公司持续推进 5G 终端用高基频晶体和小型化晶体、5G 通讯用 OCXO1409 恒温振荡器和小型化 VCXO 振荡器等新品的开发，自动驾驶用压控频率模块 (FCXO)、网络通讯用恒温振荡器 (OCXO) 及其配套的恒温晶体和 SC-Cut 晶片、高压电网故障检测模组等新产品的产能进一步提升。“年产 7800 万件 5G 通



信终端用石英谐振器产业化”和“5G 通信设备用小型化 OCXO 及专用 IC 研发科技成果转化”项目进展顺利。

表 5-12：近年来公司晶体元器件产、销、存情况（万件）

项目	2019	2018	2017
生产量	34,188.87	27,608.89	29,258.84
销售量	33,139.90	27,766.48	30,127.85
库存量	2,929.14	1,880.17	2,037.76

#### （五）发行人业务资质获取情况

公司及下属子公司从事的集成电路设计与销售及晶体业务涉及行业准入的，均已取得相关主管部门的业务许可或者其颁发的业务许可证书或资格证书。

智能安全芯片业务方面，公司下属子公司同芯微电子已取得国家密码管理局颁发的商用密码产品销售许可证，且已根据《集成电路卡注册管理办法》的要求向国家集成电路卡注册管理机构申请并获得了唯一注册标识号；特种集成电路业务方面，公司下属子公司国微电子已取得必要的业务资质。除此以外，公司经营的业务不涉及其他行业准入。

#### （六）主要客户及供应商情况

最近三年，发行人前五大客户情况如下：

表 5-13：发行人前五大客户情况

年份	客户名称	销售金额（万元）	占总营收比例
2019 年	第一大客户	21,222.70	6.21%
	第二大客户	21,060.96	6.16%
	第三大客户	13,101.89	3.83%
	第四大客户	12,469.25	3.65%
	第五大客户	12,137.93	3.55%
	合计	<b>79,992.74</b>	<b>23.39%</b>
2018 年	第一大客户	26,971.15	10.97%
	第二大客户	11,153.83	4.54%
	第三大客户	10,950.85	4.45%
	第四大客户	7,330.49	2.98%
	第五大客户	6,855.41	2.79%
	合计	<b>63,261.72</b>	<b>25.73%</b>
2017 年	第一大客户	21,380.02	11.71%
	第二大客户	8,864.11	4.86%
	第三大客户	7,357.56	4.03%
	第四大客户	6,921.43	3.79%
	第五大客户	6,121.92	3.35%
	合计	<b>50,645.03</b>	<b>27.74%</b>

最近三年，发行人前五大供应商情况如下：

表 5-14：发行人前五大供应商情况

年份	客户名称	采购金额（万元）	占总采购额比例
2019 年	第一大供应商	37,763.45	13.35%
	第二大供应商	33,751.73	11.94%
	第三大供应商	32,904.20	11.64%
	第四大供应商	18,407.05	6.51%
	第五大供应商	18,334.84	6.48%
	合计	<b>141,161.27</b>	<b>49.92%</b>
2018 年	第一大供应商	54,037.03	28.14%
	第二大供应商	25,859.63	13.47%
	第三大供应商	13,512.17	7.04%
	第四大供应商	13,212.07	6.88%
	第五大供应商	9,242.14	4.81%
	合计	<b>115,863.04</b>	<b>60.34%</b>
2017 年	第一大供应商	40,709.57	32.34%
	第二大供应商	14,578.13	11.58%
	第三大供应商	7,945.66	6.31%
	第四大供应商	6,692.43	5.32%
	第五大供应商	5,962.12	4.74%
	合计	<b>75,887.91</b>	<b>60.29%</b>

最近三年，发行人向第一大供应商采购的金额占总采购额的比例较高，为发行人智能安全芯片业务向上海华虹宏力半导体制造有限公司采购晶圆，主要原因系集成电路制造为典型的资本和技术密集型行业，同时智能安全芯片的制造对技术要求相对较高，目前国内具备合格制造能力的晶圆厂较少，上海华虹宏力半导体制造有限公司在该领域的晶圆代工服务中具有一定的技术和成本优势。

发行人与上海华虹宏力半导体制造有限公司建立了长期稳定的合作关系，报告期内发行人向其采购金额占比较高系集成电路行业特性及当前国内集成电路产业现状所致，目前发行人也开始向 UMC、Global Foundry 等晶圆厂采购晶圆，采购渠道进一步丰富。

#### （七）发行人境内外销售情况

报告期内，发行人境内外销售情况如下：

表 5-15：发行人境内外销售情况

年份	项目	销售金额（万元）	占总销售比例
2020 年 1-6 月	境内	135,747.19	93.35%
	境外	9,677.37	6.65%
	合计	<b>145,424.56</b>	<b>100.00%</b>
2019 年	境内	278,471.73	81.18%
	境外	64,569.27	18.82%
	合计	<b>343,041.00</b>	<b>100.00%</b>

年份	项目	销售金额 (万元)	占总销售比例
2018 年	境内	184,082.98	75.02%
	境外	61,296.63	24.98%
	合计	<b>245,379.61</b>	<b>100.00%</b>
2017 年	境内	139,430.26	76.23%
	境外	43,479.32	23.77%
	合计	<b>182,909.57</b>	<b>100.00%</b>

报告期内发行人境内销售占比总体呈上升趋势。

## (八) 发行人的行业地位和经营优势

### 1、发行人的行业地位

公司长期专注于集成电路芯片设计和销售领域，经过多年的持续快速发展，已成长为国内较具竞争力的芯片设计企业之一，具有一定的行业地位优势。

主要业务领域	公司在该业务领域的行业地位
智能安全芯片	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 智能安全芯片，拥有银联芯片安全认证、国密二级认证、国际 SOGIS CC EAL5+、ISCCC EAL4+ 等国内外权威认证资质，以及 AEC-Q100 车规认证。THD89 搭载的 SM9 算法获得国密二级认证；</li> <li>✓ 2020 年 7 月，THD89 通过国际 SOGIS CC EAL6+ 安全认证，在产品安全性方面达到了国际顶尖水准；</li> <li>✓ SIM 卡市场地位领先，公司已经完成了高性能、高可靠、大容量的电信安全芯片布局；</li> <li>✓ 第二代居民身份证芯片稳定供货、居住证芯片成为市场主流产品，交通卡芯片市场份额继续保持领先，机读旅行证件、工业互联网标识等新应用逐步推广；</li> <li>✓ 金融支付安全芯片领域，公司持续提升技术水平，保持了领先的产品优势和市场优势。银行 IC 卡芯片保持领先地位，国际 SOGIS CC EAL6+ 认证的成功取得，代表了安全芯片领域的最高水平；</li> <li>✓ 社保卡芯片实现稳定出货；</li> <li>✓ USB-Key 芯片稳定出货，POS 机安全芯片、非接触读写器芯片市场保持领先地位。</li> </ul>
特种集成电路	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 国内领先的特种可编程器件产品供应商；</li> <li>✓ 持有全部特种集成电路行业资质；</li> <li>✓ 国内唯一能提供完全自主研制的百万门级可编程系统芯片和配套开发软件的公司；</li> <li>✓ 多款特种微处理器产品进入了重要的嵌入式特种应用领域；</li> <li>✓ 特种 FPGA 产品广泛应用在电子系统、信息安全、自动化控制等领域，新一代的大容量高性能 FPGA 系列产品逐步获得市场认可；</li> <li>✓ 特种存储器产品已经具有国内特种应用领域最广泛的产品系列；</li> <li>✓ 网络、总线及驱动产品技术先进、品种齐全、可靠性高，继续保持较高的市场占有率</li> <li>✓ 特种电源变换类、特种电源监控类产品均获得了较高的市场份额，微型 DC/DC 电源变换器产品的应用已经开始获得较快的增长。</li> </ul>
存储器芯片	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 业内少有的本土存储芯片公司</li> <li>✓ 承担着多个存储器领域的国家重大专项研究项目和课题</li> </ul>

主要业务领域	公司在该业务领域的行业地位
半导体功率器件业务	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 专注于先进半导体功率器件的研发和销售，产品涵盖 500V-1200V 高压超结 MOSFET、20V-150V 中低压 SGT/TRENCH MOSFET、40V-1200V VDMOS、IGBT、IGTO、SIC 等先进半导体功率器件；</li> <li>✓ 公司高压超结 MOSFET、中低压 MOSFET 等产品的研发取得新进展，销售额保持逆势增长</li> </ul>

## 2、发行人的竞争优势

报告期内，公司不断通过资源优化配置及相关业务的协同合作，推动核心业务的健康发展，核心竞争力不断增强。主要体现在以下方面：

### (1) 人才与技术优势

公司拥有集成电路行业内优秀的技术、研发和管理团队，为公司健康持续发展提供了有力保障。公司的技术、研发团队在数字、模拟及数模混合集成电路的设计和产业化方面积累了丰富的丰富经验。

公司深耕集成电路领域多年，凭借不断的技术进步和积累，在智能安全芯片、特种集成电路、存储器芯片等核心产品方面已形成业内领先的人才与技术优势，为保持产品核心竞争力奠定了坚实基础。

### (2) 研发与创新优势

公司始终重视技术创新和研发投入，注重科研创新能力与产品开发能力的结合，努力提高公司的综合技术实力，致力于提供差异化、高性价比、安全可信的产品与服务。

2019 年度，公司新申请专利 148 项，新获授权专利 70 项，其中包括欧洲发明专利 1 项。在研的新产品开发项目顺利推进，进一步提升了公司核心产品的技术优势。公司新一代高性能安全芯片获第七届中国电子信息博览会（CITE2019）创新奖；高性能生物识别安全芯片获“中国芯”优秀技术创新产品奖。

### (3) 资质与产品优势

目前公司涉足的智能安全芯片、特种集成电路设计和大容量 DRAM 存储器芯片设计及测试领域所需相关资质完备，特别是智能安全芯片，通过了银联芯片安全认证、国密二级认证、国际 SOGIS CC EAL5+、ISCCC EAL4+ 等国内外权威认证资质。

2019 年度，THD89 系列产品再次成功通过 AEC-Q100 车规认证，发力汽车电子领域。

### (4) 市场与渠道优势

公司产品应用广泛，涉及众多行业领域。通过多年的市场耕耘，公司积累了深厚的客户资源。目前公司智能卡安全芯片业务的客户包括全球领先智能卡卡商，

并服务于国内三大运营商、各大商业银行以及公安、社保、交通和卫生等行业应用，产品销往全球市场。存储器芯片设计服务业务的客户涵盖美国、日本和台湾地区的知名半导体公司，测试服务能力也达到世界主流水平。

未来，公司将继续密切跟踪市场需求，抓住物联网、人工智能、汽车电子等行业大发展的机遇，发挥技术、人才方面的优势，提供差异化的安全产品与服务，同时积极开拓集成电路产业链上下游市场，借助资本市场力量，实现公司战略目标。

## 九、发行人的在建工程与未来投资计划

### (一) 在建项目情况

截至 2020 年 6 月末，发行人主要在建项目共 5 个，分别为成都研发中心项目、SMD 小型化项目、集成电路在安装设备、小型化 OCXO 及专用 IC 研发与产业化项目和高档石英谐振器产业化项目。项目总投资合计 7.41 亿元，截至 2020 年 6 月末已累计投入 3.48 亿元，未来需投入 3.93 亿元。

截至 2020 年 6 月末，发行人在建工程合计 24,435.14 万元，较年初的 26,226.75 万元略有下降，主要系 SMD 小型化项目及集成电路在安装设备完工转入固定资产所致。

表 5-16：发行人 2020 年 6 月末重点在建项目情况

项目名称	预算数	截至 2020 年 6 月末已投金额	工程进度	资金来源
成都研发中心项目	5.26 亿元	2.36 亿元	85.00%	自筹、债券
SMD 小型化项目	4,777.00 万元	3,767.10 万元	100.00%	专项资金 860 万元，其余自筹
集成电路在安装设备	1.06 亿元	0.71 亿元	80.00%	专项资金 750 万元，其余自筹
小型化 OCXO 及专用 IC 研发与产业化项目	900.00 万元	137.26 万元	15.25%	专项资金 200 万元，其余自筹
高档石英谐振器产业化项目	5,162.00 万元	210.93 万元	4.09%	自筹
合计	7.41 亿元	3.48 亿元	-	-

上述在建工程均已取得或正在取得目前建设所需的相关批政府审批/备案，已经取得的政府审批/备案情况如下：

(1) 成都研发中心项目已经成都高新区经济运行和安全生产监管局备案，备案号“川投资备[2017-510109-70-03-223063]FGQB-1161 号”；该项目已完成环境影响评价手续，已取得成都高新区环境保护与城市综合管理执法局出具的“成高环字[2018]33 号”批复，已取得成都高新区生态环境和城市管理局出具的“成高环城审水

保[2019]56号”批复；该项目已取得成都高新区规划国土建设局出具的《关于紫光芯云项目初步设计的批复》（成高规土建房初〔2018〕18号）；该项目已取得国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证（基坑部分和主体部分）、建筑工程施工许可证（基坑部分和主体部分）等，项目正在建设中。

(2) SMD 小型化项目已取得玉田县城乡规划局同意项目选址的意见（玉规[2018]096号）；该项目已取得玉田县发展改革局出具的企业投资项目备案文件（玉发改备字[2018]70号）；该项目已完成环境影响评价手续，已取得唐山市环境保护局玉田县分局关于该项目环境影响报告表的批复（玉环表[2018]150号）；该项目固废环保措施通过竣工验收，已取得唐山市生态环境局玉田县分局出具的竣工验收批复（唐玉环表验字[2019]111号）。

(3) 集成电路在安装设备项目竣工规划验收合格，已取得玉田县自然资源和规划局出具的《建设工程规划条件核实合格证》（编号：玉资规核字第130229202004002号）；该项目已取得玉田县行政审批局出具的企业投资项目备案文件（玉审批投资备字[2019]50号）；该项目环境影响登记表已完成备案（备案号：201913022900000078）。

(4) 高档石英谐振器产业化项目已取得玉田县自然资源和规划局同意项目选址的意见（玉资规审字[2020]032号）；该项目已取得玉田县行政审批局出具的企业投资项目备案文件（玉审批投资备字[2020]309号）；该项目已完成环境影响评价手续，已取得唐山市生态环境玉田县分局出具的关于该项目环境影响报告表的批复（玉环表[2020]57号）。

小型化 OCXO 及专用 IC 研发与产业化项目不涉及政府审批/备案程序。

## **(二) 未来三年拟建项目情况**

截至本募集说明书签署日，发行人预计未来三年无重大拟建项目。

# **十、发行人的发展战略和目标**

## **(一) 发行人所处行业的发展趋势**

公司所处的集成电路产业属于新一代信息技术领域，是我国信息技术产业的基石，也是促进国民经济发展的战略性、基础性和先导性产业。近年来陆续颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》、《国家信息化发展战略纲要》、《信息产业发展指南》以及国家集成电路产业投资基金的设立，为我国集成电路产业发展提供了良好的政策环境。加上 5G 通信、大数据、人工智能、云计算、物联网、互联网+等多样化创新应用的需求驱动，我国已成为全球规模最大、增速最快的集成电路市场，集成电路产业处于发展的黄金期。

根据半导体协会统计, 2019 年我国集成电路产业规模达到 7591.30 亿元。2020 年随着下游新应用的产生, 相关行业景气度的回升, 新兴行业应用的发展将给半导体行业带来前所未有的新空间。

集成电路设计业作为产业龙头及技术和产品创新的主要环节, 在产业发展中承担重要责任。近年来, 集成电路产业中设计产业的占比不断上升, 近 7 年复合增长率为 25.7%, 核心地位逐渐稳固。根据中国产业信息网预计, 2020 年 IC 设计产业规模将达到 3546.10 亿, 占比提升为 39.35%。未来几年, 我国的集成电路设计行业仍将保持持续快速发展, 为公司战略目标的实现提供了坚实基础。

1、国内芯片企业在智能安全领域已占据重要市场地位, 未来智能终端及物联网领域的需求将带来更大发展空间。

近年来, 智能安全芯片已在诸多领域实现广泛应用, 为信息安全和民生建设提供了基础保障。产业政策层面目前已经具备了良好的生态环境, 同时, 随着国内智能安全芯片企业的技术实力和制造能力的不断增强, 国产芯片已逐步成为市场主力, 占据更加主动的竞争地位。

国产银行卡安全芯片已逐步在国内各大商业银行实现大规模商用, 全面拓展国内市场的同时, 也开始布局全球市场。同时, VISA 和 MasterCard 进入中国, EMV 卡将是未来金融安全芯片市场上新的增长点。人社部发布了第三代社保规范, 智能安全芯片将迎来新的发展机遇。

此外, 随着物联网的广泛应用, 除了智能手机及平板电脑等传统终端产品外, 日常生活中的众多电子产品都走向智能化, 且智能终端产品与物联网的有机融合也将是必然趋势, 万物互联对信息和连接的安全需求更将拉动智能安全芯片的快速增长, 未来市场空间巨大, 对智能安全芯片企业来说是一次重要的发展契机。

2、特种装备领域对安全可控的要求, 成为特种集成电路行业快速增长的驱动力。

在复杂多变的国际形势下, 加快推进核心集成电路的自主可控, 构建安全可控的信息技术体系, 是我国信息产业发展的重要保障。特种集成电路能够满足安全性、可靠性、环境适应性及稳定性的高要求, 是决定特种装备信息化性能的最关键因素。当前特种装备信息化、网络化、智能化的发展趋势, 推动特种集成电路的需求激增, 行业呈爆发式增长态势。

受制于国内的技术、供应链等多种因素, 作为特种装备核心的特种集成电路产品已经成为制约装备发展的瓶颈。为提高特种装备的安全保障能力, 特种装备生产企业掀起了对国产特种集成电路的新一轮采购浪潮。

3、我国存储器芯片市场需求广阔, 将长期保持稳定增长态势。

存储器芯片是全球芯片市场比重最大的产品之一，是信息系统的基础核心部件，也是最能代表集成电路产业规模经济效益和先进制造工艺的芯片产品。随着我国经济结构转型与消费升级，社会信息化程度日益加深，对信息化产品和服务的需求也与日俱增，存储器芯片作为信息化产品的关键芯片，将在社会信息化进程快速发展中受益。

近年来，智能手机及平板电脑市场趋于饱和，但产品更新迭代需求迫切，存储容量不断提升；另外，随着个人、企业及工业应用等对数据存储需求的增加，新型存储介质 SSD 需求持续增长，大大刺激了存储器的需求。预计未来几年仍是我国加速发展存储器行业的重要窗口期，我国存储器芯片市场将长期保持稳定增长态势。

#### 4、石英晶体行业供需波动，中高端产品获利空间较大。

2019 年，由于主要厂商前期产能增长较快，年初开始，中低端产品市场竞争就非常激烈，行业整体盈利状况不佳，而下半年，在 ETC 需求集中爆发的拉动下，市场明显好转。2020 年，在物联网、5G 通信、汽车电子等新兴需求的推动下，行业整体发展前景良好。特别是超小型化、高精度的中高端产品存在较高技术门槛，供给不足，有较好获利空间。寻求差异化发展，避免无序竞争是产业良性发展面临的课题。

### （二）发行人未来 3-5 年发展规划及工作重点

在国家政策引导、产业资本助力及市场需求推动的共同作用下，集成电路产业处于重大发展机遇期，公司聚焦战略、稳中进取，各个业务领域扎实推进，综合竞争力不断提升，整体经营规模不断突破，正迈入高质量快速发展的重要阶段。2020 年，公司将深入落实紫光集团芯云战略，围绕“确保安全、稳中进取、降本增效”的工作总体要求，坚持“以客户为中心”，坚持科技创新、业务创新、服务创新和管理创新，抓住“新基建”发展机遇，围绕 5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等新型基础设施，发挥公司在安全芯片等领域的技术优势，助力以数字经济为代表的新兴经济崛起，同时促进公司产业结构优化升级。通过持续做强做优做大，实现自主创新强、资源配置强、风险管控强、协同发展强、人才队伍强“五强”和经营业绩优、公司管治优、产品结构优、产业生态优、企业品牌优“五优”的经营管理目标，把公司打造成为盈利能力稳健，核心竞争力突出，以安全芯片为核心的硬科技领军企业。主要工作包括以下几个方面：

#### 1、持续推进技术创新及产品升级

持续加大研发投入，加强新技术、新产品的研究与应用，加强研发团队能力建设，提升核心竞争力，不断增强在细分领域的技术领先优势。同时，不断推动产品创新，加速产品迭代，致力于提供差异化的产品、服务和解决方案，满足客户个性需求。



## 2、重点突破，推进创新业务快速成长

关注科技创新带来的变革，开拓新型业务和创新商业模式，打造新的业务增长点。依托公司在创新业务的持续布局，推动 5G 超级 SIM 卡、安全智能锁、汽车电子、无线充电产品等业务快速崛起，并密切关注数字货币、网上身份认证、5G 物联网等新技术、新业务，跟进并推动创新业务落地。

## 3、创新服务，开拓新市场和新客户

坚持“客户为中心”，以安全芯片为核心，围绕身份识别、智能物联、智慧生活、芯片连接、重要元器件等安全产品，优化服务质量，创新业务模式，以领先的技术、产品与服务，成就客户价值。对标行业标杆，通过关键服务指标的提升，以服务促客户满意，打造行业口碑，突破重点行业，拓展重点客户，开拓海外客户，实现传统市场的新应用和创新市场的新客户双增长。

## 4、精耕细作，降本增效

推行精细化管理，优化经营全过程管理指标，从研发、生产制造、市场营销、资金筹措与使用、运营管理等全方面优化，开展全员降本增效活动。通过科技创新、业务创新，合理降低生产和运行成本，提升产品竞争力；通过服务创新、管理创新，加强智慧运营，优化流程，有效提升管理效能。大力推动降本增效，加强业务协同和技术创新，努力把新冠肺炎疫情的影响降到最小，同时积极关注疫情带来的新需求，研究新业态、寻找新机会。

## 5、加强协同，推动全球化发展

加强与紫光集团体系内企业的协同，强强联合，优势互补，在技术、市场、产品、客户等全方面形成合力，突破重点优势项目。全力推进重大资产重组工作，充分利用国内外两个市场、两种资源，发挥标的公司在全球的生产布局和营销网络优势，拓展海外市场，加快全球化发展步伐。

## 6、弘扬紫光文化，注重员工发展与关爱

坚持“一个紫光、彰显特色”，把紫光文化内化于心、外化于行，形成统一的企业价值观，强化团队作战能力。持续推进“员工发展与关爱工程”，精准引进专业人才，做好人才布局，加强人才培养和赋能平台搭建，完善激励与认可机制，持续探索有效的员工激励模式。

# 十一、发行人所在行业现状及前景、行业政策、竞争格局

## （一）发行人所在行业现状及前景

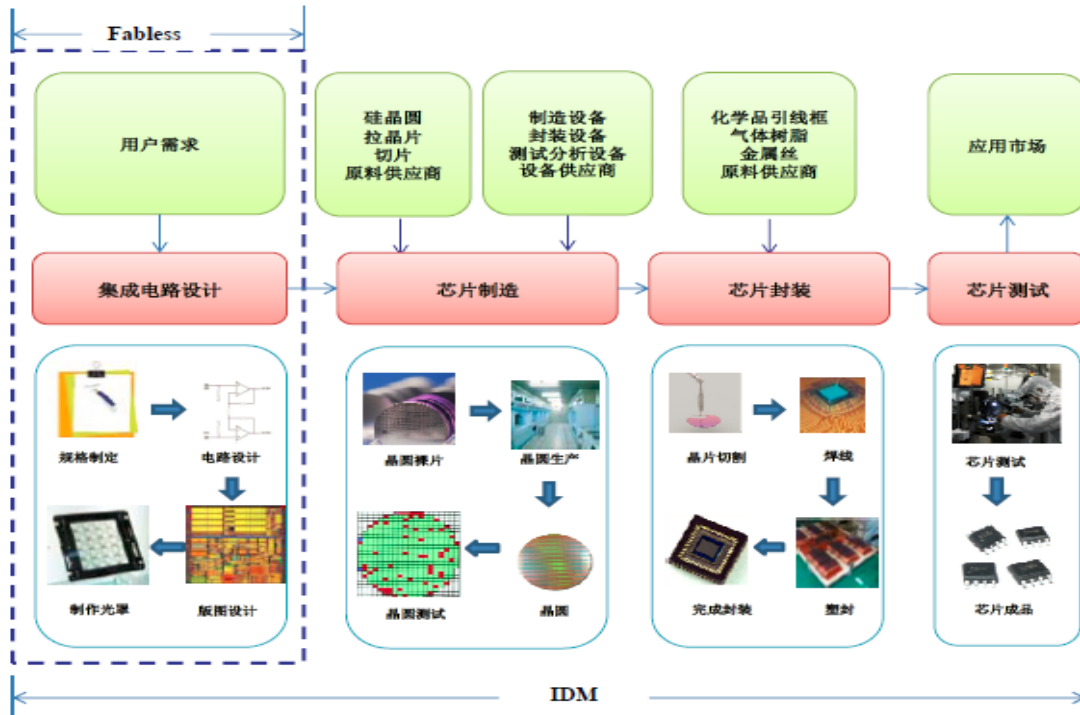
### 1、集成电路行业

集成电路（Integrated Circuit, IC），通常也称为芯片（Chip），系采用特种电路设计及加工工艺，集成于半导体晶片上的微型电子电路产品。集成电路产业

属于新一代信息技术领域，是我国“十三五”时期重点培育的战略性新兴产业之一，也是支撑“中国制造 2025”国家战略的核心产业之一。

(1) 业务模式方面：全球半导体产业存在两种商业模式，一种是 IDM (Integrated Device Manufacture, 集成器件制造) 模式，另一种是垂直分工模式。出现垂直分工模式的根本原因是半导体制造业的规模经济性。现今 IDM 厂商仍然占据主要地位，美国、日本和欧洲半导体产业主要采用这一模式，典型的 IDM 厂商包括英特尔和三星等。IDM 厂商的经营范围涵盖了 IC 设计、IC 制造和封装测试等环节，甚至延伸至下游电子终端；垂直分工商业模式源于产业的专业化分工，随着分工的逐渐深入，形成了专业的 IP (知识产权) 核、无生产线的 IC 设计 (Fabless)、晶圆代工 (Foundry) 以及封装测试 (Package Testing) 厂商。垂直分工模式中，直接面对客户需求的只有 Fabless 厂商。Fabless 为市场需求服务，IP 核、Foundry 以及封装测试企业为 Fabless 服务。

图 5-3: IDM 模式



(2) 产业链环节方面：

从集成电路的产业链环节来看，芯片设计是集成电路产业最核心的部分，其流程涉及对电子器件和器件间互连线模型的建立。该环节研发费用高，具有高技术壁垒。根据 Trend Force 统计数据，2019 年全球前 10 大无晶圆厂 IC 设计公司排名前三名分别为博通、高通和英伟达，收入规模分别为 172.46 亿美元、145.18 亿美元和 101.25 亿美元，合计营收占前十名营收总和的 61.70%，短期内领先地位不易受到撼动。

## 2、国际集成电路行业

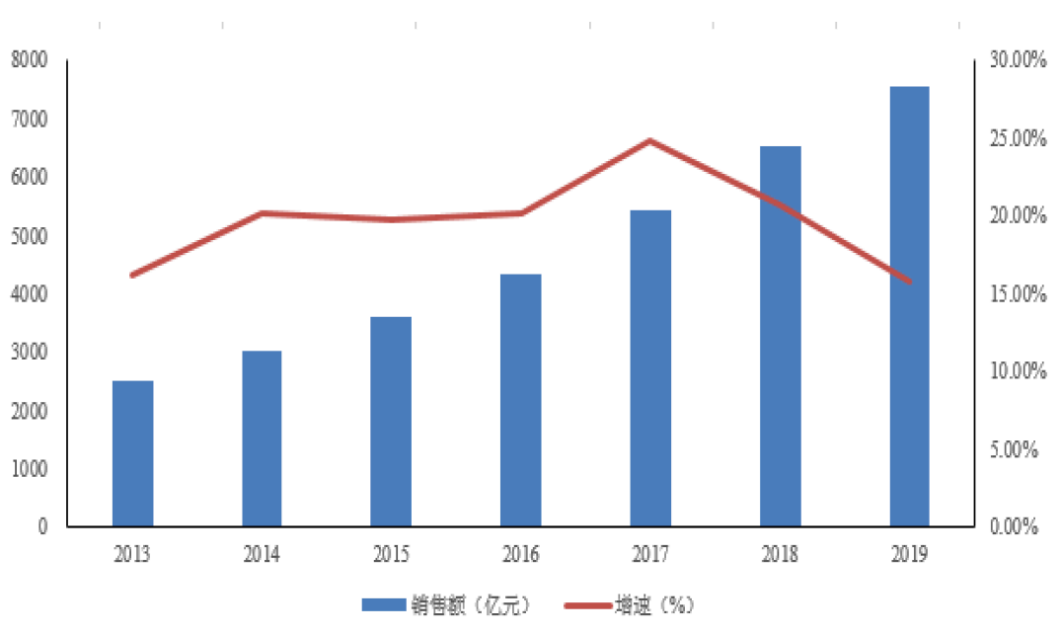
随着全球信息化、网络化和知识经济的迅速发展，集成电路产业在国民经济中的地位越来越重要，其市场规模随着应用领域的扩大相应增长。但受行业周期性波动、全球经济不景气及贸易摩擦等因素综合影响，2019 年全球半导体行业出现负增长。根据 WSTS 数据，2019 年全球半导体市场销售额 4,121.00 亿美元，同比下降 12.10%；其中集成电路下降最为明显，同比下降 14.30%；在集成电路产品中，存储器销售额同比下降 30.60%，主要系全球智能手机出货量持续下降、行业去库存导致的需求下降等影响。从全球市场竞争格局来看，美国、韩国、欧洲、中国台湾、日本和中国大陆在全球集成电路产业的市场份额占比分别为 55%、21%、7%、6%、6%和 5%，其中，美国在 IDM 和无晶圆厂 IC 设计市场都处于绝对主导地位，市占率均超过 50%；中国台湾和中国大陆在无晶圆厂 IC 设计市占率较高，分别为 17%和 15%，但在 IDM 市场份额很低，分别为 2%和低于 1%；韩国和日本表现则恰好相反，无晶圆厂 IC 设计市占率均在 1%及以下水平，但在 IDM 领域市占率仅次于美国，分别为 29%和 9%。

### 3、国内集成电路行业

相较于全球市场，2019年我国集成电路行业保持较快增长，未来随着市场需求的释放以及相关政策的扶持，我国集成电路产业有望保持良好的发展态势，同时国内企业仍需在核心技术创新研发等方面持续增进实力。

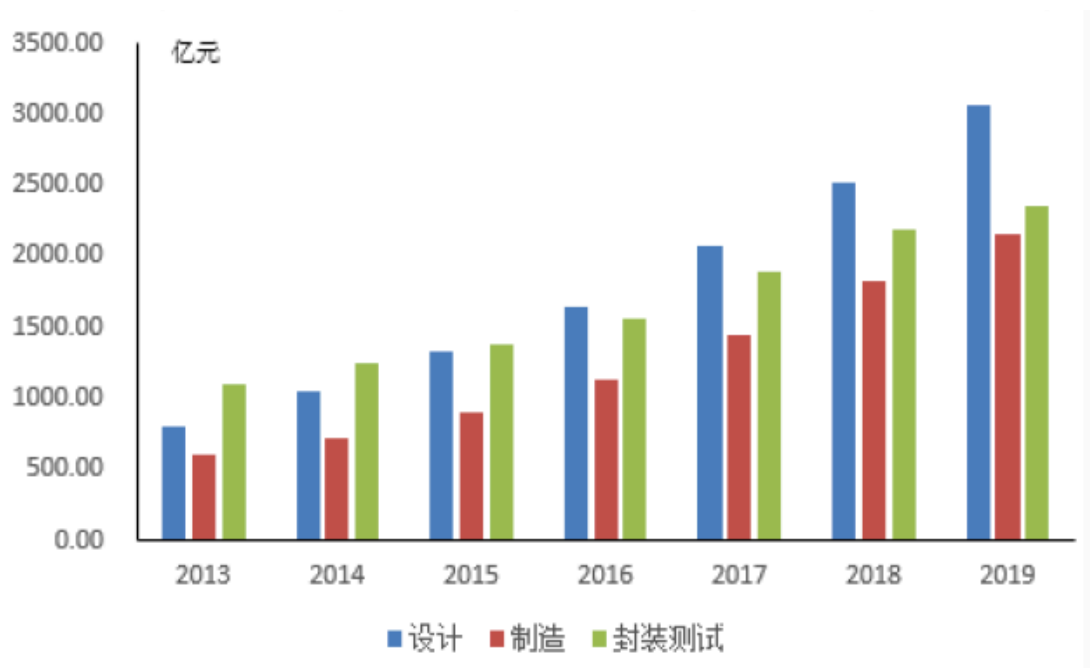
续增进实力国内市场方面，受国家相关利好政策的推动以及外资企业加大在华投资的影响，我国集成电路行业迎来快速发展时期。根据中国半导体行业协会统计数据，2019年中国集成电路产业销售额为7,562.30亿元，同比增长15.80%。我国是全球最大的集成电路消费市场，但国内集成电路自给率水平低，核心技术实力仍缺乏。我国核心芯片自给率更低，除了移动通信终端和核心网络设备有部分集成电路产品占有率超过10%外，包括计算机系统中的MPU、通用电子系统中的FPGA/EPLD和DSP、通信装备中的Embedded MPU和DSP、存储设备中的DRAM和NAND Flash、显示及视频系统中的Display Driver等，国产芯片占有率都几乎为零，国产化率亟待提升。

图 5-4：2013~2019 年我国集成电路销售额及增长率



目前，中国集成电路产业已经形成了 IC 设计、芯片制造和封装测试三业并举及支撑配套业共同发展的较为完善的产业链格局。其中集成电路设计业销售规模从 2013 年的 808.80 亿元增长至 2019 年的 3,063.50 亿元，年均复合增长率 24.85%，制造业销售规模由 2013 年的 600.90 亿元增长至 2019 年的 2,149.10 亿元，年均复合增长率 23.67%，封装测试业销售额由 2013 年的 1,098.80 亿元增长至 2019 年的 2,349.70 亿元，年均复合增长率 13.50%。

图 5-5：2013~2019 年中国集成电路各产业销售额（亿元）



虽然中国集成电路产业规模在近几年发展快速，但产业结构仍需调整。2019 年我国集成电路设计、制造和封装测试占比分别为 40.51%、28.42%和 31.07%，而

世界集成电路产业三业占比惯例为（设计业、制造业和封测业）3：4：3，呈现较为均衡发展态势，对比而言，我国集成电路行业产业结构依然不均衡，制造业比重过低。

从下游需求领域来看，计算机、通信和消费电子领域是我国集成电路产品最主要的应用市场，三者合计市场份额占比约 80%。其中，受益于移动智能设备对应用处理器、基带、射频等芯片需求量的增加，通信网络占比较高。消费电子领域增长动力主要来自于以智能手环、智能手表以及无人机为代表的智能移动设备和新兴消费电子产品的快速增长。5G 及行业应用发展将为下游需求带来持续增长动力。

随着国内工业转型升级的步伐持续加快，带动了工业控制领域的集成电路市场快速增长。在市场需求牵引以及政策与资本的支持下，中国集成电路市场将保持良好的发展势头。随着国内集成电路企业实力的提升，有望在服务器芯片等重点核心领域取得突破，国内集成电路产业的自主程度将再上一个新台阶。

## （二）行业政策

集成电路产业是国民经济支柱性行业之一，其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一，影响着社会信息化进程，因此受到各国政府的大力支持。自 2000 年以来，我国政府将集成电路产业确定为战略性产业之一，并颁布了一系列政策法规，以大力支持集成电路行业的发展。

时间	颁布部门	相关政策	主要内容
2011.1	国务院	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业，在财税、投融资、研究开发、进出口等各方面制定了许多优惠政策。
2011.12	工信部	《集成电路产业“十二五”发展规划》	规划的发展目标为到“十二五”末，产业规模再翻一番以上，关键核心技术和产品取得突破性进展，结构调整取得明显成效，产业链进一步完善，形成一批具有国际竞争力的企业，基本建立以企业为主体的产学研用相结合的技术创新体系。
2012.4	财政部、国家税务总局	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按 10% 的税率征收企业所得税。
2012.7	国务院	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	提出大力提升高性能集成电路产品自主开发能力，突破先进和特色芯片制造工

时间	颁布部门	相关政策	主要内容
		划》	艺技术，先进封装、测试技术以及关键设备、仪器、材料核心技术，加强新一代半导体材料和期间工艺技术研发，培育集成电路产业竞争新优势。
2013.3	发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2013 版	将集成电路测试设备列入战略性新兴产业重点产品目录。
2014.6	工信部	《国家集成电路产业发展推进纲要》	推动集成电路产业中的突破和整体提升，实现跨越发展，为经济发展方式转变、国家安全保障、综合国力提升提供有力支撑。纲要提出设立国家产业投资基金，主要吸引大型企业、金融机构以及社会资金，重点支持集成电路等产业发展，促进工业转型升级。支持设立地方性集成电路产业投资基金。
2015.5	国务院	《中国制造 2025》	将集成电路及专用装备作为“新一代信息技术产业”纳入大力推动突破发展的重点领域，着力提升集成电路设计水平，掌握高密度封装及三维(3D)组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力，形成关键制造装备供货能力。
2016.5	财政部、国家税务总局等	《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》	明确了在集成电路企业的税收优惠资格认定等非行政许可审批取消后，规定集成电路设计企业可以享受《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27 号)有关企业所得税减免政策需要的条件，再次从税收政策上支持集成电路设计行业的发展。
2016.7	国务院	《国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》	支持面向集成电路等优势产业领域建设若干科技创新平台，形成具有国际竞争力的高新技术产业集群；逐步形成从分析模型、优化设计、芯片制备、测试封装到可靠性研究的体系化研发平台，推动我国信息光电子器件技术和集成电路设计达到国际先进水平。
2016.12	国务院	《“十三五”国家信息化规划》	提升关键芯片设计水平，发展面向新应用的芯片。加快 16/14 纳米工艺产业化和存储器生产线建设，提升封装测试业技术水平和产业集中度，加紧布局后摩尔定律时代芯片相关领域；加快先进制造工艺、存储器、特色工艺等生产线建设，提升安全可靠 CPU、数模/模数转换芯片、数字信号处理芯片等关键产品设计开发能力和应用水平，推动封装测试、关键装备和材料等产业快速发展。
2017.1	发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016 版	“集成电路芯片制造，线宽 100nm 及以下大规模数字集成电路制造，0.5 微米及以下模拟、数模集成电路制造”列入战略性新兴产业重点产品目录。

时间	颁布部门	相关政策	主要内容
2017.6	商务部	《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》	“线宽 28nm 及以下大规模数字集成电路制造，0.11 微米及以下模拟、数模集成电路制造，MEMS 和化合物半导体集成电路制造”属于鼓励类行业。
2018.3	财政部、国家税务总局等	《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》	2018 年 1 月 1 日后投资新设的集成电路线宽小于 130 纳米，且经营期在 10 年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。2018 年 1 月 1 日后投资新设的集成电路线宽小于 65 纳米或投资额超过 150 亿元，且经营期在 15 年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。
2019.5	财政部、国家税务总局	《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》	依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

除上述鼓励产业发展的政策外，我国政府对集成电路知识产权保护也给予了高度重视。2001 年国务院颁布实施了《集成电路布图设计保护条例》（国务院令 第 300 号）及《集成电路布图设计保护条例实施细则》（国家知识产权局局长令 第 11 号），对集成电路布图设计专有权的保护客体、权利主体、权利内容、保护范围和权利限制，以及权利产生的条件、登记与保护期作了相应的规定。2001 年，国家知识产权局颁布了《集成电路布图设计行政执法办法》，明确了集成电路布图设计纠纷的处理和调解、调查取证及法律责任，为我国集成电路设计业的持续健康发展创造了良好的知识产权环境。

国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家大基金一期”）于 2014 年 9 月注册成立，截至 2018 年末，基金一期总规模已达 1,387.2 亿元，实现超募 187.2 亿元。根据国家大基金一期唯一管理人——华芯投资管理有限责任公司官方微信的公布信息，截至 2018 年 9 月 12 日，国家大基金一期有效承诺额超过 1,200 亿元，实际出资额达到 1,000 亿元，预计 2018 年底将基本完成首期规模的有效承诺，投资进度总体提前 9 个月。根据国家大基金一期投资规划，总期限为 15 年，分为投资期（2014~2019 年）、回收期（2019~2024 年）和展期（2024~2029 年）；其中 60% 的资金将投向集成电路芯片制造业，40% 投向设计、封装、原材料等产业链相关领域。此外，根据国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“国家大基金二期”，与“国家大基金一期”以下统称为“国家大基金”）已于 2019 年 10 月 22 日注册成立，注册资本达 2,041.5

亿元，预期未来几年将显著加大对国内集成电路产业的投资。除国家大基金外，多个省市和企业亦成立或准备成立集成电路投资基金，其中包括 300 亿元规模的北京市集成电路产业发展股权投资基金、500 亿元规模的上海集成电路信息产业基金和 500 亿元规模的重庆市半导体产业发展基金等，国家大基金及地方政府集成电路投资基金将为国内集成电路产业的快速发展提供资金支持。

### **（三）行业竞争格局**

市场调研机构 IC Insights 发布的报告，2019 年前十大半导体厂商（三星、英特尔、SK 海力士、台积电、Micron、博通、高通、东芝、德州仪器和英伟达）占据了整个市场 65% 的份额，且主要占领中高端市场。国内集成电路企业主要集中于中低端市场，在国内中低端市场逐步饱和的情况下，进入中高端市场是行业发展趋势。但是，国内企业进入中高端市场在技术、资金和管理方面存在较高的行业壁垒。技术方面，作为战略性产业，全球主要发达国家越来越重视半导体产业的发展，为保持其领先地位，国际半导体巨头仍会对关键技术设备、材料、高端设计和工艺技术向我国的出口进行严格控制，国内产业面临的技术挑战仍将长期存在。技术瓶颈导致国内集成电路企业竞争力不足，在终端基带芯片方面，国内华为海思和紫光展锐等企业积极参与竞争，但在服务器芯片层面，美国供应商一家独大；在通信网络的核心光芯片层面，主要为美国供应商，使得国内企业在服务器芯片和光芯片领域将受制于国外供应商及其政府部门的管制。资金以及人员方面，除少数行业领先企业具有大规模投资并运营先进生产线的的能力外，绝大部分厂商并不具备相应的条件。这样的竞争格局决定了我国企业赶超跨国领先厂商是一个长期的、艰难的过程。

随着国内市场需求的逐步释放，以及国家和地方政策的扶持，未来我国集成电路产业有望保持良好的发展态势，但仍面临国际半导体巨头掌握核心技术、垄断市场局面未有明显改善及人才短缺等外在制约因素的影响。

## **十二、其它重要事项**

### **（一）重大合并重组事项**

发行人于 2019 年 5 月 20 日披露“关于筹划重大资产重组的停牌公告”，公告紫光国微正在筹划以发行股份购买资产的方式收购间接控股股东紫光集团有限公司下属控股公司北京紫光联盛科技有限公司（以下简称“紫光联盛”）100% 股权事项。目前该事项仍处于决策阶段，交易各方正在积极协商沟通中，尚存在较大不确定性。

发行人 2019 年 5 月 31 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事发表了独立意见，关联董事就相关议案回避表决。同日，公司与本次交易各方



签署附生效条件的《紫光国芯微电子股份有限公司与北京紫光联盛科技有限公司全体股东以及北京紫光联盛科技有限公司之发行股份购买资产协议》，就本次交易的相关事项进行具体约定。

标的资产的价格初步约定为 1,800,000 万元；最终的标的资产价格应以具有证券从业资格的评估机构对标的资产截至审计评估基准日的价值进行评估而出具的评估/估值报告所确定的、并经国有资产监督管理部门备案的结果作为参考依据，由各方协商确定。

2019 年 10 月 28 日，清华大学出具《国有资产评估项目备案表》，对本次交易的标的资产评估结果予以备案。

发行人于 2019 年 10 月 30 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》等议案。

瑞信方正证券有限责任公司于 10 月 30 日出具上市公司并购重组财务顾问专业意见，上市公司发行股份向紫光神彩、紫锦海阔、紫锦海跃、红枫资本和鑫铎投资购买其合计持有的紫光联盛 100% 股权，交易作价 1,800,000.00 万元。本次交易完成后，紫光联盛将纳入上市公司合并报表范围。

北京市中伦律师事务所于 10 月 30 日出具《关于紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易》的法律意见书，北京国融兴华资产评估有限责任公司于 2019 年 9 月 20 日出具《紫光国芯微电子股份有限公司拟发行股份购买北京紫光联盛科技有限公司 100% 股权股东全部权益价值项目资产评估报告》。紫光国芯微电子股份有限公司于 2019 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体上公告了《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）等相关文件，并于 2019 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对紫光国芯微电子股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第 39 号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，结合本次重大资产重组最新进展等，公司对《重组报告书》进行了部分补充、修改与完善。

2019 年 12 月 23 日，财政部下发《财政部关于批复清华大学所属企业资产重组有关事项的函》（财教函〔2019〕43 号），同意本次资产重组事项。

2019 年 12 月 23 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关的议案。

2020 年 1 月 20 日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（193122 号）。中国证监会对公司提交的《紫光国芯微电子股

份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内提交书面回复意见。

2020 年 7 月 2 日，公司收到中国证监会《关于不予核准紫光国芯微电子股份有限公司向西藏紫光神彩投资有限公司等发行股份购买资产的决定》（证监许可〔2020〕1273 号）。中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2020 年 6 月 5 日举行 2020 年第 24 次并购重组委会议，依法对公司的发行股份购买资产方案进行了审核，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，依法对公司发行股份购买资产申请作出不予核准的决定。公司于 2020 年 7 月 3 日披露了《关于收到证监会不予核准公司发行股份购买资产的决定公告》（公告编号：2020-044）。

2020 年 7 月 9 日，公司披露了《紫光国芯微电子股份有限公司关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》：

### **1、终止本次资产重组的原因**

自中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2020 年 6 月 5 日召开 2020 年第 24 次会议对公司资产重组事项审核未通过以来，公司积极与交易对方就方案调整及项目后续安排等事项进行沟通，双方就取消本次交易达成一致意见，公司经审慎研究，决定终止本次资产重组事项。

### **2、对公司的影响**

公司现有核心业务发展良好，本次资产重组事项的终止，不会对公司现有的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不会影响公司未来的发展战略，公司仍将聚焦现有芯片设计业务，推动公司持续健康发展，以期更好地回报全体股东。

### **（二）发行人重大资产出售事宜**

截至报告期末，发行人无重大资产出售事宜。

### **（三）发行人其他重要事项说明**

发行人会计报表附注中的资产负债表日后事项及其他重要事项主要为各期重大资产重组进展情况、债券及股票发行情况、利润分配情况等，该等事项已在发行人历年年度报告中详尽披露，投资者可参阅读发行人年度报告了解详细情况，以上报告已刊登于指定的信息披露网站。

2019 年 12 月 18 日，发行人召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。

2020 年 2 月 12 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。

2020 年 7 月 8 日，发行人召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展应收账款资产证券化业务的议案》。

2020 年 7 月 24 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于开展应收账款资产证券化业务的议案》。

2020 年 9 月 7 日，发行人召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

2020 年 9 月 25 日，发行人召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

2020 年 9 月 30 日，发行人召开第七届董事会第六次会议，逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

## 第六章 发行人主要财务状况

提示：投资者在阅读以下财务信息时，应当参阅读发行人完整的财务报表、注释以及本募集说明书其他部分对于本公司财务数据和指标的解释。

### 一、发行人财务报告的编制及审计意见

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师独立审计准则审计了紫光国芯微电子股份有限公司 2017 年-2019 年度合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表、以及相关财务报表附注，以上报表均符合会计准则的要求，真实、完整地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，并分别出具了“(2018)京会兴审字第 0100M0005 号”、“(2019)京会兴审字第 0100M0010 号”和“[2020]京会兴审字第 0100M0004 号”标准无保留意见的审计报告。北京兴华会计师事务所该事务所具备证券、期货从业资格。

本募集说明书中所披露的财务数据，除非经特别说明，均来源于公司 2017 年-2019 年度经审计的财务报表当年年末数和年度数据，以及未经审计的 2020 年 6 月末财务报表。

发行人 2017-2019 年度审计报告均执行国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

### 二、财务报告使用的编制基础、会计制度及会计政策变更

#### 1、财务报告的编制基础

发行人财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

#### 2、会计制度

发行人 2017-2019 年度审计报告均执行国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

#### 3、主要会计政策变更情况

##### (1) 2017 年审计报告会计政策变更

1) 财政部于 2017 年 4 月颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“准则 42 号”), 准则 42 号自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司及其子公司根据准则 42 号有关持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报等规定, 对存在的持有待售的非流动资产及处置组进行了重新梳理, 采用未来适用法变更了相关会计政策。采用该准则未对本公司及其子公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2) 财政部于 2017 年 5 月颁布了修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(以下简称“准则 16 号(2017)”), 准则 16 号(2017)自 2017 年 6 月 12 日起施行。本公司及其子公司根据准则 16 号(2017)的规定, 对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助进行了重新梳理, 采用未来适用法变更了相关会计政策。采用该准则未对本公司及其子公司财务状况和经营成果产生重大影响。采用该准则后, 对于与企业日常活动相关的政府补助, 在计入利润表时, 按照经济业务实质由原计入“营业外收入”改为计入“其他收益”。

3) 财政部于 2017 年 12 月颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)。本公司及其子公司按照该规定编制 2017 年度财务报表。本公司及其子公司根据财会[2017]30 号规定的财务报表格式编制 2017 年度财务报表, 并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。采用财会[2017]30 号的规定未对本公司及其子公司财务状况和经营成果产生重大影响。根据该文件要求, 本公司及其子公司在利润表新增“资产处置收益”项目, 反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失, 以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在该项目内。上述项目原在“营业外收入”及“营业外支出”反映。

## (2) 2018 年审计报告会计政策变更

2018 年 6 月 15 日, 财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 对于执行企业会计准则的非金融企业中, 尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件 1 的要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。由于上述通知的修订, 公司需对原会计政策进行相应变更, 并按以上文件规定的起始日开始执行。该项会计政策变更采用追溯调整法, 公司可比年度报表已重新表述, 具体情况如下表所示:

项目	2017 年 12 月 31 日/2017 年度	2017 年 12 月 31 日/2017 年度	2017 年 12 月 31 日/2017 年度	2017 年 12 月 31 日/2017 年度
	合并	合并(经重述)	母公司	母公司(经重述)
应收票据及应收账款	108,768.20	272.36		

项目	2017 年 12 月 31 日/2017 年度	2017 年 12 月 31 日/2017 年度	2017 年 12 月 31 日/2017 年度	2017 年 12 月 31 日/2017 年度
	合并	合并(经重述)	母公司	母公司(经重述)
应收票据	27,065.95	51.96		
应收账款	81,702.24	220.40		
其他应收款	343.03	343.03	28.12	28.12
应付票据及应付账款	48,713.23	700.00		
应付票据	24,790.71			
应付账款	23,922.52	700.00		
其他应付款	435.39	462.42	69.21	69.21
应付利息	27.03			
管理费用	23,910.07	15,626.89	1,139.17	1,139.17
研发费用	8,283.18			
财务费用	2,871.77	2,871.77	408.50	408.50

本次会计政策变更仅对公司财务报表列报产生影响，对公司净利润、净资产均无影响。

### (3) 2019 年审计报告会计政策变更

1) 根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)的要求,“研发费用”项目,反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出,以及计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

2) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更: 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”)。发行人对会计政策相关内容调整如下:

① 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

② 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

- ③ 修订套期会计相关规定，更好地反映企业的风险管理活动。
- ④ 简化嵌入衍生工具的会计处理。
- ⑤ 调整非交易性权益工具投资的会计处理等。
- ⑥ 金融工具披露要求相应调整。

根据新金融准则的衔接规定，新金融准则的实施对公司 2018 年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，无需重述前期可比数据。首日执行新准则与原准则的差异，将调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益。

#### (4) 2020 年 1-6 月财务报告会计政策变更

**1) 执行新收入准则导致的会计政策变更：**财政部于 2017 年 7 月 5 日修订并发布《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。会计政策变更的主要内容如下：

- ① 将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
- ② 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确定时点的判断标准；
- ③ 识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；
- ④ 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新收入准则中衔接规定相关要求，企业可不重述前期可比数，但应当根据首次执行“新收入准则”的累积影响数，调整首次执行“新收入准则”当年年初留存收益及财务报表其他相关项目。执行新收入准则后，公司将调减 2020 年期初留存收益 4,636,057.08 元，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

首次执行新收入准则对合并财务报表的影响：

项目	2019 年 12 月 31 日余额	2020 年 1 月 1 日余额	调整金额
应收账款	131,349.83	127,371.65	-3,978.18
存货	86,397.66	95,022.44	8,624.78
递延所得税资产	2,647.31	2,646.72	-0.60
预收款项	1,487.25	6,648.74	5,161.49
应交税费	2,531.91	2,480.02	-51.89
未分配利润	282,516.73	282,053.13	-463.61

**2) 政府补助改按净额法核算的会计政策变更：**2017 年 5 月 10 日，财政部发布了财会[2017]15 号文，对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，按照财政部要求对政府补助会计政策进行了变更，政

府补助采用总额法核算。2020 年，为使会计核算更加准确，会计披露更符合企业实际情况，公司对符合净额法核算条件的政府补助改按净额法核算。该政策变更不影响期初留存收益和本期损益。本公司第七届董事会第四次会议审议通过上述变更，并调整期初、上年同期相关报表项目。

#### A:资产负债表相关项目调整

项目	2019 年 12 月 31 日余额		
	调整前	调整后	调整金额
固定资产	17,314.13	16,188.22	-1,125.91
无形资产	64,089.96	26,487.12	-37,602.84
递延收益	58,882.65	20,153.90	-38,728.75

#### B:利润表相关项目调整

项目	2019 年 1-6 月		
	调整前	调整后	调整金额
其他收益	1,797.18	322.79	-1,474.39
营业成本	100,225.75	100,048.40	-177.35
管理费用	14,562.44	14,441.23	-121.21
研发费用	6,145.62	4,969.78	-1,175.83

### 三、发行人合并报表范围变化情况

#### (一) 2017 年合并财务报表合并范围的变动

本期纳入合并范围的子公司共 18 户。2017 年度，公司新纳入合并范围子公司 1 家，子公司名称为紫光国芯微电子有限公司，为新设成立；公司不再纳入合并范围子公司 2 家，分别为于 2017 年 10 月注销的北京同芯创展投资有限公司和 2017 年 8 月注销的 Concore Investments Limited。

表 6-1: 2017 年末公司合并范围变化情况

单位：万元

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
唐山晶源电子有限公司	二级	河北省玉田县	河北省玉田县	生产销售		100.00	设立
北京晶源裕丰光学电子器件有限公司	一级	北京市	北京市	生产销售	100.00		设立
成都国微科技有限公司	一级	四川省成都市	四川省成都市	研发、生产、销售和技术咨询	100.00		非同一控制下企业合并
香港同芯投资有限公司	一级	中国香港	中国香港	高科技企业投资	100.00		设立
西藏拓展创芯投资有限公司	一级	拉萨市	拉萨市	股权投资、投资	100.00		设立



子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
				管理、投资咨询			
西藏茂业创芯投资有限公司	一级	拉萨市	拉萨市	股权投资、投资管理、投资咨询	100.00		设立
西藏微纳芯业投资有限公司	一级	拉萨市	拉萨市	股权投资、投资管理、投资咨询	100.00		设立
北京同方微电子有限公司	一级	北京市	北京市	设计、开发和销售	100.00		同一控制下企业合并
无锡同方微电子有限公司	二级	江苏省无锡市	江苏省无锡市	设计、生产和销售		70.00	设立
深圳市国微电子有限公司	一级	广东省深圳市	广东省深圳市	设计、开发和销售	100.00		非同一控制下企业合并
成都国微电子有限公司	二级	四川省成都市	四川省成都市	研发、设计、生产		100.00	非同一控制下企业合并
深圳市紫光同创电子有限公司	二级	广东省深圳市	广东省深圳市	研发、销售、投资		73.00	设立
北京晶智意达科技有限公司	三级	北京市	北京市	研发、咨询等		100.00	非同一控制下企业合并
盘古设计系统有限公司	三级	美国	美国	研发、设计		100.00	设立
西安紫光国芯半导体有限公司	一级	陕西省西安市	西安市	研发、生产、销售	51.00	25.00	非同一控制下企业合并
紫光国芯先进集成电路技术有限公司	二级	香港	香港	研发、生产、销售		100.00	非同一控制下企业合并
唐山国芯晶源电子有限公司	一级	河北省玉田县	河北省玉田县	研发、生产、销售	100.00		设立
紫光国芯微电子股份有限公司	截至本募集说明书签署日，紫光国芯微电子股份有限公司已被注销						设立

## (二) 2018 年合并财务报表合并范围的变动

1、2018 年 7 月 26 日，西藏紫光新才信息技术有限公司（以下简称“紫光新才”）和深圳市岭南聚仁股权投资合伙企业（以下简称“聚仁投资”）以现金向紫光同创增资 2.51 亿元，紫光同创注册资本由 1.50 亿元增加至 3.00 亿元，并于 2018 年 8 月 6 日完成工商变更登记。至此，紫光新才、茂业创芯持股比例均为 36.50%，聚仁投资持股比例为 27.00%，鉴于紫光新才在紫光同创董事会中拥有多数表决权，紫光同创及其全资子公司北京晶智意达科技有限公司和盘古设计系统有限公司自 2018 年 8 月起不再纳入本公司的合并报表范围。

2、2018 年 10 月，本公司之全资子公司国微电子转让其全资子公司成都国微电子有限公司 100.00% 股权，股权转让后成都国微电子不再纳入公司的合并报表范围。

## (三) 2019 年合并财务报表合并范围的变动

公司新纳入合并范围子公司 4 家，子公司名称为北京紫光青藤微系统有限公司、北京紫光芯能科技有限公司、北京紫光安芯科技有限公司和新加坡公司 MARS TECHNOLOGY PTE.LTD。

紫光青藤、紫光芯能、紫光安芯为同芯微电子的控股子公司，自设立之日起，纳入本公司合并财务报表范围。2019 年 8 月 9 日，本公司之子公司香港同芯在新加坡设立全资子公司 MARS TECHNOLOGY PTE. LTD., 自设立之日起纳入本公司合并财务报表范围。

公司不再纳入合并范围子公司 1 家，子公司名称为紫光国芯微电子有限公司，已被注销。

#### (四) 2020 年 1-6 月合并财务报表合并范围的变动

无。

### 三、发行人近三年及一期财务报表

#### (一) 发行人近三年及一期合并会计报表数据

表 6-2: 发行人近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

项目	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
流动资产：				
货币资金	102,706.98	117,925.32	113,031.88	101,467.52
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	6,976.28	-	-
应收票据	62,093.49	60,666.36	33,228.19	27,065.95
应收账款	181,823.62	131,349.83	108,948.35	81,702.24
预付款项	5,706.22	6,231.76	5,510.47	2,863.75
其他应收款	714.10	28,056.34	365.10	343.03
其中：应收利息	-	1,176.37	-	-
应收股利	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	89,893.72	86,397.66	78,858.79	60,054.48
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	1,232.53	2,834.98	559.14	786.02
<b>流动资产合计</b>	<b>444,170.66</b>	<b>440,438.53</b>	<b>340,501.92</b>	<b>274,282.99</b>
非流动资产：				
发放贷款及垫款	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	9,889.66	14,620.91
其他债权投资	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	14,057.68	9,025.46	17,851.39	-

## 紫光国芯微电子股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书

项目	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
其他权益工具投资	2,500.00	-	-	-
其他非流动金融资产	866.91	866.91	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	23,013.27	17,314.13	20,077.90	27,410.26
在建工程	24,435.14	26,226.75	5,930.72	296.91
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	-	-	-	-
无形资产	23,427.01	64,089.96	72,240.55	47,913.22
开发支出	47,539.68	39,741.89	22,862.75	73,778.31
商誉	68,567.60	68,567.60	80,668.23	80,668.23
长期待摊费用	1,700.73	485.10	831.89	1,056.25
递延所得税资产	3,544.63	2,647.31	1,498.96	675.49
其他非流动资产	34,161.23	9,242.89	248.28	
<b>非流动资产合计</b>	<b>243,813.88</b>	<b>238,208.00</b>	<b>232,100.33</b>	<b>246,419.52</b>
<b>资产总计</b>	<b>687,984.54</b>	<b>678,646.53</b>	<b>572,602.25</b>	<b>520,702.52</b>
流动负债：				
短期借款	36,804.51	25,797.14	1,251.59	24,470.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	13,424.60	33,799.36	33,221.46	24,790.71
应付账款	51,579.99	65,449.12	40,434.80	23,922.52
预收款项	6,715.94	1,487.25	2,495.45	1,837.30
应付职工薪酬	15,775.47	19,590.16	14,014.78	11,415.22
应交税费	5,691.81	2,531.91	6,650.29	4,188.31
其他应付款	8,278.75	6,766.88	1,427.23	462.42
一年内到期的非流动负债	9,000.00	2,000.00	1,000.00	13.73
其他流动负债	3,601.36	4,406.42	2,296.23	-
流动负债合计	150,872.44	161,828.24	102,791.83	91,100.21
非流动负债：	-	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-	-
长期借款	23,720.00	7,120.00	-	1,000.00
应付债券	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁负债	-	-	-	-
长期应付款	80.00	80.00	80.00	80.00
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	25,946.78	58,882.65	58,124.10	73,235.80
递延所得税负债	1,442.30	1,460.01	1,514.08	1,834.23
专项应付款	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	81,189.08	97,542.66	89,718.18	76,150.03
<b>负债合计</b>	<b>232,061.51</b>	<b>259,370.90</b>	<b>192,510.01</b>	<b>167,250.24</b>

项目	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	60,681.80	60,681.80	60,681.80	60,681.80
其它权益工具	-	-	-	-
其它权益工具: 优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	61,902.13	61,902.13	61,902.13	61,902.13
减: 库存股	-	-	-	-
其它综合收益	1,695.91	1,330.52	3,244.32	5,033.55
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	12,390.98	12,390.98	11,792.47	11,449.97
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	318,119.45	282,516.73	241,817.32	210,396.53
归属于母公司所有者权益合计	454,790.27	418,822.16	379,438.05	349,463.98
少数股东权益	1,132.76	453.47	654.19	3,988.30
<b>所有者权益合计</b>	<b>455,923.03</b>	<b>419,275.63</b>	<b>380,092.24</b>	<b>353,452.28</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>687,984.54</b>	<b>678,646.53</b>	<b>572,602.25</b>	<b>520,702.52</b>

表 6-3: 发行人近三年及一期合并利润表

单位: 万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
<b>一、营业总收入</b>	<b>146,436.53</b>	<b>343,041.00</b>	<b>245,842.35</b>	<b>182,909.57</b>
其中: 营业收入	146,436.53	343,041.00	245,842.35	182,909.57
<b>二、营业总成本</b>	<b>98,142.15</b>	<b>280,275.59</b>	<b>224,763.48</b>	<b>158,853.30</b>
其中: 营业成本	65,789.34	220,412.76	171,726.98	122,297.85
税金及附加	1,291.11	2,222.22	1,479.57	1,622.56
销售费用	9,407.08	14,047.72	9,246.50	8,163.24
管理费用	6,177.22	20,501.13	23,211.65	15,626.89
研发费用	14,280.64	20,183.93	12,922.08	8,283.18
财务费用	1,196.76	2,907.82	-9.81	2,871.77
利息收入	786.36	1,587.49	799.72	642.91
资产减值损失	2,242.75	10,047.52	6,186.52	-12.17
加: 其他收益	1,069.80	4,727.55	5,052.21	7,040.19
投资收益	-1,177.68	-9,552.44	11,169.06	268.85
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-2,927.98	-12,581.96	-348.97	-
汇兑收益	-	-	-	-
净敞口套期收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	95.27	-	-
信用减值损失	-2,008.93	-2,219.63	-	-
资产处置收益	-5.17	-0.42	8.06	-12.39
<b>三、营业利润</b>	<b>43,929.65</b>	<b>45,768.22</b>	<b>37,308.19</b>	<b>31,352.91</b>
加: 营业外收入	1.47	73.37	12.50	302.98
减: 营业外支出	124.68	224.59	17.72	33.90

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
<b>四、利润总额</b>	<b>43,806.43</b>	<b>45,617.00</b>	<b>37,302.97</b>	<b>31,621.98</b>
减：所得税费用	3,584.46	5,562.30	2,447.66	3,748.63
<b>五、净利润</b>	<b>40,221.97</b>	<b>40,054.70</b>	<b>34,855.30</b>	<b>27,873.35</b>
(一) 按经营持续性分类	-	-	-	-
1.持续经营净利润	40,221.97	40,054.70	34,855.30	27,873.35
2.终止经营净利润	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	40,192.69	40,576.18	34,797.38	27,988.72
2.少数股东损益	29.29	-521.48	57.93	-115.37
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>365.39</b>	<b>458.02</b>	<b>-1,789.23</b>	<b>6,229.77</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	365.39	458.02	-1,789.23	6,230.87
<b>七、综合收益总额</b>	<b>40,587.37</b>	<b>40,512.72</b>	<b>33,066.08</b>	<b>34,103.12</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,558.08	41,034.20	33,008.15	34,219.60
归属于少数股东的综合收益总额	29.29	-521.48	57.93	-116.48
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.66	0.67	0.57	0.46
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.66	0.67	0.57	0.46

表 6-4：发行人近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
<b>经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	92,574.98	307,231.71	239,216.63	180,257.88
收到的税费返还	2,603.81	2,723.04	2,716.56	2,284.91
收到其他与经营活动有关的现金	9,398.56	11,406.72	18,665.38	22,603.79
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>104,577.35</b>	<b>321,361.47</b>	<b>260,598.57</b>	<b>205,146.58</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	91,896.28	220,305.69	174,677.89	100,625.79
支付给职工以及为职工支付的现金	21,944.26	37,278.16	32,674.15	25,875.08
支付的各项税费	12,002.81	23,803.84	11,127.91	12,523.47
支付其他与经营活动有关的现金	3,533.66	13,380.90	10,254.35	7,698.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>129,377.00</b>	<b>294,768.59</b>	<b>228,734.29</b>	<b>146,723.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净</b>	<b>-24,799.65</b>	<b>26,592.89</b>	<b>31,864.28</b>	<b>58,423.47</b>

## 紫光国芯微电子股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
额				
<b>投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	5,765.21	4,021.99	3,141.34	-
取得投资收益收到的现金	4,381.94	958.43	2,334.10	268.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15.69	23.37	101.61	58.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	9,185.43	763.12	-
收到其他与投资活动有关的现金	26,500.00	19,300.00	125.63	1,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>36,662.84</b>	<b>33,489.22</b>	<b>6,465.81</b>	<b>1,327.49</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,904.15	51,306.75	30,422.87	30,341.99
投资支付的现金	10,450.00	3,000.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	26,714.13	27,401.02	310.72	310.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>61,068.28</b>	<b>81,707.76</b>	<b>30,733.59</b>	<b>30,651.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-24,405.44</b>	<b>-48,218.55</b>	<b>-24,267.78</b>	<b>-29,324.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	650.00	325.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	650.00	325.00	-	-
取得借款收到的现金	51,570.21	36,865.54	9,281.59	25,270.00
发行债券收到的现金	-	-	30,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	8,166.18	11,807.21	7,150.80	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>60,386.39</b>	<b>48,997.75</b>	<b>46,432.39</b>	<b>25,270.00</b>
偿还债务支付的现金	15,891.12	4,251.59	32,513.73	13,813.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,552.17	5,648.63	3,851.40	4,368.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	16.66	13,039.39	12,138.12	7,303.31
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>18,459.96</b>	<b>22,939.60</b>	<b>48,503.24</b>	<b>25,484.65</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>41,926.43</b>	<b>26,058.15</b>	<b>-2,070.85</b>	<b>-214.65</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	215.08	-569.97	1,180.10	-1,423.23
现金及现金等价物净增加额	-7,063.58	3,862.52	6,705.75	27,461.10
加：期初现金及现金等价物余额	109,568.47	105,705.95	99,000.20	71,539.11
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>102,504.89</b>	<b>109,568.47</b>	<b>105,705.95</b>	<b>99,000.20</b>

## (二) 发行人近三年及一期母公司会计报表数据

表 6-5: 发行人近三年及一期母公司资产负债表

单位: 万元

项目	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
流动资产:				
货币资金	4,717.75	26,483.40	10,576.97	17,047.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	291.27	202.43	262.57	51.96
应收账款	300.78	172.98	157.21	220.40
预付款项	0.85			246.36
其他应收款	9,792.44	34,636.83	37,017.74	28.12
存货				31.43
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	164.55	88.36	6.11	154.65
<b>流动资产合计</b>	<b>15,267.63</b>	<b>61,584.01</b>	<b>48,020.60</b>	<b>17,780.50</b>
非流动资产:				
长期股权投资	252,039.32	243,588.50	249,260.47	243,037.20
其他权益工具投资	2,500.00			
固定资产	448.30	462.80	509.25	557.85
无形资产				29.42
开发支出				1,486.60
商誉				
长期待摊费用	146.49	167.93	210.80	253.68
递延所得税资产				
其他非流动资产	33,045.00	8,000.00		
<b>非流动资产合计</b>	<b>288,179.11</b>	<b>252,219.23</b>	<b>249,980.52</b>	<b>245,364.75</b>
<b>资产总计</b>	<b>303,446.74</b>	<b>313,803.24</b>	<b>298,001.13</b>	<b>263,145.26</b>
流动负债:				
短期借款	4,115.00	10,000.00		
应付账款	5.88	424.11	60.00	700.00
应付职工薪酬	12.88	18.38	16.81	12.42
应交税费	2.78	1.06	39.59	3.29
其他应付款	9,264.58	8,600.00	2,251.55	69.21
<b>流动负债合计</b>	<b>13,401.12</b>	<b>19,043.54</b>	<b>2,367.95</b>	<b>784.93</b>
非流动负债:				
长期借款				
应付债券	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
递延收益			2,882.00	
<b>非流动负债合计</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>32,882.00</b>	
<b>负债合计</b>	<b>43,401.12</b>	<b>49,043.54</b>	<b>35,249.95</b>	<b>784.93</b>
所有者权益:				
股本	60,681.80	60,681.80	60,681.80	60,681.80
其他权益工具				

项目	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
其中：优先股				
永续债				
资本公积	121,904.41	121,904.41	121,904.41	121,904.41
减：库存股				
其他综合收益	15.24	5.03		
专项储备				
盈余公积	12,158.28	12,158.28	11,559.77	11,217.28
未分配利润	65,285.90	70,010.17	68,605.20	68,556.84
<b>所有者权益合计</b>	<b>260,045.62</b>	<b>264,759.69</b>	<b>262,751.17</b>	<b>262,360.33</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>303,446.74</b>	<b>313,803.24</b>	<b>298,001.13</b>	<b>263,145.26</b>

表 6-6：发行人近三年及一期母公司利润表

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
<b>一、营业收入</b>	<b>505.31</b>	<b>1,692.04</b>	<b>5,004.02</b>	<b>1,780.13</b>
减：营业成本	495.35	1,636.38	4,884.27	1,761.72
税金及附加	5.22	13.40	10.09	34.72
销售费用				5.21
管理费用	676.67	6,235.85	1,639.30	1,139.17
研发费用			660.38	
财务费用	340.01	-286.89	-488.27	408.50
资产减值损失			-0.13	-57.23
信用减值损失	0.10	0.02		
加：其他收益	3.52	0.12	1.97	85.00
资产处置收益			109.33	
投资收益	410.61	11,876.92	5,015.65	19,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	410.61	-22.23		
<b>二、营业利润</b>	<b>-597.91</b>	<b>5,970.31</b>	<b>3,425.33</b>	<b>17,573.04</b>
加：营业外收入		20.07		0.56
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		5.25	0.39	0.95
其中：非流动资产处置损失				
<b>三、利润总额</b>	<b>-597.91</b>	<b>5,985.12</b>	<b>3,424.94</b>	<b>17,572.66</b>
减：所得税费用				150.52
<b>四、净利润</b>	<b>-597.91</b>	<b>5,985.12</b>	<b>3,424.94</b>	<b>17,422.15</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>10.21</b>	<b>5.03</b>		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-587.70</b>	<b>5,990.16</b>	<b>3,424.94</b>	<b>17,422.15</b>

表 6-7：发行人近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
----	--------------	--------	--------	--------



## 紫光国芯微电子股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	328.61	1,814.20	4,289.98	2,156.00
收到的税费返还		-	161.80	41.37
收到其他与经营活动有关的现金	6,273.92	15,235.27	5,409.04	338.67
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>6,602.53</b>	<b>17,049.47</b>	<b>9,860.81</b>	<b>2,536.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	896.22	1,303.59	3,330.37	3,279.79
支付给职工以及为职工支付的现金	68.73	99.82	499.16	78.96
支付的各项税费	4.80	55.99	37.31	96.55
支付其他与经营活动有关的现金	7,740.28	17,523.23	6,529.89	1,041.91
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>8,710.04</b>	<b>18,982.63</b>	<b>10,396.73</b>	<b>4,497.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,107.51</b>	<b>-1,933.16</b>	<b>-535.91</b>	<b>-1,961.16</b>
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	1,364.80	13,524.27	5,085.92	18,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,696.29	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,777.76		
收到其他与投资活动有关的现金	27,300.00	26,100.00	17,202.08	1,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>28,664.80</b>	<b>56,402.03</b>	<b>23,984.29</b>	<b>19,550.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39.43	101.74	1,945.85	273.75
投资支付的现金	10,530.00	11,710.00	6,033.28	17,197.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	30,129.13	31,450.00	49,069.24	310.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>40,698.56</b>	<b>43,261.74</b>	<b>57,048.37</b>	<b>17,780.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,033.76</b>	<b>13,140.29</b>	<b>-33,064.08</b>	<b>1,769.02</b>
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	615.00	10,000.00	5,545.00	
发行债券收到的现金			30,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金				5.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>615.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>35,545.00</b>	<b>5.00</b>
偿还债务支付的现金	6,500.00		5,545.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,744.68	5,303.43	3,187.88	3,398.18
支付其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>8,244.68</b>	<b>5,303.43</b>	<b>8,732.88</b>	<b>3,398.18</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,629.68</b>	<b>4,696.57</b>	<b>26,812.12</b>	<b>-3,393.18</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5.29	2.74	317.25	-550.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-21,765.66</b>	<b>15,906.44</b>	<b>-6,470.62</b>	<b>-4,136.16</b>
加：期初现金及现金等价物余额	26,483.40	10,576.97	17,047.58	21,183.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,717.75</b>	<b>26,483.40</b>	<b>10,576.97</b>	<b>17,047.58</b>

## 四、发行人资产负债表结构分析

### (一) 资产结构分析

表 6-8：发行人近三年及一期资产结构情况

单位：万元、%

项 目	2020 年 6 月末		2019 年末		2018 年末		2017 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	102,706.98	14.93%	117,925.32	17.38%	113,031.88	19.74%	101,467.52	19.49%
交易性金融资产	-	-	6,976.28	1.03%				
应收票据	62,093.49	9.03%	60,666.36	8.94%	33,228.19	5.80%	27,065.95	5.20%
应收账款	181,823.62	26.43%	131,349.83	19.35%	108,948.35	19.03%	81,702.24	15.69%
预付款项	5,706.22	0.83%	6,231.76	0.92%	5,510.47	0.96%	2,863.75	0.55%
其他应收款	714.10	0.10%	28,056.34	4.13%	365.10	0.06%	343.03	0.07%
存货	89,893.72	13.07%	86,397.66	12.73%	78,858.79	13.77%	60,054.48	11.53%
其他流动资产	1,232.53	0.18%	2,834.98	0.42%	559.14	0.10%	786.02	0.15%
<b>流动资产合计</b>	<b>444,170.66</b>	<b>64.56%</b>	<b>440,438.53</b>	<b>64.90%</b>	<b>340,501.92</b>	<b>59.47%</b>	<b>274,282.99</b>	<b>52.68%</b>
非流动资产：								
持有至到期投资								
可供出售金融资产					9,889.66	1.73%	14,620.91	2.81%
长期股权投资	14,057.68	2.04%	9,025.46	1.33%	17,851.39	3.12%		
其他权益工具投资	2,500.00	0.36%						
其他非流动金融资产	866.91	0.13%	866.91	0.13%				
固定资产	23,013.27	3.35%	17,314.13	2.55%	20,077.90	3.51%	27,410.26	5.26%
在建工程	24,435.14	3.55%	26,226.75	3.86%	5,930.72	1.04%	296.91	0.06%
无形资产	23,427.01	3.41%	64,089.96	9.44%	72,240.55	12.62%	47,913.22	9.20%
开发支出	47,539.68	6.91%	39,741.89	5.86%	22,862.75	3.99%	73,778.31	14.17%
商誉	68,567.60	9.97%	68,567.60	10.10%	80,668.23	14.09%	80,668.23	15.49%
长期待摊费用	1,700.73	0.25%	485.10	0.07%	831.89	0.15%	1056.25	0.20%
递延所得税资产	3,544.63	0.52%	2,647.31	0.39%	1,498.96	0.26%	675.45	0.13%
其他非流动资产	34,161.23	4.97%	9,242.89	1.36%	248.28	0.04%		
<b>非流动资产合计</b>	<b>243,813.88</b>	<b>35.44%</b>	<b>238,208.00</b>	<b>35.10%</b>	<b>232,100.33</b>	<b>40.53%</b>	<b>246,419.52</b>	<b>47.32%</b>
<b>资产总计</b>	<b>687,984.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>678,646.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>572,602.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>520,702.52</b>	<b>100.00%</b>

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末，公司的流动资产分别为 274,282.99 万元、340,501.92 万元、440,438.53 万元和 444,170.66 万元，占总资产的比例分别为 52.68%、59.47%、64.90%和 64.65%；非流动资产分别为 246,419.52 万元、232,100.33 万元、238,208.00 万元和 243,813.88 万元，占总资产的比例分别为 47.32%、40.53%、

35.10%和 35.44%。随着公司持续稳定的发展，业务规模的不断扩大，公司的流动资产和资产总额均呈现稳步上升态势。

### 1、流动资产

报告期内各期末，公司流动资产情况如下：

**表 6-9：2017-2019 年末及 2020 年 6 月末发行人流动资产情况表**

单位：万元

项目	2020 年 6 月末		2019 年末		2018 年末		2017 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	102,706.98	23.12%	117,925.32	26.77%	113,031.88	33.20%	101,467.52	36.99%
交易性金融资产	-	0.00%	6,976.28	1.58%	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-	-
应收票据及应收账款	243,917.11	54.92%	192,016.19	43.60%	142,176.54	41.75%	108,768.20	39.66%
预付款项	5,706.22	1.28%	6,231.76	1.41%	5,510.47	1.62%	2,863.75	1.04%
其他应收款	714.10	0.16%	28,056.34	6.37%	365.10	0.11%	343.03	0.13%
存货	89,893.72	20.24%	86,397.66	19.62%	78,858.79	23.16%	60,054.48	21.90%
其他流动资产	1,232.53	0.28%	2,834.98	0.64%	559.14	0.16%	786.02	0.29%
<b>流动资产合计</b>	<b>444,170.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>440,438.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>340,501.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>274,282.99</b>	<b>100.00%</b>

公司流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、存货，报告期内各期末，前述流动资产合计数占流动资产总额的比重分别为 98.54%、98.11%、89.99% 和 98.28%，基本保持稳定。

#### (1) 货币资金

公司的货币资金主要为银行存款。报告期内各期末，公司货币资金余额分别为 101,467.52 万元、113,031.88 万元、117,925.32 万元和 102,706.98 万元，分别占流动资产的 36.99%、33.20%、26.77%和 23.12%。公司 2017 年末至 2020 年 6 月末货币资金基本持平。

截至 2019 年末及 2020 年 6 月末，发行人受限制货币资金分别为 8,356.85 万元和 202.09 万元，受限货币资金主要为票据、信用证保证金。具体明细如下：

**表 6-10：2019 年末及 2020 年 6 月末发行人货币资金受限情况表**

单位：万元

项目	2020 年 6 月末	2019 年末
应付票据保证金	4.69	4,055.54
信用证保证金	197.40	4,001.31
履约保函保证金	300.00	0.00
<b>合计</b>	<b>202.09</b>	<b>8,356.85</b>

整体来看，公司货币资金充足合理，能够保障正常经营活动的有序开展。同时，各期货币资金余额均足以覆盖短期有息负债余额，现金流安全性高。

#### (2) 应收票据及应收账款

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末，公司应收票据余额分别为 27,065.95 万元、33,228.19 万元、60,666.36 万元和 62,093.49 万元，分别占流动资产的 9.87%、9.76%、13.77%和 13.98%。2020 年 6 月末，应收票据余额为 62,093.49 元，较年初增长 2.35%，主要系公司集成电路业务经营规模增长所致。

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末，公司应收账款余额分别为 81,702.24 万元、108,948.35 万元、131,349.83 万元和 181,823.62 万元，占流动资产的比例分别为 29.79%、32.00%、29.82%和 40.94%。随着公司持续稳定的发展，业务规模不断扩大，公司的应收账款也呈稳步上升趋势。

表 6-11：发行人近三年及一期应收账款及计提坏账准备情况

单位：万元、%

类别	2020 年 6 月末					2019 年末				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例		金额	比例	金额	比例	
单项评估信用风险的应收账款	3,777.55	2.02	3,753.68	99.37	23.87	2,009.81	1.50	1,855.22	92.31	154.60
逾期的应收账款组合	10,046.46	5.37	812.17	8.08	9,234.29	12,601.22	9.37	1,011.86	8.03	11,589.36
未逾期的应收账款组合	173,093.86	92.61	528.40	0.31	172,565.47	119,833.24	89.13	227.37	0.19	119,605.87
其中：初始确认后信用风险未显著增加	169,504.94	90.68	169.50	0.10	169,335.44	118,747.00	88.32	118.75	0.10	118,628.25
初始确认后信用风险显著增加	3,588.92	1.92	358.89	10.00	3,230.03	1,086.24	0.81	108.62	10.00	977.62
<b>合计</b>	<b>186,917.87</b>	<b>100.00</b>	<b>5,094.25</b>	<b>2.73</b>	<b>181,823.62</b>	<b>134,444.28</b>	<b>100.00</b>	<b>3,094.45</b>	<b>2.30</b>	<b>131,349.83</b>

类别	2018 年末					2017 年末				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例		金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	103.03	0.09	103.03	100						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	110,564.88	99.91	1,616.53	1.46	108,948.35	82,923.90	99.88	1,221.65	1.47	817,02.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						98.09	0.12	98.09	100.00	
<b>合计</b>	<b>110,667.91</b>	<b>100.00</b>	<b>1,719.56</b>	<b>1.55</b>	<b>108,948.35</b>	<b>83,021.99</b>	<b>100.00</b>	<b>1,319.74</b>	<b>1.59</b>	<b>81,702.24</b>

表 6-12：2019 年末前五大应收账款和应收票据情况

单位：万元

应收单位名称	企业性质	形成原因	账龄	账面余额	回款计划	关联关系
客户一	国有	产品销售	1 年以内	22,573.38	约定回款日	非关联方

应收单位名称	企业性质	形成原因	账龄	账面余额	回款计划	关联关系
					前回款	
客户二	国有	产品销售	1 年以内	6,712.61	约定回款日 前回款	非关联方
客户三	国有	产品销售	1 年以内	6,681.57	约定回款日 前回款	非关联方
客户四	国有	产品销售	1 年以内	6,199.57	约定回款日 前回款	非关联方
客户五	国有	产品销售	1 年以内	5,589.10	约定回款日 前回款	非关联方
合 计				<b>47,756.23</b>	—	

表 6-13: 2020 年 6 月末前五大应收账款和应收票据情况

单位: 万元

应收单位名称	企业性质	形成原因	账龄	账面余额(万元)	回款计划	关联关系
客户一	国有	产品销售	1 年以内	37,090.88	约定回款日 前回款	非关联方
客户二	国有	产品销售	1 年以内	11,388.43	约定回款日 前回款	非关联方
客户三	国有	产品销售	1 年以内	10,565.83	约定回款日 前回款	非关联方
客户四	国有	产品销售	1 年以内	9,943.70	约定回款日 前回款	非关联方
客户五	国有	产品销售	1 年以内	6,700.74	约定回款日 前回款	非关联方
合 计				<b>75,689.58</b>	—	

### (3) 预付款项

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末, 公司预付款项余额分别为 2,863.75 万元、5,510.47 万元、6,231.76 万元和 5,706.22 万元, 占流动资产的比例分别为 1.04%、1.62%、1.41%和 1.28%。2018 年末预付款项余额为 5,510.47 万元, 较 2017 年末增长 92.42%, 主要是因为随着公司业务规模扩张, 公司预付款项也随之大幅增长。2020 年 6 月末预付款项余额为 5,706.22 万元, 较年初减少 8.43%。

表 6-14: 近三年发行人预付款项账龄

单位: 万元、%

账龄	2020 年 6 月末		2019 年末		2018 年末		2017 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内 (含 1 年)	5,697.43	99.85	6,197.23	99.45	5,463.96	99.16	2,784.02	97.22
1 至 2 年	8.79	0.15	29.26	0.47	13.63	0.25	27.65	0.97
2 至 3 年			0.26	0.00	5.08	0.09	16.68	0.58
3 年以上			5.00	0.08	27.81	0.50	35.40	1.23
合计	<b>5,706.22</b>	<b>100.00</b>	<b>6,231.76</b>	<b>100.00</b>	<b>5,510.47</b>	<b>100.00</b>	<b>2,863.75</b>	<b>100.00</b>

2020 年 6 月末按预付款归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 2,108.60 万元，占预付账款期末余额的 36.95%。

表 6-15：2019 年末前五大预付款项情况

单位：万元

预付单位名称	企业性质	形成原因	账龄	账面余额(万元)	关联关系
供应商一	外资	采购	1 年以内	1,191.30	非关联方
供应商二	国有控股	采购	1 年以内	543.54	非关联方
供应商三	外资	采购	1 年以内	507.30	非关联方
供应商四	国有	采购	1 年以内	353.60	非关联方
供应商五	国有	采购	1 年以内	282.64	非关联方
合 计				<b>2,878.38</b>	

表 6-16：2020 年 6 月末前五大预付款项情况

单位：万元

预付单位名称	企业性质	形成原因	账龄	账面余额(万元)	关联关系
供应商一	国有控股	采购	1 年以内	591.67	非关联方
供应商二	有限公司	采购	1 年以内	429.35	非关联方
供应商三	有限公司	采购	1 年以内	392.55	非关联方
供应商四	外资	采购	1 年以内	369.71	非关联方
供应商五	外资	采购	1 年以内	325.32	非关联方
合 计				<b>2,108.60</b>	

#### (4) 其他应收款

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末，公司其他应收款余额分别为 343.03 万元、365.10 万元、28,056.34 万元和 714.10 万元，分别占流动资产合计的 0.13%、0.11%、6.37%和 0.16%。2019 年末其他应收款较 2018 年末增加 7,584.56%，主要是系随着公司业务发展与下游客户往来款增加所致；2020 年 6 月末公司其他应收款为 714.10 万元，较 2019 年末减少 3,828.91%，主要系 2020 年初收到来自某客户 26,500.00 万元的借款及往来款回款所致。

2020 年 6 月末按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 419.43 万元，占其他应收款期末余额合计数的比例 55.13%，相应计提的坏账准备期末余额 0.42 万元。

表 6-17：发行人近三年及一期企业其他应收款按款项性质分类情况

单位：万元

款项性质	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
出口退税款			1.45	

款项性质	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
往来款	285.71	26,551.37	5.79	11.67
押金、保证金及其他	475.15	370.20	488.55	479.21
合计	<b>760.85</b>	<b>26,921.57</b>	<b>495.79</b>	<b>490.88</b>

表 6-18: 发行人 2020 年 6 月末其他应收款账龄组合

单位: 万元

类别	2020 年 6 月末
1 年以内 (含 1 年)	610.53
1-2 年	20.44
2-3 年	2.15
3-4 年	7.65
4-5 年	0.50
5 年以上	119.58
合计	<b>760.85</b>

表 6-19: 2019 年末前五大其他应收账款情况

单位: 万元

其他应收单位名称	企业性质	形成原因	账龄	账面余额	回款计划	关联关系
客户一	国有控股	借款及往来	1 年以内	26,500.00	约定回款日前回款 (2020 年年初已全部回款)	实际控制人控制的其他企业
客户二	国有控股	押金、保证金	1 年以内	190.53	约定回款日前回款	实际控制人控制的其他企业
客户三	国有控股	押金、保证金	1 年以内	39.00	约定回款日前回款	非关联方
客户四	有限责任公司	押金、保证金	1 年以内	20.82	约定回款日前回款	实际控制人控制的其他企业
客户五	国有	押金、保证金	1 年以内	17.60	约定回款日前回款	非关联方
合计				<b>26,767.95</b>	—	

表 6-20: 2020 年 6 月末前五大其他应收账款情况

单位: 万元

其他应收单位名称	企业性质	形成原因	账龄	账面余额	回款计划	关联关系
客户一	国有	押金、保证金	1 年以内	190.53	约定回款日前回款	实际控制人控制的其他企业
客户二	有限责任公司	往来款	1 年以内	96.21	约定回款日前回款	外部第三方
客户三	国有	押金、保证金	1 年以内	64.73	约定回款日前回款	涉密
客户四	国有	押金、保证金	1 年以内	39.00	约定回款日前回款	涉密
客户五	有限责任公司	往来款	1 年以内	28.96	约定回款日前回款	外部第三方

其他应收单位名称	企业性质	形成原因	账龄	账面余额	回款计划	关联关系
合计				419.43	—	

### (5) 存货

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末，公司存货余额分别为 60,054.48 万元、78,858.79 万元、86,397.66 万元和 89,893.72 万元，分别占流动资产的 21.90%、23.16%、19.62%和 20.24%。最近三年及一期，发行人存货周转率分别为 2.16、2.47、2.67 和 1.49，存货周转情况良好。

公司对存货按成本与可变现净值孰低原则计量，根据存货账面成本高于预计可变现净值的差额计提跌价准备。其中，对直接用于出售的商品存货，预计可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对需要经过加工的材料存货，预计可变现净值以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

公司存货及计提减值准备情况如下表：

表 6-21：发行人近三年及一期存货明细及计提存货跌价准备情况

单位：万元

项目	2020 年 6 月末		2019 年末		2018 年末		2017 年末	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	20,031.50	3,861.43	18,226.02	2,427.45	20,104.41	366.14	19,684.23	
库存商品	842.68		1,038.18		5,273.23		5,412.51	
委托加工物资	6,188.40		4,662.30		3,477.13		2,913.12	
在产品	39,781.78	2,217.25	33,453.20	2,364.06	19,226.45	122.41	12,456.53	
产成品	17,498.17	4,064.41	26,978.98	3,650.17	25,447.12	1,054.99	14,486.59	
发出商品	5,517.40		9,242.88		6,113.74		4,317.12	
开发成本	10,176.87		9,862.56		557.09		560.97	
周转材料					203.16		223.41	
<b>合计</b>	<b>100,036.80</b>	<b>10,143.09</b>	<b>103,464.12</b>	<b>8,441.68</b>	<b>80,402.33</b>	<b>1,543.54</b>	<b>60,054.48</b>	

### (6) 其他流动资产

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末，公司其他流动资产余额分别为 786.02 万元、559.14 万元、2,834.98 万元和 1,232.53 万元，占比分别为 0.29%、0.16%、0.64%和 0.28%。2019 年末，发行人其他流动资产较 2018 年末增长了 407.03%，主要系 2019 年末发行人待抵扣进项税额较 2018 年末有较大增长。

表 6-22：发行人近三年及一期其他流动资产情况

单位：万元

款项性质	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
待抵扣进项税	1,222.70	2,632.59	435.56	786.02
预缴城建税及教育费附加			1.96	
预缴所得税			121.62	



款项性质	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
待认证进项税	9.83	202.39		
<b>合计</b>	<b>1,232.53</b>	<b>2,834.99</b>	<b>559.14</b>	<b>786.02</b>

## 2、非流动资产

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末，公司非流动资产分别为 246,419.52 万元、232,100.33 万元、238,208.00 万元和 243,813.88 万元，分别占总资产的比例为 47.32%、40.53%、35.10%和 35.44%，占比逐年略有降低，相对较为稳定。

### (1) 长期股权投资

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末，公司长期股权投资余额分别为 0.00 万元、17,851.39 万元、9,025.46 万元和 14,057.68 万元，分别占非流动资产的 0.00%、7.69%、3.79%和 5.77%。2018 年末长期股权投资在非流动资产中占比大幅增加，主要是因为主要系紫光同创的持股比例下降转为权益法核算所致。2019 年末发行人长期股权投资较 2018 年末减少了 8,825.93 万元，同比下降 49.44%，主要系 2019 年度发行人确认对被投资单位深圳市紫光同创电子有限公司的投资损失 1.26 亿元所致，该部分投资损失主要是因为研发支出大幅增加。紫光同创系发行人联营企业，其计入发行人当期损益的研发支出大幅增加导致公司权益法核算确认的投资损失大幅增加。2020 年 6 月末，发行人长期股权投资较 2019 年末增加了 5,032.22 万元，增长 55.76%，主要系发行人 2020 年 1-6 月对联营企业紫光同创增加投资 7,950.00 万元。

表 6-23：截至 2020 年 6 月末发行人长期股权投资情况

单位：万元

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额	账面价值
			增加投资	合并范围变化引起的变动	权益法下确认的投资损失	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他				
九江佳华压电晶体材料有限公司	255.00	147.39									147.39		147.39	
深圳市紫光同创电子有限公司	21,900.00	8,269.43	7,950.00		3,338.59						12,880.84			12,880.84
西安紫光国芯半导体有限公司	4,353.12	756.03			-410.61	10.21					1,176.84			1,176.84
<b>合计</b>	<b>26,508.12</b>	<b>9,172.85</b>	<b>7,950.00</b>		<b>2,927.98</b>	<b>10.21</b>					<b>14,205.08</b>		<b>147.39</b>	<b>14,057.68</b>

## (2) 固定资产

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末,公司固定资产余额分别为 27,410.26 万元、20,077.90 万元、17,314.13 万元和 23,013.27 万元, 分别占非流动资产的 11.12%、8.65%、7.27%和 9.44%。公司固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备和电子设备及其他等构成。2018 年末, 发行人固定资产较 2017 年末减少 36.52%, 主要系固定资产减值准备增加 4,213.37 万元所致。公司 2011 年上线的 LED 用蓝宝石生长与衬底加工产线设备计提的减值准备。因蓝宝石衬底市场供过于求, 且设备升级换代, 该产线产能利用率不足, 公司多次产线盘活也未达到预期效果, 根据卓信大华估报字(2018)第 2017 号估值报告, 计提了减值。2020 年 6 月末, 发行人固定资产较 2019 年末增加了 5,699.14 万元, 增长 32.92%, 主要系发行人 SMD 小型化项目完工转入固定资产所致。

2020 年发行人对符合净额法核算条件的政府补助由总额法改为净额法核算所致。该会计政策调整对发行人资产负债表中固定资产科目产生影响。发行人在 2020 年 1-6 月财务报表中对 2019 年末固定资产项目进行相应调整: 调整前 2019 年末固定资产为 17,314.13 万元, 调整后 2019 年末固定资产为 16,188.22 万元。

**表 6-24: 发行人近三年及一期固定资产明细表**

单位: 万元

项目	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
房屋及建筑物	7,367.43	7,442.18	7,794.25	8,163.30
机器设备	12,800.58	6,889.73	7,316.50	14,077.51
运输工具	333.93	360.25	291.98	376.88
电子设备及其他	2,511.33	2,621.97	4,675.17	4,792.56
<b>合计</b>	<b>23,013.27</b>	<b>17,314.13</b>	<b>20,077.90</b>	<b>27,410.26</b>

## (3) 在建工程

2017 年-2019 年及 2020 年 6 月末, 公司在建工程余额分别为 296.91 万元、5,930.72 万元、26,226.75 万元和 24,435.14 万元。2018 年末公司在建工程较 2017 年末增加 5,633.81 万元, 占比增加 0.98%; 2019 年末公司在建工程余额较年初增长 342.22%, 主要系成都芯云中心和生产线项目投入增加所致。2020 年 6 月末, 发行人在建工程较 2019 年末略有下降, 主要系 SMD 小型化项目完工转入固定资产所致。

表 6-25：发行人近三年及一期在建工程情况

单位：万元

项目	2020 年 6 月末			2019 年末			2018 年末			2017 年末		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成都研发中心项目	23,581.02		23,581.02	16,892.57		16,892.57	5,928.08		5,928.08	296.91		296.91
SMD 小型化项目				3,734.53		3,734.53						
待安装设备	505.93		505.93	5,599.64		5,599.64	2.64		2.64			
小型化 OCXO 及专用 IC 研发与产业化项目	137.26		137.26									
高档石英谐振器产业化项目	210.93		210.93									
合计	24,435.14		24,435.14	26,226.75		26,226.75	5,930.72		5,930.72	296.91		296.91

表 6-26：截至 2020 年 6 月末发行人各公司在建工程变动表

项目名称	预算数	期初金额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
成都研发中心项目	52,571.38	16,892.57	6,688.45			23,581.02	44.86%	85.00%	1,221.79	445.57	6.32%	自筹、债券
SMD 小型化项目	4,777.00	3,734.53	32.56	2,907.10	860.00		78.86%	100.00%				自筹
集成电路在安装设备	10,600.00	5,599.64	1,538.36	5,767.59	864.47	505.93	67.42%	80.00%				自筹
小型化 OCXO 及专用 IC 研发与产业化项目	900.00		137.26			137.26	15.25%	15.25%				自筹
高档石英谐振器产业化项目	5,162.00		210.93			210.93	4.09%	4.09%				自筹
合计		26,226.75	8,607.56	8,674.69	1,724.47	24,435.14			1,221.79	445.57		/

#### (4) 无形资产

公司的无形资产主要由土地使用权、非专利技术 etc 构成。2017 年-2019 年及 2020 年 6 月末，公司无形资产分别为 47,913.22 万元、72,240.55 万元、64,089.96 万元和 23,427.01 万元，分别占非流动资产的 19.44%、31.12%、26.91%和 9.61%。2018 年末发行人无形资产较 2017 年末同比增长 50.77%，主要系集成电路业务开发支出转入无形资产所致；2020 年 6 月末，发行人无形资产较 2019 年末末减少 63.45%，主要系 2020 年公司对符合净额法核算条件的政府补助由总额法改为净额法核算所致。该会计政策调整对发行人资产负债表中无形资产科目产生影响。发行人在 2020 年 1-6 月财务报表中对 2019 年末无形资产项目进行相应调整：调整前 2019 年末无形资产为 64,089.96 万元，调整后 2019 年末无形资产为 26,487.11 万元。发行人 2020 年 6 月末无形资产较调整后的 2019 年末无形资产有小幅下降，下降 11.55%。

最近三年及一期末，公司无形资产明细情况如下：

表 6-27：发行人近三年及一期无形资产明细

单位：万元

项目	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
土地使用权	8,659.63	8,765.56	8,977.43	9,189.30
软件	269.29	2,084.15	2,330.73	1,474.00
商标			237.50	275.50
专利技术	137.50	0.01	474.25	844.71
非专利技术	14,360.59	53,240.24	60,220.64	36,129.72
专有使用权			-	-
合计	<b>23,427.01</b>	<b>64,089.96</b>	<b>72,240.55</b>	<b>47,913.22</b>

#### (二) 负债结构分析

表 6-28：发行人近三年及一期负债结构情况

单位：万元；%

项目	2020 年 6 月末		2019 年末		2018 年末		2017 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	36,804.51	15.86%	25,797.14	9.95%	1,251.59	0.65%	24,470.00	14.63%
应付票据及应付账款	65,004.59	28.01%	99,248.48	38.27%	73,656.26	38.26%	48,713.23	29.13%
预收款项	6,715.94	2.89%	1,487.25	0.57%	2,495.45	1.30%	1,837.30	1.10%
应付职工薪酬	15,775.47	6.80%	19,590.16	7.55%	14,014.78	7.28%	11,415.22	6.83%
应交税费	5,691.81	2.45%	2,531.91	0.98%	6,650.29	3.45%	4,188.31	2.50%
其他应付款	8,278.75	3.57%	6,766.88	2.61%	1,427.23	0.74%	462.42	0.28%
一年内到期的非流动负债	9,000.00	3.88%	2,000.00	0.77%	1,000.00	0.52%	13.73	0.01%
其他流动负债	3,601.37	1.55%	4,406.42	1.70%	2,296.23	1.19%		0.00%
流动负债合计	<b>150,872.44</b>	<b>65.01%</b>	<b>161,828.24</b>	<b>62.39%</b>	<b>102,791.83</b>	<b>53.40%</b>	<b>91,100.21</b>	<b>54.47%</b>

项目	2020 年 6 月末		2019 年末		2018 年末		2017 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
非流动负债：								
长期借款	23,720.00	10.22%	7,120.00	2.75%			1,000.00	0.60%
应付债券	30,000.00	12.93%	30,000.00	11.57%	30,000.00	15.58%		0.00%
长期应付款	80.00	0.03%	80.00	0.03%	80.00	0.04%	80.00	0.05%
预计负债								
递延所得税负债	1,442.30	0.62%	1,460.01	0.56%	1,514.08	0.79%	1,834.23	1.10%
递延收益	25,946.78	11.18%	58,882.65	22.70%	58,124.10	30.19%	73,235.80	43.79%
其他非流动负债								
<b>非流动负债合计</b>	<b>81,189.08</b>	<b>34.99%</b>	<b>97,542.66</b>	<b>37.61%</b>	<b>89,718.18</b>	<b>46.60%</b>	<b>76,150.03</b>	<b>45.53%</b>
<b>负债合计</b>	<b>232,061.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>259,370.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>192,510.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>167,250.24</b>	<b>100.00%</b>

随着发行人的资产规模的不断扩大，发行人对外融资规模增长较快，债务规模逐年上升，截至 2017-2019 年末以及 2020 年 6 月末，发行人的负债总额分别为 167,250.24 万元、192,510.01 万元、259,370.90 万元和 232,061.51 万元，发行人流动负债占总负债的比例分别为 54.47%、53.40%、62.39%和 65.01%，非流动负债占总负债的比例为 45.53%、46.60%、37.61%和 34.99%。截至 2020 年 6 月末，流动负债合计 150,872.44 万元，占比较年初减少 6.77%，发行人流动负债和非流动负债占比较为平均，债务结构合理。

## 1、流动负债

### (1) 短期借款

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末,公司短期借款余额分别为 24,470.00 万元、1,251.59 万元、25,797.14 万元和 36,804.51 万元,分别占流动负债的 26.86%、1.22%、15.94%和 24.39%。

2018 年末公司短期借款余额较 2017 年末减少 23,218.41 万元，降幅 94.88%，占比流动负债减少 25.64%，主要是由于公司发行债券募集资金后偿还了大部分短期借款；2019 年较年初增长 1,961.15%，2020 年 6 月末较年初增长 42.67%，主要系公司集成电路业务经营规模增长，运营资金需求增加所致。

表 6-29：发行人近三年及近一期短期借款分类情况表

单位：万元

项目	2020 年 6 月末	2019 年末	2017 年末	2016 年末
信用借款	35,929.53	22,915.05	200.00	24,100.00
保证借款	600.00	600.00	1,051.59	370.00
质押借款	274.98	2,282.10		
<b>合计</b>	<b>36,804.51</b>	<b>25,797.13</b>	<b>1,251.59</b>	<b>24,470.00</b>

### (2) 应付票据及应付账款

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末,公司应付票据余额分别为 24,790.71 万元、33,221.46 万元、33,799.36 万元和 13,424.60 万元,分别占流动负债的 27.21%、32.32%、20.89%和 8.90%。2017-2019 年发行人应付票据总体呈上升趋势,主要系公司集成电路业务规模增长,采购金额增加及采用银行承兑汇票支付比例上升所致。2020 年 6 月末应收票据较年初减少 60.28%,主要系偿还到期票据所致。

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末,公司应付账款余额分别为 23,922.52 万元、40,434.80 万元、65,449.12 万元和 51,579.99 万元,分别占流动负债的 26.26%、39.34%、40.44%和 34.19%。随着公司业务规模的不断提升,公司的采购金额也逐渐上升,应付账款也保持稳步上升态势。2018 年末应付账款余额较 2017 年末增加 16,512.28 万元,增幅 69.02%,主要系公司集成电路业务规模增长采购增加所致;2019 年末公司应付账款余额较年初增加 25,014.32 万元,增幅 61.86%,主要系公司集成电路业务规模增长采购增加所致。2020 年 6 月末公司应付账款余额较年初减少 13,869.13 万元,减幅 21.19%。

表 6-30: 发行人近三年及一期应付账款账龄分类情况表

单位: 万元

项目	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
1 年以内(含 1 年)	46,412.71	61,930.44	36,407.53	22,288.06
1-2 年	2,990.19	2,113.06	2,587.86	318.05
2-3 年	779.95	28.68	155.90	24.77
3 年以上	1,397.13	1,376.93	1,283.52	1,291.63
合计	<b>51,579.99</b>	<b>65,449.12</b>	<b>40,434.80</b>	<b>23,922.52</b>

表 6-31: 2020 年 6 月末发行人账龄超过 1 年的重要应付账款

单位: 万元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	1,384.04	设备尾款
供应商二	1,346.03	尚未结算
供应商三	457.48	设备尾款
供应商四	354.30	工程结算未办妥
供应商五	240.00	项目未结束
合计	<b>3,781.85</b>	--

#### (7) 其他应付款

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末,公司其他应付款分别为 462.42 万元、1,427.23 万元、6,766.88 万元和 8,278.75 万元,分别占流动负债的 0.51%、1.39%、4.18%和 5.49%。2018 年末公司其他应付款较 2017 年末增加 964.81 万元,增幅 208.64%,主要是有房屋租赁押金,尚未到期;2019 年末公司其他应付款余额为 6,766.88 万元,较年初增长 374.13%,主要系计提资产重组中介费所致。

表 6-32: 发行人近三年及一期按款项性质分类的其他应付款情况表

单位：万元

项目	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
往来款	366.25	51.60	238.09	292.82
押金、保证金	277.32	766.87	216.74	142.57
中介顾问咨询费	3,304.49	4,974.28		
<b>合计</b>	<b>3,948.06</b>	<b>5,792.76</b>	<b>454.83</b>	<b>435.39</b>

表 6-33：截至 2020 年 6 月末发行人账龄超过 1 年的其他应付款情况表

单位：万元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	71.00	尚未到期
单位二	50.00	尚未到期
单位三	30.00	尚未到期
<b>合计</b>	<b>151.00</b>	<b>--</b>

### (3) 一年内到期的非流动负债

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末，公司一年内到期的非流动负债分别为 13.73 万元、1,000.00 万元、2,000.00 万元和 9,000.00 万元，占比分别为 0.02%、0.97%、1.24%和 5.97%。2018 年末公司一年内到期的非流动负债较年初增长 986.27 万元，主要系部分长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致。2019 年末一年内到期的非流动负债较年初增长 1,000.00 万元，2020 年 6 月末一年内到期的非流动负债较年初增加 7,000.00 万元，主要系部分长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致。

表 6-34：发行人近三年及一期一年内到期的非流动负债构成

单位：万元

项目	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
一年内到期的长期借款	9,000.00	2,000.00	1,000.00	13.73
<b>合计</b>	<b>9,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>13.73</b>

### (8) 其他流动负债

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末，公司其他流动负债余额分别为 0.00 万元、2,296.23 万元、4,406.42 万元和 3,601.37 万元。2018 年末公司其他流动负债余额较 2017 年末增加 2,296.23 万元，主要是公司计提待转销项税额；2019 年末，其他流动负债余额为 4,406.42 元，较年初增长 91.90%，主要系计提增值税待转销项税额所致。2020 年 6 月末公司其他流动负债余额较年初减少 18.27%。

表 6-35：发行人近三年及一期其他流动负债明细表

单位：万元

项目	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
待转销项税额	3,601.37	4,406.42	2,296.23	-
<b>合计</b>	<b>3,601.37</b>	<b>4,406.42</b>	<b>2,296.23</b>	<b>-</b>

## 2、非流动负债



2017-2019 年末及 2020 年 6 月末，公司非流动负债分别为 76,150.03 万元、89,718.18 万元、97,542.66 万元和 81,189.08 万元。主要由长期借款、应付债券和递延收益构成。

表 6-36: 2017-2019 年末及 2020 年 6 月末公司的非流动负债结构

单位: 万元

项目	2020.06.30		2019年末		2018年末		2017年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	23,720.00	29.22%	7,120.00	7.30%	-	-	1,000.00	1.31%
应付债券	30,000.00	36.95%	30,000.00	30.76%	30,000.00	33.44%		
长期应付款	80.00	0.10%	80.00	0.08%	80.00	0.09%	80.00	0.11%
递延所得税负债	1,442.30	1.78%	1,460.01	1.50%	1,514.08	1.69%	1,834.23	2.41%
递延收益	25,946.78	31.96%	58,882.65	60.37%	58,124.10	64.79%	73,235.80	96.17%
<b>非流动负债合计</b>	<b>81,189.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>97,542.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>89,718.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>76,150.03</b>	<b>100.00%</b>

### (1) 长期借款

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末，公司长期借款余额分别为 1,000.00 万元、0.00 万元、7,120.00 万元和 23,720.00 万元，占非流动负债的比重分别为 1.31%、0.00%、7.30%和 29.22%。2018 年末公司长期借款账面余额较 2017 年减少 1,000.00 万元，账面已不存在未偿还长期借款；2019 年末长期借款余额为 7,120.00 万元，主要是成都研发中心项目的在建项目贷款。2020 年 6 月末长期借款余额为 23,720.00 万元，较年初增长 233.15%，主要系发行人从国家开发银行北京市分行获得 1.90 亿元复工复产专项贷款所致。报告期内，公司不存在已经逾期但尚未偿还的长期借款。

表 6-37: 发行人近三年及一期长期借款分类表

单位: 万元

项目	2020 年 6 月	2019 年末	2018 年末	2017 年末
保证借款	-	-	-	1,000.00
抵押借款	23,720.00	7,120.00	-	-
<b>合计</b>	<b>23,720.00</b>	<b>7,120.00</b>	<b>-</b>	<b>1,000.00</b>

### (2) 应付债券

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末，公司应付债券余额分别为 0.00 万元、30,000.00 万元、30,000.00 万元和 30,000.00 万元，占非流动负债的比重分别为 0.00%、33.44%、30.76%和 36.95%。

2018 年末公司应付债券余额较 2017 年末增加 3.00 亿元，主要是公司发行紫光国芯微电子股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

表 6-38: 近三年及一期发行人应付债券明细

单位: 万元

项目	2020 年 6 月	2019 年末	2018 年末	2017 年末	发行日期	债券期限
公司债券	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	2018.5.21	5 年
合计	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-		

表 6-39: 公司应付债券具体情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	票面利率
紫光国芯微电子股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	3.00 亿元	2018/5/21	5 年	5.28%

2018 年 5 月 21 日, 紫光国芯微电子股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 完成首期发行, 目前该债券仍处于存续期内。

### (3) 长期应付款

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末, 公司长期应付款余额分别为 80.00 万元、80.00 万元、80.00 万元和 80.00 万元, 占比分别为 0.11%、0.09%、0.08%和 0.10%。公司长期应付款余额形成原因为发行人收到的委托及合作开发的研发项目资金。

表 6-40: 发行人近三年及一期长期应付款明细

单位: 万元

项目	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
专项应付款	80.00	80.00	80.00	80.00

### (4) 递延收益

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末, 公司递延收益余额分别为 73,235.80 万元、58,124.10 万元、58,882.65 万元和 25,946.78 万元, 占比分别为 96.17%、64.79%、60.37%和 31.96%。发行人递延收益主要系公司收到的委托及合作开发的研发项目资金。2018 年末递延收益 58,124.10 万元, 较 2017 年末减少 20.63%。2020 年 6 月末递延收益较 2019 年末减少 55.93%, 主要系发行人对政府补助进行了会计政策变更, 追溯调整所致。

表 6-41: 发行人近三年及一期递延收益明细

单位: 万元

项目	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
政府补助	25,946.78	58,882.65	58,124.10	73,235.80

## (三) 所有者权益分析

发行人归属于母公司所有者权益主要由实收资本 (股本)、资本公积、专项储备和未分配利润构成。2017-2019 年末及 2020 年 6 月末, 发行人归属于母公司

所有者权益分别为 349,463.98 万元、379,438.05 万元、418,822.16 万元和 454,790.27 万元，占所有者权益比例分别为 98.87%、99.83%、99.89%和 99.75%。

表 6-42：发行人近三年及一期所有者权益情况

单位：万元

项 目	2020 年 6 月末		2019 年末		2018 年末		2017 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
实收资本（或股本）	60,681.80	13.31%	60,681.80	14.47%	60,681.80	15.97%	60,681.80	17.17%
资本公积	61,902.13	13.58%	61,902.13	14.76%	61,902.13	16.29%	61,902.13	17.51%
其他综合收益	1,695.91	0.37%	1,330.52	0.32%	3,244.32	0.85%	5,033.55	1.42%
盈余公积	12,390.98	2.72%	12,390.98	2.96%	11,792.47	3.10%	11,449.97	3.24%
未分配利润	318,119.45	69.77%	282,516.73	67.38%	241,817.32	63.62%	210,396.53	59.53%
<b>归属于母公司所有 者权益合计</b>	<b>454,790.27</b>	<b>99.75%</b>	<b>418,822.16</b>	<b>99.89%</b>	<b>379,438.05</b>	<b>99.83%</b>	<b>349,463.98</b>	<b>98.87%</b>
少数股东权益	1,132.76	0.25%	453.47	0.11%	654.19	0.17%	3,988.30	1.13%
<b>所有者权益（或股东 权益）合计</b>	<b>455,923.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>419,275.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>380,092.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>353,452.28</b>	<b>100.00%</b>

### （1）所有者权益

发行人归属于母公司所有者权益主要由实收资本（股本）、资本公积、盈余公积和未分配利润构成。2017-2019年末及2020年6月末，发行人归属于母公司所有者权益分别为349,463.98万元、379,438.05万元、418,822.16万元和454,790.27万元，占所有者权益比例分别为98.87%、99.83%、99.89%和99.75%。

截至2020年6月末，公司所有者权益合计455,923.03万元，较年初增长8.74%；归属于母公司所有者权益合计454,790.27万元，其中，股本占比13.31%、资本公积占比13.58%、盈余公积占比2.72%、未分配利润占比69.77%，未分配利润占比较大。

### （2）资本公积

2017-2019年末及2020年6月末，公司资本公积余额分别为61,902.13万元、61,902.13万元、61,902.13万元和61,902.13万元，占比分别为17.51%、16.29%、14.76%和13.58%。

### （3）未分配利润

2017-2019年末及2020年6月末，分别为210,396.53万元、241,817.32万元、282,516.73万元和318,119.45万元，占比分别为59.53%、63.62%、67.38%和69.77%。2018年末公司未分配利润较2017年末增加31,420.79万元，2019年末公司未分配利润较年初增加40,699.41万元，2020年6月末公司未分配利润较年初增加35,602.72万元，主要为企业利润增加所致。

#### 1) 公司利润分配政策

公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及中国证监会河北监管局发布的《关于印发河北上市公司进一步落实现金分红有关规定的通知》（冀证监发[2012]74号）的要求，结合公司实际经营情况，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》进行了修改，强化了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，完善了公司的分配政策尤其是现金分红政策，进一步明确了现金分红的标准和比例，规定了独立董事在现金分红中应发挥的作用，为中小股东有充分表达意见和诉求的机会提供了条件，充分维护了中小股东的合法权益。

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。根据公司的盈利状况及资金需求状况，公司可以进行中期现金分红。

①公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配利润。

②公司实施现金分红应至少同时满足以下条件：

a.累计可供分配利润大于零；

b.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③在满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

④在股本与业绩保持增长的前提下，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

## 2) 公司近期利润分配计划

**表 6-43：2019 年度公司利润分配情况**

项目	具体情况
拟分配的利润或股利	以公司 2019 年末总股本 606,817,968 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
经审议批准宣告发放的利润或股利	以公司 2019 年末总股本 606,817,968 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 五、发行人利润结构分析

**表 6-44：发行人近三年及一期利润情况**

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
营业总收入	146,436.53	343,041.00	245,842.35	182,909.57

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
营业总成本	98,142.15	280,275.59	224,763.48	158,853.30
税金及附加	1,291.11	2,222.22	1,479.57	1,622.56
销售费用	9,407.08	14,047.72	9,246.50	8,163.24
管理费用	6,177.22	20,501.13	23,211.65	15,626.89
财务费用	1,196.76	2,907.82	-9.81	2,871.77
研发费用	14,280.64	20,183.93	12,922.08	8,283.18
期间费用合计	31,061.70	57,640.60	45,370.41	34,945.08
期间费用主营业务收入比 (%)	21.21	16.80	18.46	19.11
资产减值损失	2,242.75	10,047.52	6,186.52	-12.17
信用减值损失	2,008.93	2,219.63		
投资收益	-1,177.68	-9,552.44	11,169.06	268.85
加：营业外收入	1.47	73.37	12.50	302.98
利润总额	43,806.43	45,617.00	37,302.97	31,621.98
净利润	40,221.97	40,054.70	34,855.30	27,873.35
毛利率 (%)	55.07	35.75	30.15	33.14
净资产收益率 (%)	9.18	9.15	9.56	8.39
总资产报酬率 (%)	12.84	7.59	7.10	6.75

### (一) 营业收入和营业成本

随着国家集成电路产业政策的系统实施，更有利于产业发展的政策环境已基本形成，在政策导向、市场需求的共同推动下，我国集成电路产业继续保持了平稳快速的发展态势。报告期内，公司各项经营业务保持了良好的发展态势，营业收入稳步上升。

2017-2019 年及 2020 年 1-6 月，公司实现营业收入 182,909.57 万元、245,842.35 万元、343,041.00 万元和 146,436.53 万元，公司实现主营业务收入 182,556.65 万元、245,379.61 万元、341,963.12 万元和 145,424.56 万元，占营业收入的比重分别为 99.81%、99.81%、99.69%和 99.31%；2017-2019 年及 2020 年 1-6 月，公司营业成本 122,297.85 万元、171,726.98 万元、280,275.59 万元和 98,142.15 万元。2020 年 1-6 月，公司实现营业收入 146,436.53 万元，较上年同期减少 6.08%，主要系本期西安紫光国芯不再合并所致，扣除此因素实际增长 24%，系集成电路业务增长所致。营业成本金额为 65,789.34 万元，较上年同期减少 34.24%，主要系主要系本期西安紫光国芯不再合并所致，扣除此因素实际下降 1%，系集成电路细分业务结构变化所致。

### (二) 期间费用

公司的期间费用为销售费用、管理费用、研发费用与财务费用。2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月，公司期间费用合计分别为 34,945.08 万元、45,370.41 万元、

57,640.60 万元和 31,061.70 万元, 占营业收入的比例分别为 19.11%、18.46%、16.80% 和 21.21%, 占比较低。

2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月, 公司销售费用分别为 8,163.24 万元、9,246.50 万元、14,047.72 万元和 9,407.08 万元, 总体呈上升态势, 主要系随着公司业务的快速发展, 人工薪资、业务招待费及市场营销费也相应同步上升。

2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月, 公司管理费用分别为 15,626.89 万元、23,211.65 万元、20,501.13 万元和 6,177.22 万元, 公司研发费用分别为 8,283.18 万元、12,922.08 万元、20,183.93 万元和 14,280.64 万元, 总体呈上升态势, 主要系随着公司业务的快速发展, 人工薪金等也相应同步上升。

2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月, 公司财务费用分别为 2,871.77 万元、-9.81 万元、2,907.82 万元和 1,196.76 万元, 2018 年度财务费用较上年同期大幅减少主要系美元汇率升值汇兑收益增加所致。2019 年度财务费用较上年同期大幅增加主要系现金折扣、汇兑损失增加所致。

表 6-45: 发行人近三年及近一期期间费用情况

单位: 万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
销售费用	9,407.08	14,047.72	9,246.50	8,163.24
管理费用	6,177.22	20,501.13	23,211.65	15,626.89
研发费用	14,280.64	20,183.93	12,922.08	8,283.18
财务费用	1,196.76	2,907.82	-9.81	2,871.77
期间费用合计	31,061.70	57,640.60	45,370.42	34,945.08
占营业收入比例	21.21%	16.80%	18.46%	19.11%

表 6-46: 发行人近三年及一期销售费用情况

单位: 万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
人工费	7,823.57	9,874.17	6,127.18	5,863.24
差旅费	133.60	868.16	679.01	724.85
业务招待费	122.64	571.00	679.05	435.16
办公费	114.28	266.18	206.58	190.85
折旧摊销租赁费	282.44	495.25	447.96	364.65
运保费	114.70	651.91	391.12	144.45
市场营销费	768.72	1,177.09	601.65	378.15
中介费	43.58	142.15	110.90	53.78
其他费用	3.53	1.81	3.05	8.11
合计	9,407.08	14,047.72	9,246.50	8,163.24

表 6-47: 发行人近三年及一期管理费用情况

单位: 万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
人工费用	4,180.26	9,465.34	8,246.34	5,849.82
差旅费	83.70	443.07	335.30	304.03
业务招待费	44.04	307.34	271.39	255.25

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
办公费	199.31	553.02	479.27	480.92
折旧摊销租赁及物业费	1,252.77	3,502.50	12,884.81	8,059.52
中介费	326.05	6,036.49	724.00	502.34
税费	1.15	29.47	31.73	27.06
其他	89.94	163.91	238.80	147.94
<b>合计</b>	<b>6,177.22</b>	<b>20,501.13</b>	<b>23,211.65</b>	<b>15,626.89</b>

表 6-48：发行人近三年财务费用情况

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
利息支出	1,432.44	1,845.16	1,521.11	1,013.39
减：利息收入	786.36	1,587.49	799.72	642.91
汇兑净损益	377.81	389.89	-1,294.64	1,682.43
手续费	57.79	161.48	113.72	77.96
其他	115.09	2,098.77	449.73	740.89
<b>合计</b>	<b>1,196.76</b>	<b>2,907.82</b>	<b>-9.81</b>	<b>2,871.77</b>

注：“其他”主要为现金折扣。

### （三）投资收益和营业外收支

2017-2019 年及 2020 年 1-6 月，公司实现投资收益 268.85 万元、11,169.06 万元、-9,552.44 万元和 -1,177.68 万元。2018 年度公司投资收益较 2017 年度增加 10,900.21 万元，投资收益大幅增加主要系长期股权投资成本法转为权益法形成的投资收益及出售华虹半导体股票形成的投资收益所致。2019 年末，发行人投资收益金额为 -9,552.44 万元，较上年下降 185.53%，主要系按持股比例确认的对联营企业深圳紫光同创的投资损失所致。2020 年 6 月末，发行人投资收益金额为 -1,177.68 万元，较年初增加 8,374.86 万元，主要系处置交易性金融资产取得的投资收益增加。

表 6-49：发行人近三年及一期投资收益情况

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
权益法核算的长期股权投资收益	-2,927.98	-12,581.96	-348.97	
处置长期股权投资产生的投资收益		2,046.55	9,034.48	
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益			270.65	268.85
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		119.64		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,750.31	689.50	-310.72	
处置可供出售金融资产取得的投资收益			2,438.73	
理财收益		64.50	84.89	
其他		109.33		
<b>合计</b>	<b>-1,177.68</b>	<b>-9,552.44</b>	<b>11,169.06</b>	<b>268.85</b>

2017 年以来，公司营业外收入降幅较大，主要系公司根据新《会计准则》的要求修改财务报表列报，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助

准则进行了调整。该次会计政策调整不影响损益，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，仅是根据政府补助的具体情况将部分政府补助从财务报表的“营业外收入”科目转记为“其他收益”科目。

2017-2019 年及 2020 年 1-6 月,公司营业外收入分别 302.98 万元、12.50 万元、73.37 万元和 1.47 万元。2017 年营业外收入主要来自政府补助、接受捐赠利得以及其他,“其他”为结转长期挂账、因债权人倒闭而不再支付的应付账款。2018 年营业外收入主要为员工违约金收入;2019 年营业外收入主要为无法支付的往来款;2020 年 1-6 月营业外收入主要为罚款利得。

表 6-50: 发行人近三年营业外收入情况

单位: 万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
非流动资产处置利得				
政府补助				45.01
接受捐赠利得				42.49
无法支付的往来款		60.00		
罚款利得	1.20			
其他	0.27	13.37	12.50	215.48
<b>合计</b>	<b>1.47</b>	<b>73.37</b>	<b>12.50</b>	<b>302.98</b>

报告期内,公司营业外支出分别为 33.90 万元、17.72 万元、224.59 万元和 124.68 万元,金额较小。最近三年及一期公司营业外支出明细情况如下:

表 6-51: 发行人近三年及一期营业外支出情况

单位: 万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
非流动资产处置损失	79.48	10.09	13.39	1.47
对外捐赠	45.00			2.50
其他	0.21	214.50	4.33	29.93
<b>合计</b>	<b>124.68</b>	<b>224.59</b>	<b>17.72</b>	<b>33.90</b>

#### (四) 利润情况

2017-2019 年及 2020 年 1-6 月,发行人营业利润分别为 31,352.91 万元、37,308.19 万元、45,768.22 万元和 43,929.65 万元;利润总额分别为 31,621.98 万元、37,302.97 万元、45,617.00 万元和 43,806.43 万元;净利润分别为 27,873.35 万元、34,855.30 万元、40,054.70 万元和 40,221.97 万元,近三年以来,在新兴产业需求的推动下,作为新一代信息技术的重要核心,我国集成电路产业继续保持快速发展,迎来重大发展机遇。但同时,外部竞争环境复杂多变,贸易保护主义升温、贸易摩擦加剧等风险因素也给产业发展带来很多不确定性。公司在董事会的领导下,聚焦“安全芯片”领域,发扬“二次创业”精神,梳理公司发展战略,凝聚企业发展共识,持续加大产品研发及市场开拓,多方位构筑竞争优势,推动核心业务规模和市场地位迈上新台阶,企业价值实现了稳步提升。集成电路设计业务经营规模和业绩均保持了快速增长。2020 年 1-6 月,公司实现营业收入 146,436.53 万元,



较上年同期减少 6.08%，主要系本期西安紫光国芯不再合并所致，扣除此因素实际增长 24%，系集成电路业务增长所致。营业成本金额为 65,789.34 万元，较上年同期减少 34.24%，主要系主要系本期西安紫光国芯不再合并所致，扣除此因素实际下降 1%，系集成电路细分业务结构变化所致。

## 六、发行人现金流量分析

表 6-52：发行人近三年及近一期现金流指标情况

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	104,577.35	321,361.47	260,598.57	205,146.58
经营活动现金流出小计	129,377.00	294,768.59	228,734.29	146,723.11
经营活动产生的现金流量净额	-24,799.65	26,592.89	31,864.28	58,423.47
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	36,662.84	33,489.22	6,465.81	1,327.49
投资活动现金流出小计	61,068.28	81,707.76	30,733.59	30,651.99
投资活动产生的现金流量净额	-24,405.44	-48,218.55	-24,267.78	-29,324.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	60,386.39	48,997.75	46,432.39	25,270.00
筹资活动现金流出小计	18,459.96	22,939.60	48,503.24	25,484.65
筹资活动产生的现金流量净额	41,926.43	26,058.15	-2,070.85	-214.65

### （一）经营活动现金流

2017-2019 年及 2020 年 1-6 月，公司经营现金流入分别为 205,146.58 万元、260,598.57 万元、321,361.47 万元和 104,577.35 万元，2017-2019 年及 2020 年 1-6 月，公司经营活动现金净流量分别为 58,423.47 万元、31,864.28 万元、26,592.89 万元和 -24,799.65 万元。由于发行人从事的集成电路设计业务受到宏观经济、产业政策、市场需求及技术升级等因素的影响，外部环境的变化会造成发行人经营活动现金流出现一定程度的波动。

2020 年 1-6 月，经营活动产生的现金流量净额为 -24,799.65 元，较上年同期下降 44.87%，主要为公司销售回款受疫情影响延迟及备货采购付款增加所致。

### （二）投资活动现金流

2017-2019 年及 2020 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -29,324.50 万元、-24,267.78 万元、-48,218.55 万元和 -24,405.44 万元。最近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额持续为负主要为公司报告期内业务增长，投资支付、取得子公司及其他营业单位支付及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所需资金流出较大所致。

### (三) 筹资活动现金流

2017-2019 年及 2020 年 1-6 月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 -214.65 万元、-2,070.85 万元、26,058.15 万元和 41,926.43 万元。2017 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为负主要为公司购买西安紫光国芯少数股权支付现金和支付的票据保证金增加以及上年同期紫光同创收取少数股东投资款所致；2018 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为负主要为公司支付的票据保证金增加所致；2019 年度及 2020 年 1-6 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为正，主要系公司为满足主业快速增长取得借款增加所致。

### (四) 现金及现金等价物净增加额

2017-2019 年及 2020 年 1-6 月，公司现金及现金等价物净增加额分别为 27,461.10 万元、6,705.75 万元和 3,862.52 万元和 -7,063.58 万元。

## 七、发行人偿债指标分析

### (一) 偿债能力指标

表 6-53：发行人近三年及一期偿债能力指标情况

年度	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
资产负债率 (%)	33.73	38.22	33.62	32.12
流动比率 (倍)	2.94	2.72	3.31	3.01
速动比率 (倍)	2.35	2.19	2.55	2.35
EBITDA 利息保障倍数	29.03	24.95	30.00	45.44

从短期偿债能力指标来看，截至 2020 年 6 月底，公司流动比率、速动比率分别为 2.94 倍、2.35 倍，较上年底变化不大；截至 2019 年末，公司流动比率、速动比率分别为 2.72 倍、2.19 倍，较年初变化不大，公司短期偿债能力较强。

从长期偿债能力指标来看，2020 年 6 月底，公司的合并报表口径 EBITDA 利息保障倍数为 29.03 倍。在公司未来保持稳健经营业绩及偿债保障措施的支持下，公司具备较强的偿债能力。发行人资产负债率维持在较低水平，且发行人所处的集成电路行业属于目前政府大力鼓励发展的行业，行业前景广阔，发行人盈利能力较强，长期偿债能力较好。

同时，截至 2020 年 6 月末共获得各类金融机构授信额度 24.21 亿元，尚未使用的额度为 15.66 亿元；同时，作为上市企业，公司在资本市场融资渠道畅通。

综上，公司稳健、良好的盈利能力将为本期债券的本息偿付提供有力保障。

### (二) 盈利能力指标

从盈利指标来看，2017-2019 年末及 2020 年 6 月末，发行人的净资产收益率一直保持 8.39%、9.56%、10.15%和 9.18%的高水平，总资产报酬率维持在 6.75%、7.10%、7.59%和 12.84%的水平。公司盈利能力增强。

表 6-54：发行人近三年及一期盈利能力情况

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
毛利率 (%)	55.07	35.75	30.15	33.14
净资产收益率 (%)	9.18	10.15	9.56	8.39
总资产报酬率 (%)	12.84	7.59	7.10	6.75

近年来，在国家政府和产业基金的积极推动下，我国集成电路行业迎来了难得的发展机遇。公司长期深耕集成电路领域，凭借多年技术积累和历练，在智能安全芯片、特种集成电路、存储器芯片等核心产品方面已形成业内领先的技术优势，为产品核心竞争力的形成奠定了坚实基础，目前客户已遍及国内外，积累了深厚的客户资源。

公司始终重视技术创新和研发投入，注重科研创新能力与产品开发能力的结合，努力提高“自主”、“可控”能力，致力于提供差异化的高性价比产品与服务，不断提升公司的综合技术实力。

此外，公司拥有集成电路行业内优秀的技术、研发和管理团队，为公司健康持续发展提供了有力保障。公司的技术、研发团队在数字、模拟及数模混合集成电路的设计和产业化方面具有丰富的经验。

综上，公司的盈利能力具有较强的可持续性。

### （三）运营效率指标

表 6-55：发行人近三年及一期运营效率指标情况

单位：次

项目	2020 年 6 月末	2019 年	2018 年	2017 年
应收账款周转率	1.87	2.86	2.58	2.50
存货周转率	1.49	2.67	2.47	2.16
总资产周转率	0.44	0.57	0.45	0.38

2017-2019 年以及 2020 年 1-6 月，公司应收账款周转率分别为 2.50、2.58、2.86 和 1.87，近三年公司加大对资金的管理，应收账款周转率呈上升趋势。2017-2019 年以及 2020 年 1-6 月公司存货周转率分别为 2.16、2.47、2.67 和 1.49。2017-2019 年以及 2020 年 1-6 月公司总资产周转率为 0.38、0.45、0.57 和 0.44，近三年，总资产周转率呈上升趋势，公司销售能力越来越强。

## 八、发行人有息债务

### （一）金融机构借款

#### 1、期限结构

从有息债务来看，2020 年 6 月末公司有息债务共计 69,524.51 万元，较年初增加 99.11%。2020 年 6 月末，发行人短期借款、一年内到期非流动负债及长期

借款均较 2019 年末有较大增长。2020 年 6 月末，发行人长期借款有大幅增长主要系要系发行人从国家开发银行北京市分行获得 1.90 亿元复工复产专项贷款所致。截至 2020 年 6 月末，短期借款余额为 36,804.51 万元，较年初增长 5.35%，主要系公司集成电路业务经营规模增长，运营资金需求增加所致。

截至 2020 年 6 月末，公司负债总额 232,061.51 万元，其中流动负债占 65.01%，非流动负债占 34.99%，占比较为均衡。

表 6-56：发行人近三年及一期借款余额期限结构表

单位：万元

项目	2020 年 6 月末	2019 年	2018 年	2017 年
短期借款	36,804.51	25,797.14	1,251.59	24,470.00
一年内到期的非流动负债	9,000.00	2,000.00	1,000.00	13.73
长期借款	23,720.00	7,120.00	0.00	1,000.00
总有息债务	69,524.51	34,917.14	2,251.59	25,483.73
短期有息债务占总息债务比重	65.88%	79.61%	100.00%	96.08%
总有息债务占总负债比重	29.96%	13.46%	1.17%	15.24%

## 2、借款的担保结构

表 6-57 近三年及一期发行人借款余额担保结构一览表

单位：万元

项目	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
短期借款:				
信用借款	35,929.53	22,915.05	200.00	24,100.00
保证借款	600.00	600.00	1,051.59	370.00
质押借款	274.98	2,282.10		
<b>合计</b>	<b>36,804.51</b>	<b>25,797.14</b>	<b>1,251.59</b>	<b>24,470.00</b>
一年内到期的非流动负债:				
信用借款				13.73
保证借款			1,000.00	
抵押借款	9,000.00	2,000.00		
<b>合计</b>	<b>9,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>13.73</b>
长期借款:				
信用借款				
保证借款				1,000.00
抵押借款	23,720.00	7,120.00		
<b>合计</b>	<b>23,720.00</b>	<b>7,120.00</b>		<b>1,000.00</b>

备注：长期借款未包括一年内到期的长期借款，一年内到期的长期借款已重分类至一年内到期的非流动负债。

## 3、公司在金融机构的借款情况

表 6-58：截至 2020 年 6 月末发行人主要金融机构短期借款明细

单位：万元、%

贷款银行	贷款金额	贷款利率	贷款期限		贷款类型
			起始日	终止日	
工商银行上地支行	615.00	3.92	2020/4/7	2021/4/6	信用借款
华夏银行北京分行	3,500.00	4.57	2019/11/4	2020/11/3	信用借款
平安银行深圳罗湖支行	5,000.00	4.57	2019/9/27	2020/7/23	信用借款
招商银行泰然支行	3,000.00	4.35	2020/4/23	2020/12/23	信用借款
招商银行泰然支行	3,000.00	4.40	2020/2/28	2020/12/28	信用借款
招商银行泰然支行	2,000.00	4.35	2020/3/30	2020/12/30	信用借款
工商银行北京中关村支行	3,000.00	4.35	2020/1/1	2020/12/31	信用借款
中国建设银行北京清华园支行	9,203.35	2.91	2020/6/23	2020/12/20	信用借款
招商银行大运村支行	3,000.00	4.35	2020/1/19	2021/1/18	信用借款
招商银行大运村支行	625.34	4.35	2020/2/5	2021/2/4	信用借款
招商银行大运村支行	991.01	4.35	2020/2/25	2021/2/24	信用借款
招商银行大运村支行	394.84	4.35	2020/2/28	2021/2/27	信用借款
宁波银行无锡新区支行	500.00	4.79	2020/3/24	2020/9/23	信用借款
江苏银行无锡科技支行	300.00	4.35	2020/5/19	2021/1/18	信用借款
中国银行无锡河埭支行	200.00	4.79	2020/1/15	2021/1/12	信用借款
中国银行无锡河埭支行	200.00	4.79	2020/1/19	2021/1/15	信用借款
中国银行无锡河埭支行	400.00	4.79	2020/2/11	2021/2/9	信用借款
招商银行无锡分行新区支行	200.00	4.80	2020/1/20	2021/1/20	保证借款
招商银行无锡分行新区支行	82.77	5.00	2019/11/22	2020/11/22	保证借款
招商银行无锡分行新区支行	68.82	5.00	2019/12/18	2020/12/18	保证借款
招商银行无锡分行新区支行	248.41	5.00	2020/1/6	2021/1/6	保证借款
华夏银行高新支行	112.08	6.00	2019/12/26	2020/7/10	质押借款
招商银行泰然支行	162.90	5.00	2019/12/26	2020/7/17	质押借款
<b>合计</b>	<b>36,804.51</b>				

表 6-59：截至 2020 年 6 月末发行人主要金融机构长期借款明细

单位：万元、%

贷款银行	贷款金额	贷款利率	贷款期限		抵押物
			起始日	终止日	
中国工商银行成都天府支行	500.00	4.99	2019/7/17	2020/9/25	在建工程及土地使用权
	700.00	4.99	2019/7/17	2020/12/25	
	800.00	4.99	2019/8/14	2020/12/25	
	140.00	4.99	2019/8/14	2021/6/25	
	1,240.00	4.99	2019/8/31	2021/6/25	
	540.00	4.99	2019/10/11	2021/6/25	
	2,080.00	4.99	2019/10/31	2021/6/25	
	920.00	4.99	2019/10/31	2021/12/25	
	2,200.00	4.99	2019/11/12	2021/12/25	
	880.00	4.99	2020/3/10	2021/12/25	
	1,520.00	4.99	2020/3/10	2022/6/24	
	2,200.00	4.99	2020/6/1	2022/6/24	
国家开发银行北京市分行	3,000.00	3.50	2020/5/29	2021/5/28	房屋建筑物、土地使用权
	3,000.00	3.50	2020/5/29	2021/11/28	
	3,000.00	3.50	2020/5/29	2022/5/28	
	3,000.00	3.50	2020/5/29	2022/11/28	
	7,000.00	3.50	2020/5/29	2023/5/28	
合计	32,720.00				

## (二) 债务融资工具发行情况

表 6-60：发行人整体已发行债务融资工具情况表

单位：万元、%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率	还本付息方式
紫光国芯微电子股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18 国微 01	112708	2018 年 05 月 21 日	2023 年 05 月 21 日	30,000.00	5.28	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年 5 月 21 日付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
							至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
公司债券上市或转让的交易场所				深圳证券交易所			
投资者适当性安排				根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。			
报告期内公司债券的付息兑付情况				本报告期，公司按期支付公司债券利息 1584 万元。			
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）				18 国微 01 债券设置了第 3 年末调整票面利率和投资者回售选择权。报告期内均不满足行权条件。			

上述债券发债券的主承销商为国泰君安证券股份有限公司，公司债券募集资金严格按照《募集说明书》承诺的用途，用于发行人及下属子公司项目投资、偿还公司债务及补充营运资金。截至 2020 年 6 月末，公司累计使用募集资金 30,000.00 万元，其中：用于项目投资 12,000.00 万元、偿还公司债务 4,000.00 万元、补充营运资金 14,000.00 万元。所有支出均履行了支出审批程序，债券目前尚在存续期。

### （三）融资租赁情况

无。

## 九、发行人关联交易

### （一）关联方关系

1、发行人的母公司、最终控制人及直接控股子公司情况，请参见本募集说明书第五章第三节、第五节相关内容。

2、其他关联方情况

**表 6-61：截至 2019 年末其他关联方的关联方交易内容**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
紫光集团有限公司	本公司的间接控股股东
紫光数码（苏州）集团有限公司	实际控制人控制的其他企业
紫光集团有限公司北京国际科技交流中心	实际控制人控制的其他企业
紫光华山科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
紫光宏茂微电子（上海）有限公司	实际控制人控制的其他企业
同方股份有限公司	实际控制人控制的其他企业
北京同方物业管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
同方电子科技有限公司	实际控制人控制的其他企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
同方锐安科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
同方全球人寿保险有限公司	实际控制人控制的其他企业的合营企业
展讯通信（上海）有限公司	实际控制人控制的其他企业
新华三技术有限公司	实际控制人控制的其他企业
武汉新芯集成电路制造有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳市紫光同创电子有限公司	实际控制人控制的其他企业/本公司的联营企业
深圳市国微科技有限公司	离任关联自然人担任董监高的其他企业
山东新恒汇电子科技有限公司	离任关联自然人担任董监高的其他企业
锐迪科微电子（上海）有限公司	实际控制人控制的其他企业
清华控股集团财务有限公司	实际控制人控制的其他企业
启迪国信科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
南涧启迪农业科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
立联信（苏州）微连接器有限公司	实际控制人控制的其他企业
北京紫光得瑞科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
北京紫光存储科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
北京展讯高科通信技术有限公司	实际控制人控制的其他企业
Unic Memory Technology (Singapore) Pte. Ltd.	实际控制人控制的其他企业
RDA Technologies Limited	实际控制人控制的其他企业
Linxens Singapore Pte. Ltd.	实际控制人控制的其他企业
湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司	实际控制人控制的其他企业
上海伊诺尔信息电子有限公司	实际控制人控制的其他企业
紫光云技术有限公司	实际控制人控制的其他企业
清华大学（微电子学研究所）	实际控制人的全资出资人
新华三信息技术有限公司	实际控制人控制的其他企业
珠海同方爱德科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
北京紫光恒越网络科技有限公司杭州分公司	实际控制人控制的其他企业
苏州光建存储科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
西安紫光国芯半导体有限公司	实际控制人控制的其他企业

## （二）关联交易定价原则及结算方式

公司关联交易的定价政策为以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价，以现款和承兑汇票进行结算。

## （三）关联方交易

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联方股东的合法权益，公司制定了《关联交



易管理制度》，分别对关联方与关联关系、关联交易作了定义，对关联交易的决策权限、决策程序、定价原则以及信息披露流程作了严格规定，对防范控股股东及其他关联方的资金占用作了严格限制。

报告期内，公司与关联方之间的关联交易均遵照《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定严格履行审批程序，在确定关联交易价格时，均遵循“平等、自愿、等价、有偿”的商业原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

表 6-62：2019 年末购买商品、提供和接受劳务的关联交易情况一览表

单位：万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉新芯集成电路制造有限公司	购买产品	4.02	30.48
同方锐安科技有限公司	购买产品		11.26
Linxens Singapore Pte.Ltd.	购买产品	3846.66	909.56
Unic Memory Technology(Singapore) Pte. Ltd.	购买产品	1442.82	
深圳市紫光同创电子有限公司	购买产品	561.30	431.33
南涧启迪农业科技有限公司	购买产品	3.00	0.52
启迪国信科技有限公司	购买产品	0.13	
北京紫光存储科技有限公司	购买产品	68.06	
北京紫光得瑞科技有限公司	购买产品	1.72	
新华三技术有限公司	购买产品	73.25	
紫光华山科技有限公司	购买产品	164.13	
山东新恒汇电子科技有限公司	购买产品和劳务	90.52	13,212.07
北京同方物业管理有限公司	物业管理费	246.69	225.93
紫光宏茂微电子（上海）有限公司	购买服务	967.97	245.59
同方全球人寿保险有限公司	购买服务		15.16
紫光集团有限公司北京国际科技交流中心	购买服务	2.41	3.20
立联信（苏州）微连接器有限公司	购买服务	2,435.01	523.39

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
紫光数码（苏州）集团有限公司	购买服务	0.28	
湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司	购买服务	0.94	
上海伊诺尔信息电子有限公司	购买服务	18.46	
紫光云技术有限公司	购买服务	11.74	
清华大学（微电子学研究所）	购买服务	29.13	

表 6-63：2019 年末出售商品、提供和接受劳务的关联交易情况一览表

单位：万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
同方锐安科技有限公司	销售产品	86.09	55.45
新华三技术有限公司	销售产品	6.90	26.28
RDA Technologies Limited	销售产品	4.10	14.62
深圳市紫光同创电子有限公司	销售软件、提供开发服务	1,847.94	999.65
Unic Memory Technology(Singapore) Pte. Ltd.	销售产品	0.86	
北京紫光存储科技有限公司	销售产品、提供开发服务	3,561.98	
锐迪科微电子（上海）有限公司	销售产品	4.40	
紫光宏茂微电子（上海）有限公司	处置资产	6.00	
北京展讯高科通信技术有限公司	提供开发服务	982.87	801.89
展讯通信（上海）有限公司	提供开发服务		82.45
武汉新芯集成电路制造有限公司	提供开发服务	736.79	
新华三信息技术有限公司	销售产品	650.19	
Linxens Singapore Pte.Ltd.	销售产品	103.56	
同方电子科技有限公司	销售产品	4.40	
珠海同方爱德科技有限公司	销售产品	6.01	
北京紫光恒越网络科技有限公司杭州分公司	销售产品	258.31	
苏州光建存储科技有限公司	销售产品	286.43	
紫光云技术有限公司	销售产品	1.99	
山东新恒汇电子科技有限公司	销售产品		81.70

## 2、关联租赁情况

表 6-64：近三年及一期发行人关联租赁的关联交易情况一览表

单位：万元

关联方	2020 年 6 月	2019 年	2018 年	2017 年
深圳市国微科技有限公司			342.84	780.16
同方股份有限公司	1,100.06	1,814.61	1,407.70	1,319.75

### 3、关联担保情况

为满足成都国微科技工程建设资金需求，经公司第六届董事会第二十八次会议审议批准，公司为其向银行申请金额不超过 3 亿元人民币、期限为 5 年的固定资产贷款授信额度提供连带责任最高额保证担保，并与银行签署《最高额保证合同》。

为促进同芯微电子的业务发展需要，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了为全资子公司同芯微电子向国家开发银行北京分行申请金额不超过人民币 40,000 万元，贷款期限不超过 3 年的综合授信业务提供不可撤销的连带责任保证担保。

为推进“北京市海淀区学院路北端 A、B、C、J 地块 B4 综合性商业金融服务业用地、B23 研发设计用地”的开发建设，经公司第六届董事会第四十二次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议批准，公司作为联合体一方与联合体其他方紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）、紫光股份有限公司及北京紫光科技服务集团有限公司（以下简称“科服集团”）共同签署《土地出让合同》之《补充协议》和《连带担保责任函》，将《土地出让合同》的受让人由联合体变更为紫光智城科创，同时对紫光智城科创履行《土地出让合同》的行为承担连带担保责任。担保金额不超过人民币 13.50 亿元，担保期间为主债务履行期限届满之日起 6 个月。紫光集团作为紫光智城科创的控股股东对该担保提供连带责任反担保。

#### （五）关联交易形成的原因

公司的关联交易主要形成于公司与业务相关的关联方之间购销产生的债权债务关系。

#### （六）关联交易对公司的经营的影响

公司对关联交易进行严格的管理，产生的资金占用为正常经营所致，对公司的经营没有产生异常影响。

## 十、发行人或有事项

### （一）对外担保

截至 2020 年 6 月末，发行人不存在对外担保事项。

### （二）未决诉讼、仲裁事项

截至 2020 年 6 月末，发行人未有重大未决诉讼、仲裁事项。

### (三) 重大承诺

截至 2020 年 6 月末，无新增重大承诺事项。

### (四) 其他或有事项

截至 2020 年 6 月末，本公司不存在其他或有事项。

## 十一、发行人受限资产情况

截至 2020 年 6 月末，发行人主要财产权利限制情况如下：

表 6-65：2020 年 6 月末发行人受限资产账面价值情况

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	202.09	票据、信用证保证金
应收票据	274.98	贴现融资未满足终止确认条件
在建工程	24,026.13	成都研发中心在建工程为长期借款抵押
无形资产	2,009.79	土地使用权为长期借款抵押
合计	26,512.99	

### (一) 资产抵押情况

截至 2020 年 6 月末，抵押资产为公司成都芯云中心在建工程。

### (二) 资产质押情况

截至 2020 年 6 月末，公司无资产质押情况。

### (三) 受限制使用的货币资金

公司受限制使用的货币资金主要是银行承兑汇票保证金、进口设备开证保证金：

表 6-66：发行人近三年及一期受限制使用的货币资金情况表

单位：万元

项目	2020 年 6 月末		2019 年		2018 年		2017 年	
	金额	占货币资金比例	金额	占货币资金比例	金额	占货币资金比例	金额	占货币资金比例
受限制使用的货币资金	202.09	0.20%	8,356.85	7.09%	7,325.93	6.48%	2,467.31	2.43%

## 十二、发行人衍生产品、理财产品、海外投资情况

截至本募集说明书签署之日，发行人无衍生产品、理财产品投资情况。

截至本募集说明书签署之日，发行人海外投资情况如下：

表 6-67：发行人海外投资情况

公司名称	级次	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
香港同芯投资有限公司	一级	中国香港	高科技企业投资;集成电路采购、销售	100.00	-	设立
MARS TECHNOLOGY PTE.LTD	二级	新加坡	集成电路销售	-	100.00	设立

1、香港同芯投资有限公司（以下简称“香港同芯”）成立于 2014 年 9 月 26 日，系发行人全资子公司，是发行人主要的境外经营实体，香港同芯的注册地为香港。香港同芯因主要业务结算使用港币而采用港币为记账本位币。香港同芯注册资本 1.2 亿元港币加 8,300,000.00 美元，发行人实际出资 1.2 亿元港币加 7,815,914.24 美元。香港同芯主要从事高科技企业投资、集成电路采购及销售业务。截至 2019 年末，香港同芯总资产 512,856,156.00 港元，总负债 278,787,549.00 港元，所有者权益 234,068,607 港元。2019 年度营业收入 316,974,969.00 港元，净利润 22,549,312.00 港元。

2、2019 年 8 月，香港同芯于新加坡设立全资子公司 Mars Technology PTE.LTD.（以下简称“MARS”），注册资本 10 新加坡元。发行人通过香港同芯间接持有 MARS100%的股权。MARS 自设立之日起纳入发行人合并财务报表范围。MARS 的主营业务为集成电路研发、生产及销售。子公司 MARS 处于成立初期，尚未设置账套。

### 十三、发行人直接债务融资计划

截至本募集说明书签署之日，发行人除申报注册本次 10 亿元超短期融资券外，无其他直接债务融资计划。

## 第七章 发行人资信状况

### 一、信用评级情况

#### (一) 发行人历史评级情况

1、近三年公司主体评级情况如下表所示：

表 7-1：近三年发行人债务融资的历史主体评级情况

评级标准	发布日期	信用评级	评级展望	评级机构
主体评级	2020-10-29	AA+	稳定	中诚信国际信用评级有限责任公司
主体评级	2020-6-1	AA+	稳定	中诚信国际信用评级有限责任公司
主体评级	2020-1-21	AA+	稳定	中诚信国际信用评级有限责任公司
主体评级	2019-6-10	AA+	稳定	中诚信证券评估有限公司
主体评级	2018-5-9	AA+	稳定	中诚信证券评估有限公司

注：信用评级 AA 表示企业偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”、“-”符号是对信用等级的微调，表示略高或略低于该等级；评级展望的含义：正面表示评级有上升趋势，负面表示评级有下降趋势，稳定表示评级大致不会改变。

中诚信国际信用评级有限责任公司维持发行人主体信用等级 AA+，评级展望稳定。

#### (二) 发行人主体评级

中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和分析，评定发行人的主体信用等级 AA+，评级展望为稳定。

##### 1、评级观点

中诚信国际评定紫光国芯微电子股份有限公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

中诚信国际评定紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“紫光国微”或“公司”）主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。中诚信国际肯定了集成电路行业发展前景良好、公司研发设计能力较强、核心业务增长较快、财务结构稳健等方面的优势对公司整体信用实力提供了有力支持。同时，中诚信国际关注到产品研发及核心技术人员流失风险、实际控制人变动风险等因素对公司经营及信用状况造成的影响。

##### 2、优势

(1) 行业发展前景良好。近年来我国集成电路行业保持较快增长，但高端芯片仍依赖进口，进口替代需求巨大，在国家重点支持集成电路国产化的形势下，高端芯片国产化替代进程有望加速，我国集成电路产业预计将保持良好的发展态势。

(2) **研发设计能力较强。**公司研发投入较大，在智能安全芯片、特种集成电路等核心产品领域形成业内领先的技术优势，先后荣获国家科技进步一等奖和国家技术发明二等奖等，截至 2020 年 6 月末，公司累计申请专利 576 项（不含境外专利申请），共取得专利授权 370 项。

(3) **核心业务增长较快。**公司依托持续的研发投入和技术积累，在集成电路设计和产业化方面积累了较为丰富的经验，综合竞争力不断提高，智能安全芯片和特种集成电路业务收入快速增长，带动公司盈利能力稳步提升。

(4) **财务结构稳健。**近年来，公司资产负债率与总资本化比率均控制在较低水平，财务政策较为稳健。此外，公司作为上市公司，资本市场融资渠道通畅。

### 3、关注

(1) **产品研发及核心技术人员流失风险。**集成电路技术迭代速度较快，如果公司对相关技术和市场发展趋势判断失误，或新技术的市场接受度未如预期，将让公司面临研发支出无法产生预期收益的风险。核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分，若人员流失将对公司运营产生负面影响。

(2) **实际控制人变动风险。**2020 年 6 月 3 日，公司间接控股股东紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）、实际控制人清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）、北京健坤投资集团有限公司（以下简称“健坤投资”）、重庆两江新区产业发展集团有限公司（以下简称“两江产业集团”）四方共同签署《合作框架协议》，根据合作方案，紫光集团拟通过增资扩股引入新的战略投资者，合作完成后，紫光集团股权或将发生较大变动，进而对公司实际控制权变更及业务运营产生影响。

## 二、发行人授信情况

### (一) 金融机构授信情况

发行人与多家金融机构保持着良好的合作关系，近三年公司的所有融资都能按期还本付息，不存在拖欠利息和本金的情形，信用记录良好。截至 2020 年 6 月末，发行人资信状况保持正常，未发生重大变化，发行人及下属子公司从国内各家银行及其他金融机构获得的综合授信额度为 24.21 亿元，已使用授信额度为 8.55 亿元，剩余未使用额度为 15.66 亿元。

表 7-2：截至 2020 年 6 月末发行人获得金融机构授信情况

单位：万元

序号	授信开始日	授信到期日	贷款单位名称	币种	金额	截至 2020 年 6 月末已使用授信额度	担保措施
1	2020/2/19	2021/2/18	平安银行深圳罗湖支行	人民币	10,000.00	5,134.33	信用借款
2	2019/12/13	2020/12/22	招商银行深圳泰然支行	人民币	20,000.00	9,165.90	信用借款

## 紫光国芯微电子股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书

序号	授信开始日	授信到期日	贷款单位名称	币种	金额	截至 2020 年 6 月末已使用授信额度	担保措施
3	2019/11/29	2020/11/29	华夏银行深圳高新支行	人民币	10,000.00	558.35	信用借款
4	2019/8/15	2020/7/11	中国银行中关村支行	人民币	22,000.00	8,197.54	信用借款
5	2018/12/20	2020/7/15	交通银行北京林萃路支行	人民币	15,000.00	6,100.07	信用借款
6	2020/1/16	2021/1/15	招商银行北京大运村支行	人民币	10,000.00	5,011.18	信用借款
7	2019/12/25	2020/12/31	中国工商银行中关村支行 行上地支行	人民币	10,000.00	3,000.00	信用借款
8	2020/5/29	2023/5/29	国家开发银行北京分行	人民币	19,000.00	19,000.00	公司保证+房产抵押
9	2019/9/26	2020/9/25	招商银行无锡分行新区支行	人民币	1,000.00	600.00	股东按比例担保
10	2019/5/29	2020/5/19	江苏银行无锡科技支行	人民币	300.00	300.00	信用借款
11	2019/3/28	2020/3/27	宁波银行无锡科技支行	人民币	500.00	500.00	信用借款
12	2020/1/13	2023/1/13	中国银行无锡河埭支行	人民币	800.00	800.00	信用借款
13	2019/3/28	2020/3/28	华夏银行北京分行	人民币	3,500.00	3,500.00	信用借款
14	2019/12/25	2020/12/31	中国工商银行中关村支行 行上地支行	人民币	15,000.00	615.00	信用借款
25	2019/9/19	2020/9/18	兴业银行唐山支行	人民币	45,000.00	-	信用借款
16	2020/3/22	2022/3/22	中国建设银行清华园支行	人民币	20,000.00	-	信用借款
17	2020/6/23	2020/12/20	中国建设银行清华园支行	人民币	10,000.00	9,270.95	信用借款
18	2019/6/25	2024/6/24	工商银行股份有限公司 成都天府支行	人民币	30,000.00	13,720.00	母公司提供担保、在建工程抵押
合计					<b>242,100.00</b>	<b>85,473.32</b>	

注：发行人与各银行保持长期稳定合作关系。截至本募集说明书签署日，上表中“序号 5”交通银行的授信已完成最新授信审批，授信起始日为 2020 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 18 日，授信额度提升至 20,000.00 万元；上表中“序号 13”华夏银行的授信已完成最新授信审批，授信起始日为 2020 年 9 月 30 日至 2021 年 9 月 30 日，授信额度仍为 3,500.00 万元；上表中“序号 4、9、10、11、25”的授信预计于 2020 年 10 月末前完成新一年度授信审批。

## （二）发行人近三年及一期债务违约情况

近三年及一期，发行人未发生过债务违约行为。



### 三、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况

截至本募集说明书签署日，发行人处于存续期的债券情况如下：

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息情况
紫光国芯微电子股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券(第一期)	18 国微 01	112708	2018 年 05 月 21 日	2023 年 05 月 21 日	30,000.00	5.28%	存续期内，发行人按期付息

18 国微 01 的发行金额 30,000.00 万元，截至本募集说明书签署日，已累计使用募集资金 30,000.00 万元，其中：用于项目投资 12,000.00 万元、偿还公司债务 4,000.00 万元、补充营运资金 14,000.00 万元。所有支出均履行了支出审批程序，该债券尚在存续期，存续期内发行人按期付息。

### 四、发行人最新资信情况

截至本募集说明书签署之日，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。发行人银行授信情况正常，未出现贷款本息违约。

## 第八章 担保

本期超短期融资券无担保。

## 第九章 税项

本期超短期融资券的投资人应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本章的分析是依据我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定做出的。如果相关的法律、法规发生变更，本章中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。

下述所列税项不构成对投资者的纳税建议和投资者纳税依据。投资者应就有关事项咨询财税顾问，发行人不承担由此产生的任何责任。投资者应缴纳的税项与本期超短期融资券的各项支付不构成抵销。

### 一、增值税

《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号），金融业自2016年5月1日起，纳入营业税改征增值税（以下简称营改增）试点范围，金融业纳税人由缴纳营业税改为缴纳增值税，并在全围范围内全面推开。投资者从事有价证券买卖业务应缴纳增值税。

### 二、所得税

根据2008年1月1日生效的《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关的法律、法规，一般机构投资者来源于债券的利息为应纳税所得。机构应将当期收取的利息计入当期收入，核算当期损益后缴纳所得税。

### 三、印花税

根据《中华人民共和国印花税法暂行条例》及其实施细则，在我国境内买卖、继承、赠与、交换、分割等所书立的财产转让书据，均应缴纳印花税。

对超短期融资券在全国银行间债券市场进行的交易，我国目前还没有开始征收印花税。截至本募集说明书出具日，投资者买卖、赠与或继承超短期融资券而书立转让书据时，不需要缴纳印花税。但发行人目前无法预测国家是否或将会于何时决定对有关超短期融资券交易征收印花税，也无法预测将会适用的税率水平。

## 第十章 信息披露安排

### 一、信息披露机制

发行人将严格按照中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等配套文件的相关规定，由公司董事会办公室具体负责和协调各类财务报表、审计报告及可能影响超短期融资券投资者实现其超短期融资券收益及兑付的重大事项的披露工作。

披露时间不晚于企业在证券交易所、指定媒体或其他场合向市场公开披露的时间。公司已出具承诺函，保证所披露信息真实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。

### 二、信息披露安排

#### （一）本期超短期融资券发行前的信息披露

发行人在超短期融资券发行日 1 个工作日前，通过中国货币网和上海清算所网站披露如下文件：

- 1、紫光国芯微电子股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书；
- 2、紫光国芯微电子股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券法律意见书；
- 3、交易商协会要求披露的其他文件；

#### （二）超短期融资券存续期内定期信息披露

发行人在超短期融资券存续期间，向市场定期公开披露如下信息：

- 1、每年 4 月 30 日以前，披露上一年度的年度报告和审计报告；
- 2、每年 8 月 31 日以前，披露本年度上半年的资产负债表、利润表和现金流量表；
- 3、每年 4 月 30 日和 10 月 31 日以前，披露本年度第一季度和第三季度的资产负债表、利润表及现金流量表；
- 4、第一季度信息披露时间不早于上一年度信息披露时间。

#### （三）超短期融资券存续期内重大事项的信息披露

发行人在超短期融资券存续期间，将及时向市场公开披露可能影响公司偿债能力的重大事项，包括：

- 1、企业名称、经营方针和经营范围发生重大变化；
- 2、企业生产经营的外部条件发生重大变化；
- 3、企业涉及可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；

- 4、企业发生可能影响其偿债能力的资产抵押、质押、出售、转让、划转或报废；
- 5、企业发生未能清偿到期重大债务的违约情况；
- 6、企业发生大额赔偿责任或因赔偿责任影响正常生产经营且难以消除的；
- 7、企业发生超过净资产 10% 以上的重大亏损或重大损失；
- 8、企业一次免除他人债务超过一定金额，可能影响其偿债能力的；
- 9、企业三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；
- 10、企业做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
- 11、企业涉及需要说明的市场传闻；
- 12、企业涉及重大诉讼、仲裁事项；
- 13、企业涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；企业董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；
- 14、企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；企业主要或者全部业务陷入停顿，可能影响其偿债能力的；
- 15、企业对外提供重大担保。

#### **(四) 超短期融资券兑付相关的信息披露**

发行人将在超短期融资券本息兑付日前 5 个工作日通过中国货币网和上海清算所网站公布本期超短期融资券的本金兑付和付息事项。如果在本期超短期融资券存续期内有关信息披露管理制度发生变化，发行人将依据其变化对于信息披露安排作出相应调整。

## 第十一章 持有人会议机制

### 一、持有人会议的目的与效力

#### 1、会议目的

债务融资工具持有人会议由本期债务融资工具持有人或其授权代表参加，以维护债务融资工具持有人的共同利益，表达债务融资工具持有人的集体意志为目的。

#### 2、决议效力

除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具持有人，包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的持有人，以及在相关决议通过后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。

### 二、持有人会议的召开情形

#### 1、召开人及职责

本期债务融资工具的主承销商为本期债务融资工具持有人会议的召集人。

#### 2、召开情形

在债务融资工具存续期间，出现以下情形之一的，召集人应当召集持有人会议：

(1) 发行人发行的债务融资工具或其他境内外债券的本金或利息未能按照约定按期足额兑付；

(2) 发行人拟转移债务融资工具清偿义务；

(3) 发行人拟变更债务融资工具信用增进安排，或信用增进安排、提供信用增进服务的机构偿付能力发生重大不利变化；

(4) 发行人拟减资、合并、分立、解散，申请破产、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(5) 发行人因拟进行的资产出售、转让、无偿划转、债务减免、会计差错更正、会计政策（因法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求变更的除外）或

会计估计变更等原因可能导致发行人净资产减少单次超过最近一期经审计净资产的 10%或者 24 个月内累计超过净资产（以首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一期经审计净资产为准）的 10%，或者虽未达到上述指标，但对发行人营业收入、净利润、现金流、持续稳健经营等方面产生重大不利影响；

(6) 发行人发生可能导致其丧失对重要子公司实际控制权的情形；

(7) 发行人拟进行重大资产重组；

(8) 拟解聘、变更后续管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；

(9) 单独或合计持有 30%以上同期债务融资工具余额的持有人书面提议召开；

(10) 法律、法规及相关自律规则规定的其他应由持有人会议做出决议的情形。

### 3、强制召开

召集人在知悉上述持有人会议召开情形后，应在 5 个工作日内与相关方沟通持有人会议召集安排，并在实际可行的最短期内召集持有人会议，拟定会议议案。

发行人或者提供信用增进服务的机构（如有）发生上述情形的，应当告知召集人，发行人披露相关事项公告视为已完成书面告知程序。持有人会议的召集不以发行人或者提供信用增进服务的机构履行告知义务为前提。

召集人不能履行或者不履行召集职责的，单独或合计持有 30%以上同期债务融资工具余额的持有人、发行人、提供信用增进服务的机构均可以自行召集持有人会议，履行召集人的职责。

### 4、主动和提议召集

在债务融资工具存续期间，发行人或提供信用增进服务的机构出现《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》列明的重大事项或信息披露变更事项情形之一的（上述约定须持有人会议召开情形除外），召集人可以主动召集持有人会议，也可以根据单独或合计持有 10%以上同期债务融资工具余额的持

有人、发行人或提供信用增进服务的机构向召集人发出的书面提议召集持有人会议。

召集人收到书面提议的，应自收到提议之日起 5 个工作日内向提议人书面回复是否同意召集持有人会议。

### 三、持有人会议的召集

#### 1、召集公告披露

召集人应当至少于持有人会议召开日前 10 个工作日在交易商协会认可的渠道披露召开持有人会议的公告。召开持有人会议的公告内容包括但不限于下列事项：

- (1) 本期债务融资工具发行情况、持有人会议召开背景；
- (2) 会议召集人、会务负责人姓名及联系方式；
- (3) 会议时间和地点；
- (4) 会议召开形式：持有人会议可以采用现场、非现场或两者相结合的形式；
- (5) 会议议事程序：包括持有人会议的召集方式、表决方式、表决截止日和其他相关事宜；
- (6) 债权登记日：应为持有人会议召开日前一工作日；
- (7) 提交债券账务资料以确认参会资格的截止时点：债务融资工具持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权；
- (8) 参会证明要求：参会人员应出具参会回执、授权委托书、身份证明及债权登记日债券账务资料，在授权范围内参加持有人会议并履行受托义务。

#### 2、初始议案发送

召集人应与发行人、持有人、提供信用增进服务的机构、后续管理人等相关方沟通，并拟定持有人会议议案。

召集人应当至少于持有人会议召开日前 7 个工作日将议案发送至持有人。

议案内容与发行人、提供信用增进服务的机构、后续管理人等机构有关的，议案应同时发送至相关机构。



持有人及相关机构如未收到议案，可向召集人获取。

### 3、补充议案

发行人、提供信用增进服务的机构、后续管理人、单独或合计持有 10%以上同期债务融资工具余额的持有人可以于会议召开日前 5 个工作日以书面形式向召集人提出补充议案。

召集人可对议案进行增补，或在不影响提案人真实意思表示的前提下对议案进行整理，形成最终议案，并提交持有人会议审议。

### 4、最终议案发送及披露

召集人应当在不晚于会议召开前 3 个工作日将最终议案发送至持有人及相关机构，并披露最终议案概要。

最终议案概要包括议案标题、议案主要内容、议案执行程序及答复时限要求。

### 5、议案内容

持有人会议议案应有明确的决议事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。

### 6、召集程序的缩短

若发行人披露债务融资工具本息兑付的特别风险提示公告、出现公司信用类债券违约以及其他严重影响持有人权益的突发情形，召集人可在有利于持有人权益保护的情形下，合理缩短持有人会议召集程序。

符合上述缩短召集程序情形的，召集人应在持有人会议召开前披露持有人会议召开公告，并将议案发送至持有人及相关机构，同时披露议案概要。

若发行人未发生上述情形，但召集人拟缩短持有人会议召集程序的，需向本次持有人会议提请审议缩短召集程序的议案持有人，与本次持有人会议的其他议案一同表决，经持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90%的持有人同意后方可生效。

## 四、持有人会议参会机构

### 1、债权确认

债务融资工具持有人应当向登记托管机构查询本人债权登记日的债券账务信息，并于会议召开前提供相应债券账务资料以证明参会资格。

召集人应当对债务融资工具持有人或其授权代表的参会资格进行确认，并登记其名称以及持有份额。

## 2、参会资格

除法律、法规及相关自律规则另有规定外，在债权登记日确认债权的债务融资工具持有人有权出席持有人会议。

## 3、其他参会机构

发行人、债务融资工具清偿义务承继方、提供信用增进服务的机构等相关方应当配合召集人召集持有人会议，并按照召集人的要求列席持有人会议。

后续管理人应当列席持有人会议，及时了解持有人会议召开情况。

信用评级机构可应召集人邀请列席会议。

经召集人邀请，其他有必要的机构也可列席会议。

## 4、律师见证

持有人会议应当至少有 2 名律师进行见证。

见证律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格、表决权有效性、议案类型、会议有效性、决议生效情况等事项出具法律意见书。法律意见书应当与持有人会议决议一同披露。

# 五、持有人会议的表决和决议

## 1、表决权

债务融资工具持有人及其授权代表行使表决权，所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未出席会议的持有人不参与表决，其所持有的表决权数额计入总表决权数额。

## 2、关联方回避

发行人及其重要关联方持有债务融资工具的，应主动向召集人表明关联关系，并不得参与表决，其所持有的表决权数额不计入总表决权数额。利用、隐瞒关联关系侵害其他人合法利益的，承担相应法律责任。重要关联方包括但不限于：

- (1) 发行人控股股东、实际控制人；
- (2) 发行人合并范围内子公司；
- (3) 债务融资工具清偿义务承继方；
- (4) 为债务融资工具提供信用增进服务的机构；
- (5) 其他可能影响表决公正性的关联方。

### 3、特别议案

下列事项为特别议案：

- (1) 变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排；
- (2) 新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款；
- (3) 解聘、变更后续管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；
- (4) 同意第三方承担债务融资工具清偿义务；
- (5) 授权后续管理人以外的第三方代表全体持有人行使相关权利；
- (6) 其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约定。

### 4、参会比例

除法律法规另有规定外，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应超过本期债务融资工具总表决权数额的 50%，会议方可生效。出席持有人会议的债务融资工具持有人未达会议生效标准的，召集人应当继续履行会议召集召开与后续信息披露义务。

### 5、审议程序

持有人会议对列入议程的各项议案分别审议，逐项表决。持有人会议不得对公告和议案中未列明的事项进行决议。持有人会议的全部议案应当在会议召开首日后的 3 个工作日内表决结束。

## 6、表决统计

召集人应当向登记托管机构查询表决截止日持有人名册，并核对相关债项持有人当日债券账务信息。

表决截止日终无对应债务融资工具面额的表决票视为无效票，无效票不计入总表决权的统计中。

持有人未做表决、投票不规范或投弃权票的，视为该持有人放弃投票权，其所持有的债务融资工具面额计入关于总表决权的统计中。

## 7、表决比例

除法律法规另有规定外，持有人会议决议应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 50%的持有人同意后方可生效；针对特别议案的决议，应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90%的持有人同意后方可生效。

## 8、会议记录

持有人会议应有书面会议记录作为备查文件。持有人会议记录由出席会议的召集人代表和见证律师签名。

## 9、决议披露

召集人应当在持有人会议表决截止日后的 2 个工作日内将会议决议公告在交易商协会认可的渠道披露。会议决议公告包括但不限于以下内容：

- (1) 出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权情况；
- (2) 会议有效性；
- (3) 各项议案的概要、表决结果及生效情况。

## 10、决议答复与披露

发行人应对持有人会议决议进行答复，决议涉及提供信用增进服务的机构、后续管理人或其他相关机构的，上述机构应进行答复。

召集人应在会议表决截止日后的 2 个工作日内将会议决议提交至发行人及相关机构，并及时就有关决议内容与相关机构进行沟通。

相关机构应当自收到会议决议之日后的 5 个工作日内对持有人会议决议情况进行答复。

召集人应于收到相关机构答复的次一个工作日内在交易商协会认可的渠道披露。

## 六、其他

### 1、释义

本节所称以上、以下，包括本数。

### 2、保密义务

召集人、参会机构对涉及单个债务融资工具持有人的持券情况、投票结果等信息承担保密义务。

### 3、承继方、增进机构及受托人义务

本期债务融资工具发行完毕进入存续期后，债务融资工具清偿义务承继方应按照本节中对发行人的要求履行相应义务；新增或变更后的提供信用增进服务的机构以及后续管理人应按照本节中对提供信用增进服务的机构以及后续管理人的要求履行相应义务。

### 4、兜底条款

本节关于持有人会议的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2019 版）》要求不符的，或本节内对持有人会议规程约定不明的，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2019 版）》要求执行。

## 第十二章 违约责任与投资者保护机制

### 一、违约事件

以下事件构成本期债务融资工具项下的违约事件：

1、在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日，发行人未能足额偿付约定本金或利息；

2、因发行人触发本募集说明书中“投资人保护条款”及其他条款的约定(如有)或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本期债务融资工具提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息。

3、在本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，法院受理发行人破产申请；

4、本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其他原因导致法人主体资格不存在。

### 二、违约责任

#### 1、持有人有权启动追索

如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金，或者按照受托管理协议约定授权后续管理人代为追索。

#### 2、违约金

发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外(按照前一计息期利率，至实际给付之日止)，还须向债务融资工具持有人支付违约金，法律另有规定除外。违约金自违约之日起(约定了宽限期的，自宽限期届满之日起)到实际给付之日止，按照应付未付本息乘以日利率 0.21‰ 计算。

### 三、投资者保护机制

#### (一) 应急事件

应急事件是指发行人突然出现的，可能导致超短期融资券不能按期、足额兑付，并可能影响到金融市场稳定的事件。在各期超短期融资券存续期内单独或同时发生下列应急事件时，可以启动投资者保护应急预案：

1. 本公司发生未能清偿到期债务的违约情况，且足以影响到超短期融资券的按时、足额兑付；债务种类包括但不限于短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等公开发行债务，以及银行贷款、承兑汇票、非公开定向发行债务融资工具等非公开发行债务；

2. 当发生强制付息事件时发行人仍未付息，或本公司违反利息递延下的限制事项，或发生递延支付利息时本公司未按信息披露安排进行公告；

3. 发行人或发行人的高级管理层出现严重违法、违规案件，或已就重大经济事件接受有关部门调查，且足以影响到超短期融资券的按时、足额兑付；

4. 发行人发生超过净资产 10%以上重大损失(包括投资损失和经营性亏损)，且足以影响到超短期融资券的按时、足额兑付；

5. 发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，且足以影响到超短期融资券的按时、足额兑付；

6. 发行人受到重大行政处分、罚款或涉及重大诉讼或司法强制执行等事件，且罚款、诉讼或强制执行的标的额较大，且足以影响超短期融资券的按时、足额兑付；

7. 其他可能导致超短期融资券不能按期、足额兑付的事件。

应急事件发生后，发行人、主承销商和联席主承销商应立即按照本章的约定启动投资者保护应急预案，保障投资者权益，减小对债券市场的不利影响。

## (二) 投资者保护应急预案的启动

投资者可以在发生上述应急事件时，向发行人和主承销商建议启动投资者保护应急预案，或由发行人和主承销商在发生应急事件后主动启动应急预案，也可在监管机构认为必要时要求启动应急预案。

发行人和主承销启动应急预案后，可采取下列某项或多项措施保护债权：

1. 公开披露有关事项；

2. 召开债券持有人会议，商议债权保护有关事宜。

#### 四、不可抗力

不可抗力是指本超短期融资券计划公布后，由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况，致使超短期融资券相关责任人不能履约的情况。

(一) 不可抗力包括但不限于以下情况：

1. 自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等；
2. 国际、国内金融市场风险事故的发生；
3. 交易系统或交易场所无法正常工作；
4. 社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。

(二) 不可抗力事件的应对措施

1. 不可抗力发生时，发行人或主承销商应及时通知投资者及超短期融资券相关各方，并尽最大努力保护超短期融资券投资者的合法权益；

2. 发行人或主承销商应召集超短期融资券投资者会议磋商，决定是否终止超短期融资券或根据不可抗力事件对超短期融资券的影响免除或延迟相关义务的履行。

#### 五、弃权

任何一方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利，或宣布对方违约仅适用某一特定情势，不能视作弃权，也不能视为继续对权利的放弃，致使无法对今后违约方的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利，也不会构成对对方当事人的弃权。



## 第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构

### 一、发行人

紫光国芯微电子股份有限公司  
注册地址：河北省玉田县无终西街 3129 号  
邮寄地址：河北省玉田县无终西街 3129 号  
法定代表人：马道杰  
联系人：杜林虎  
电话：010-82355911  
传真：010-82366623  
邮编：064000

### 二、牵头主承销商、簿记管理人、后续管理人

中国建设银行股份有限公司  
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号  
法人代表：田国立  
邮寄地址：北京市西城区金融大街 25 号  
联系人：王文俊  
电话：010-6759 4276  
传真：010-6627 5840

### 三、联席主承销商

光大证券股份有限公司  
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号  
法人代表：刘秋明  
邮寄地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层  
联系人：贾俊、郭毓桐、梁祖铭  
电话：010 - 5651 3200  
传真：010 - 5651 3103

### 四、公司法律顾问

名称：北京市中伦律师事务所  
地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 28、31、33、36、37 层  
负责人：张学兵

联系人：朱永春、刘鑫  
联系电话：010-59572288  
传真：010-65681022

## 五、审计机构

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层  
法定代表人：张恩军  
联系人：时彦禄  
联系电话：010-82250666  
传真：010-82250851

## 六、信用评级机构

名称：中诚信国际信用评级有限责任公司  
地址：北京市东城区朝阳门内大街南竹胡同 2 号银河 SOHO6 号楼  
法定代表人：闫衍  
联系人：吕卓林  
联系电话：010-66428877  
传真：010-66426100

## 七、托管人

名称：银行间市场清算所股份有限公司  
地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 33 层  
法定代表人：许臻  
联系人：发行岗  
联系电话：021-63323840  
传真：021-63326661  
邮政编码：200010

## 八、集中簿记建档系统技术支持机构

名称：北京金融资产交易所有限公司  
地址：北京市西城区金融大街乙 17 号  
法定代表人：郭欠  
联系人：发行部  
电话：010-57896722、010-57896516

传真：010-57896516

邮政编码：100032

发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间都不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

## 第十四章 备查文件

### 一、备查文件

(一) 关于紫光国芯微电子股份有限公司发行超短期融资券的接受注册通知书；

(二) 紫光国芯微电子股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书；

(三) 紫光国芯微电子股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券的法律意见书；

(四) 紫光国芯微电子股份有限公司 2017 年-2019 年度审计报告及 2020 年半年度财务报表。

### 二、文件查询地址

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或簿记管理人。

#### (一) 紫光国芯微电子股份有限公司

邮寄地址：河北省玉田县无终西街 3129 号

联系人：杜林虎

电话：010-82355911

传真：010-82366623

邮编：064100

电子邮箱：dulh@gosinoic.com

#### (二) 中国建设银行股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人：田国立

联系人：王文俊

电话：010-6759 4276

传真：010-6627 5840

邮政编码：100033

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 下载本募集说明书，或在本期超短期融资券发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。

## 附录：发行人主要财务指标计算公式

1. 资产负债率=负债总额/资产总额×100%
2. 流动比率=流动资产/流动负债
3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
4. 利息保障倍数=EBIT/报告期列入财务费用的利息支出
5. EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/报告期列入财务费用的利息支出
6. 经营现金流利息保障倍数=经营性现金净流量/报告期列入财务费用的利息支出
7. 主营业务毛利率=(1-主营业务成本/主营业务收入) ×100%
8. 营业利润率=(营业收入-营业成本-营业税金及附加)/营业收入×100%
9. 总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/(期初资产总额+期末资产总额) ×2×100%
10. 净资产收益率=净利润/期末所有者权益
11. 存货周转率=主营业务成本/(期初存货余额+期末存货余额)×2
12. 应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)×2
13. 固定资产周转率=主营业务收入/(期初固定资产净额+期末固定资产净额)×2
14. 总资产周转率=营业收入/(期初资产总额+期末资产总额)×2

紫光国芯微电子股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书

(此页无正文,专用于紫光国芯微电子股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书的签字盖章页)

紫光国芯微电子股份有限公司

2020 年 10 月 30 日

